



微信公众号

联系方式:

手机:+86 13695655197 (闫)

电话:+86 551 65389802

网址:www.hfywdz.com

传真:+86 551 65389802

邮编:230088

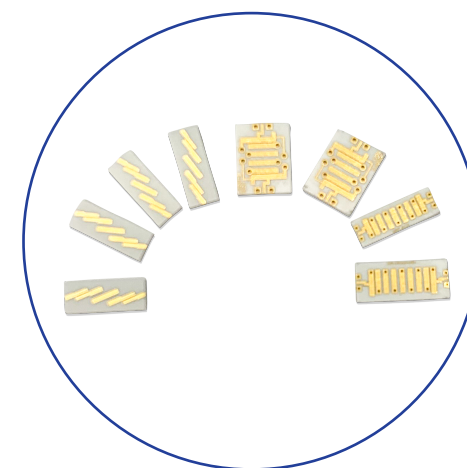
邮箱:liyong@blmicrowave.com

地址:安徽省合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园西三路-1号合肥云之微电子有限公司



合肥云之微电子有限公司

-----可定制滤波器生产厂家
小型化薄膜滤波器产品手册



薄膜滤波器

GOOD MATE

产品目录

YZBP2200-900-10DC	02
YZBP3050-200-6	03
YZBP3150-800-6DA	04
YZBP4700-2700-11DA	05
YZBP5100-200-8SA	06
YZBP5195.5-209-4CQ	07
YZBP5575-250-4CQ	08
YZBP5750-500-8SA	09
YZBP6000-4000-10	10
YZBP6050-300-6	11
YZBP6150-300-4CQ	12
YZBP6820-1100-10DA	13
YZBP7170-1020-9SA	14
YZBP7250-500-6QA	15
YZBP7250-2500-7DA	16
YZBP7800-800-8DA	17
YZBP8000-4000-9JA	18
YZBP8000-4000-10DA	19

YZBP8000-4400-11DA	20
YZBP8170-1020-9SA	21
YZBP8250-500-7JA	22
YZBP8750-2050-7	23
YZBP9170A-1050-9SA	24
YZBP9185-2370-7DA	25
YZBP9200-200-4CQ	26
YZBP9497.5-1835-6DA	27
YZBP9500-3500-10JA	28
YZBP9500-1000-9DA	29
YZBP9500-1800-9DA	30
YZBP9650-3900-7DA	31
YZBP9750-100-5SA	32
YZBP10000-2200-8	33
YZBP10000-4500-10DA	34
YZBP10000-6000-9DA	35
YZBP10150-4900-8DA	36
YZBP10170-1020-9SA	37

YZBP10170A-1020-9SA	38
YZBP10200-P-4CQ	39
YZBP10200-5000-9DA	40
YZBP10920-P-4CQ	41
YZBP11000-2500-7DA	42
YZBP11000-6200-10DA	43
YZBP11200-400-7SA	44
YZBP11300-1800-8JA	45
YZBP11400-2300-7	46
YZBP11600-100-5SA	47
YZBP11860-200-4CQ	48
YZBP12000-3000-8JA	49
YZBP12000-4000-10DA	50
YZBP12400-2200-8DA	51
YZBP12450-4100-10A	52
YZBP13000-1800-8JA	53
YZBP13000-2500-7DA	54
YZBP13000-4000-9DA	55

产品目录

YZBP13325-2000-7SA	56
YZBP13500-400-7SA	57
YZBP14250-3500-6DA	58
YZBP14400-20-6DA	59
YZBP14450-900-8SA	60
YZBP14500-7000-9DA	61
YZBP14700-1800-8JA	62
YZBP14750-2500-8DA	63
YZBP14900-1050-6SA	64
YZBP15000-2000-6DA	65
YZBP15000-2500-7DA	66
YZBP15000-6500-9DA	67
YZBP15500-3400-8SA	68
YZBP15750-4700-10DA	69
YZBP16000-4000-10DA	70
YZBP16155-980-8SA	71
YZBP16500-3500-8DA	72
YZBP16500-7000-12DA	73

YZBP16650-4900-8DA	74
YZBP16975-2450-9DA	75
YZBP17250-4500-8DA	76
YZBP17350-2700-8DA	77
YZBP17850-4250-8DA	78
YZBP18000-4000-8DA	79
YZBP18000-4400-9DA	80
YZBP18500-3400-8SA	81
YZBP19000-2300-8JA	82
YZBP20328.4-20-4CQ	83
YZBP20500-7000-11DA	84
YZBP20750-6500-9DA	85
YZBP20828.4-20-4CQ	86
YZBP21900-1600-6PA	87
YZBP22000-4400-9DA	88
YZBP22250-8400-10DA	89
YZBP22250-9000-8DA	90
YZBP23171.5-20-4CQ	91

YZBP23200-100-4CQ	92
YZBP23671.6-20-4CQ	93
YZBP24000-1000-5CQ	94
YZBP25000-2900-8PA	95
YZBP26000-4400-8DA	96
YZBP28050-8700-9DA	97
YZBP28500-8500-10DA	98
YZBP29000-200-8PA	99
YZBP29000-6500-8PA	100
YZBP29500-7200-8DA	101
YZBP33000-1000-6DA	102
YZBP34000-4000-6PA	103
YZBP34150-700-6DA	104
YZBP34500-3000-8PA	105
YZBP34500-3400-6PA	106
YZBP36000-8000-8SA	107
YZBP40500-600-5PA	108

YZBP2200-900-10DC

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

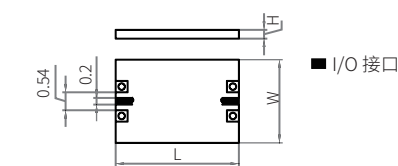
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

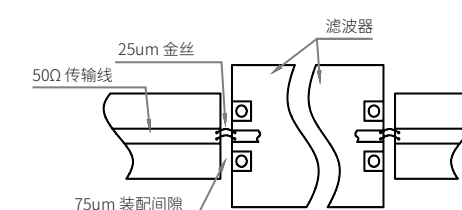
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	2.2	-	GHz
通带频率	1.75	-	2.65	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@1.45GHz			
	≥40dB@2.95GHz			

► 外形尺寸

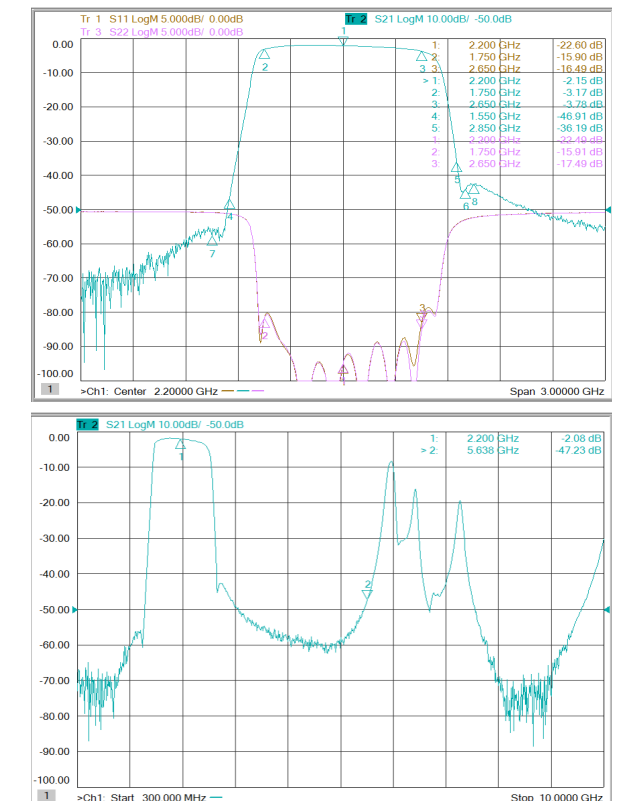


符号	数值	单位
L	8.6	mm
W	9.8	mm
H	0.381	mm

► 建议装配图

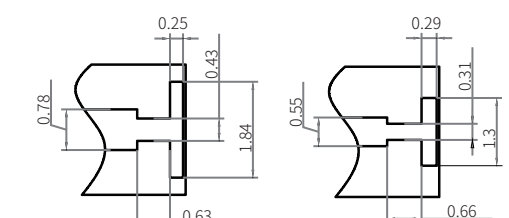


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



	
Rogers5880	Rogers4350
厚度:0.254mm	厚度: 0.254mm
适用频率:DC-30GHz	适用频率:DC-25GHz
T形头图形顶端距基板边沿50um, 频率10GHGz以下无需匹配。	

YZBP3050-200-6

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

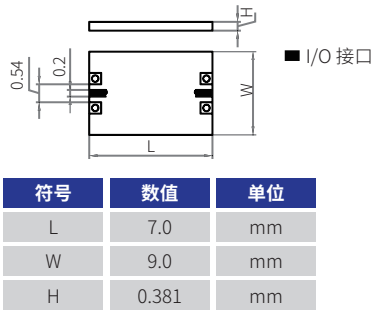
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

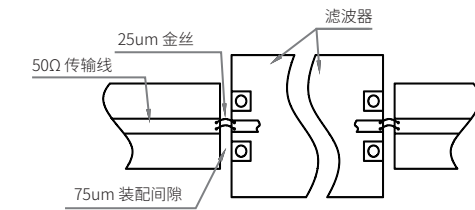
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	3.05	-	GHz
通带频率	2.95	-	3.15	GHz
中心插损	-	4.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@2 GHz			
	≥40dB@3.5 GHz			

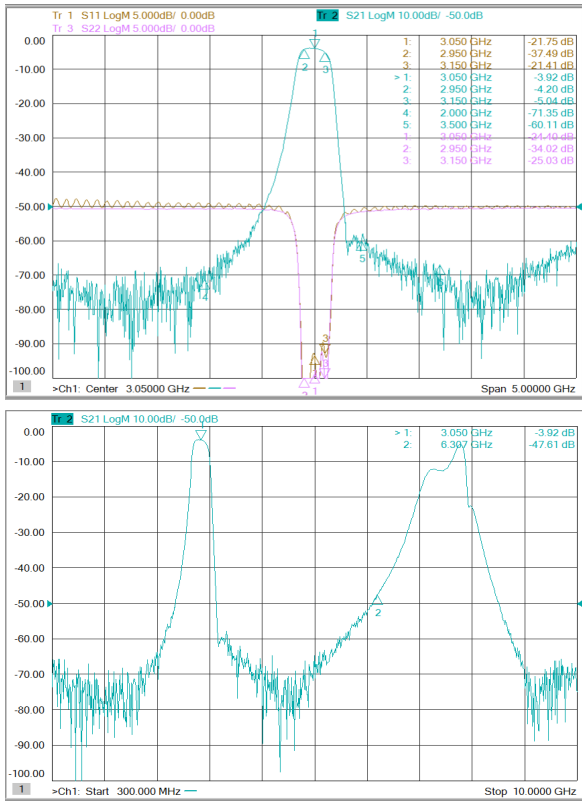
外形尺寸



建议装配图

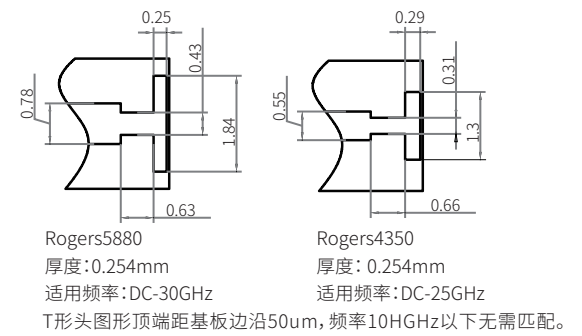


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP3150-800-6DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

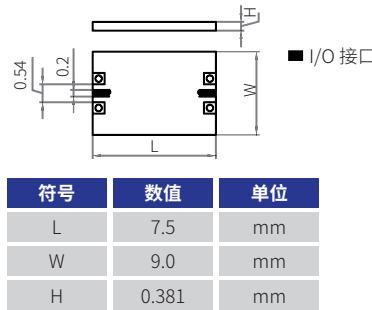
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

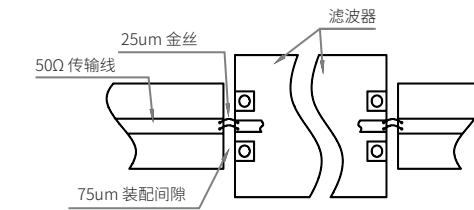
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	3.15	-	GHz
通带频率	2.75	-	3.55	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@2.2 GHz			
	≥40dB@4.6 GHz			

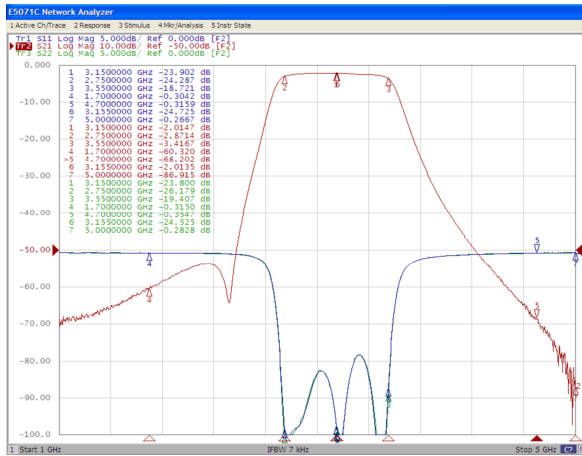
外形尺寸



建议装配图

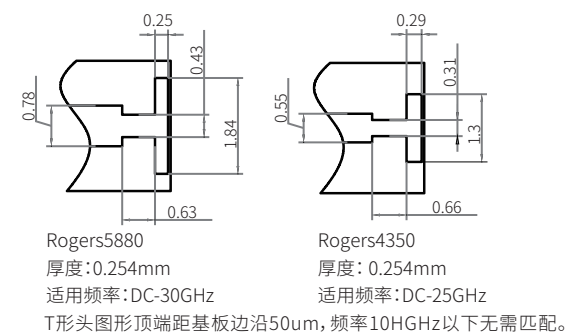


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP4700-2700-11DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

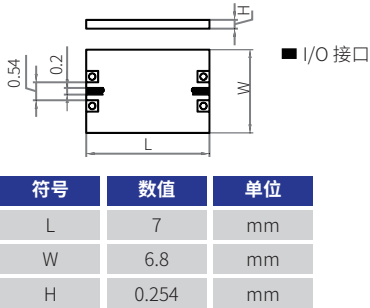
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

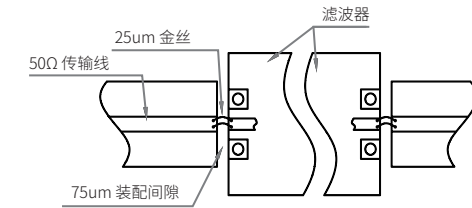
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	4.7	-	GHz
通带频率	3.35	-	6.05	GHz
中心插损	-	2.2	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@1.8 GHz			
	≥60dB@9.5 GHz			

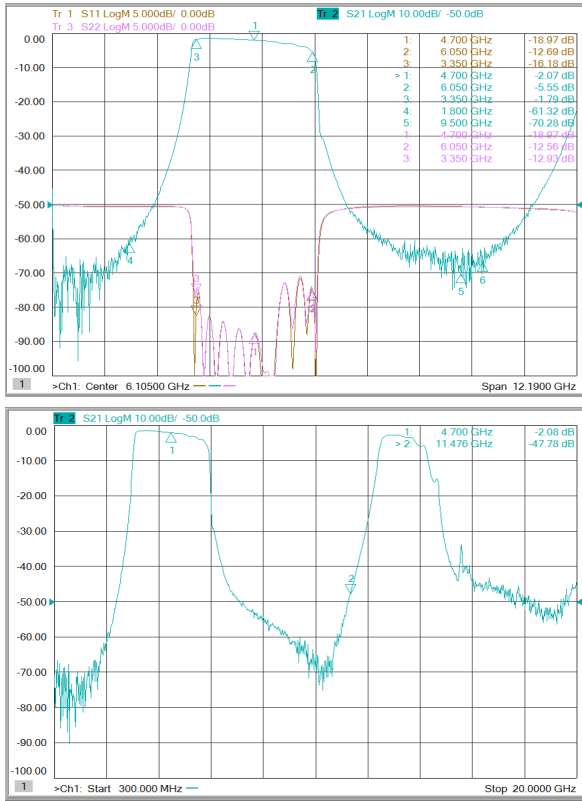
外形尺寸



建议装配图

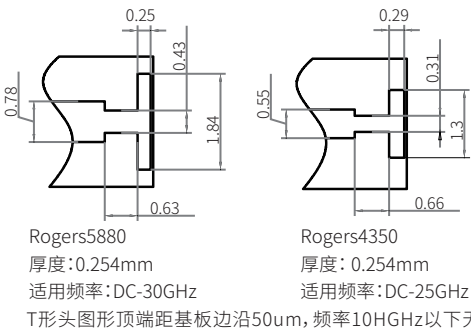


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP5100-200-8SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

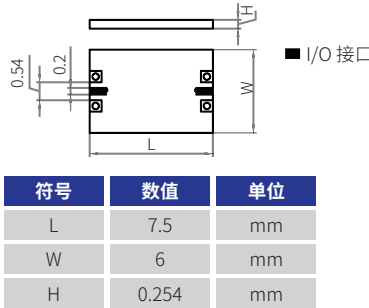
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

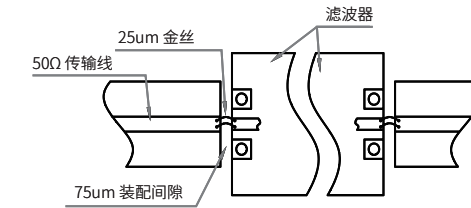
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	5.1	-	GHz
通带频率	5.0	-	5.2	GHz
中心插损	-	5.5	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@4.6GHz			
	≥50dB@5.7 GHz			

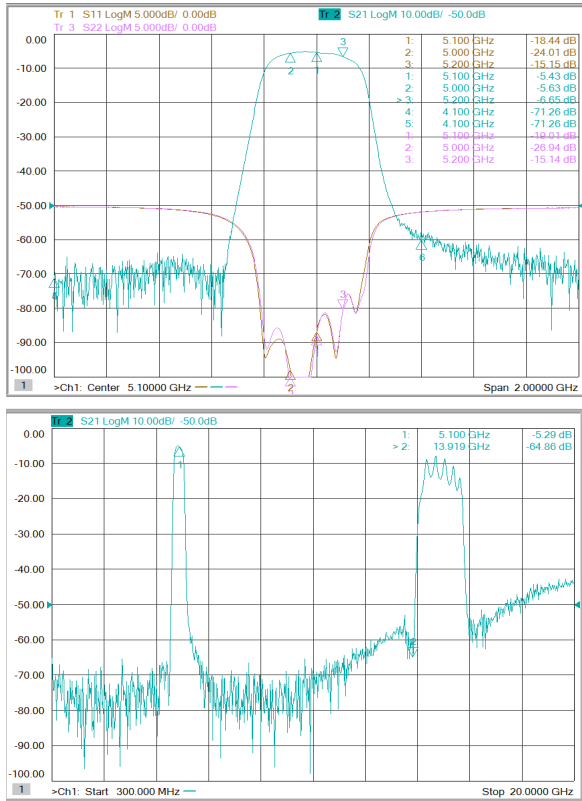
外形尺寸



建议装配图

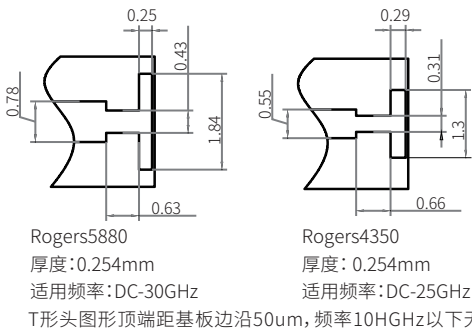


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP5195.5-209-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

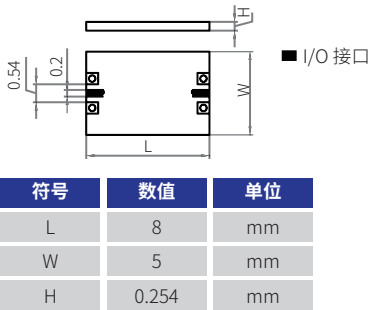
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

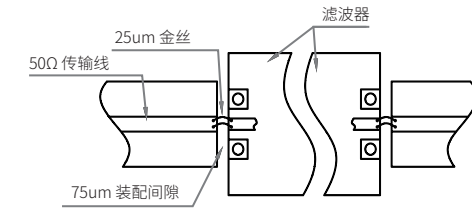
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	5.1955	-	GHz
通带频率	5.091	-	5.3	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@4.13 GHz			
	≥20dB@5.45 GHz			

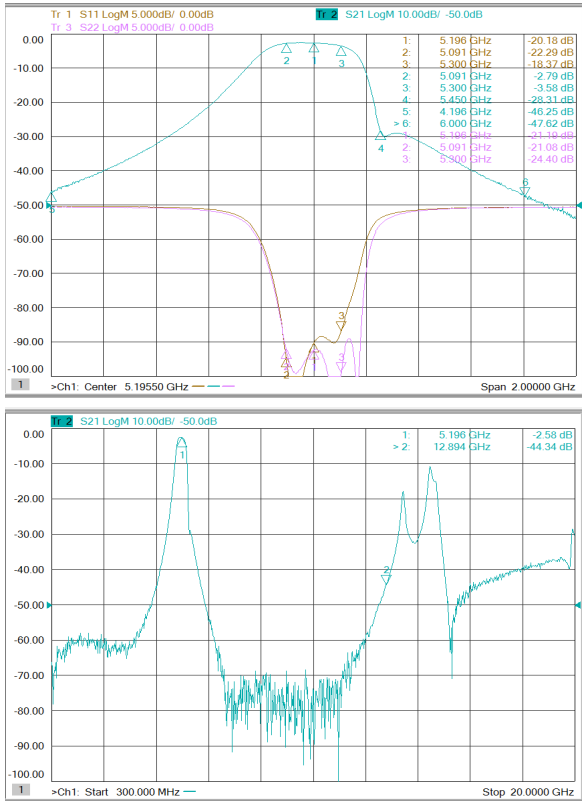
外形尺寸



建议装配图

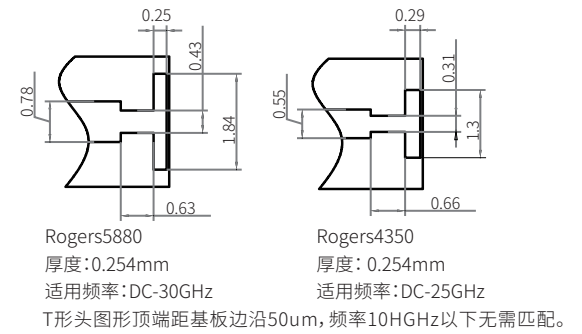


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP5575-250-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

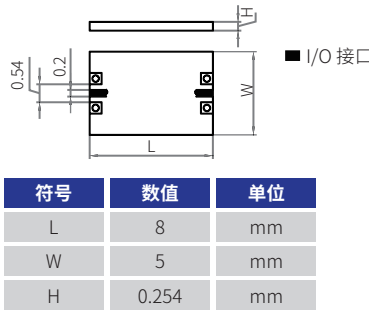
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

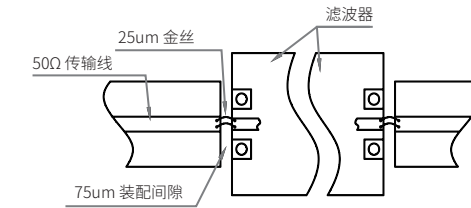
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	5.575	-	GHz
通带频率	5.45	-	5.7	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥25dB@5.3 GHz			
	≥25dB@6.0 GHz			

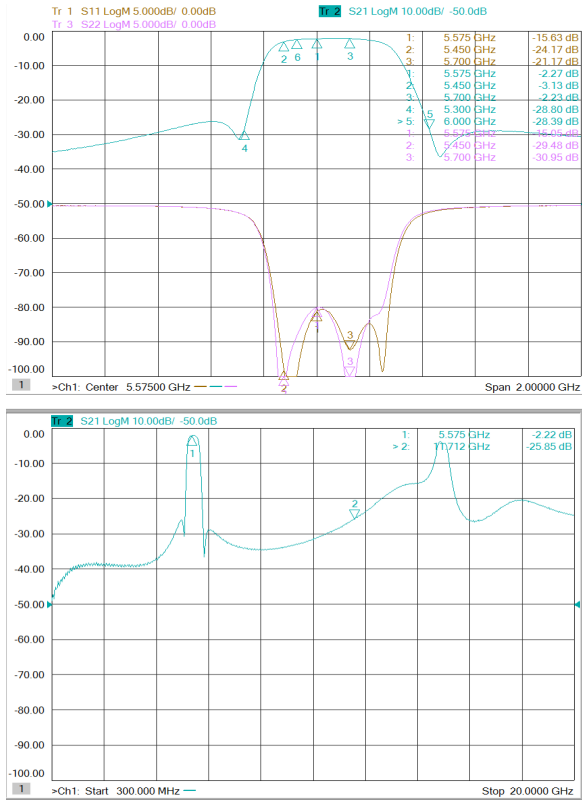
外形尺寸



建议装配图

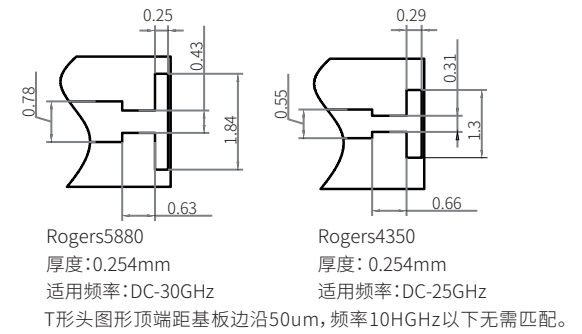


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP5750-500-8SA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

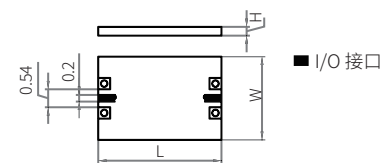
► 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

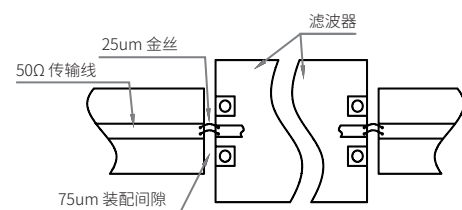
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	5.75	-	GHz
通带频率	5.25	-	6.0	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@4.0 GHz			
	≥60dB@7.0 GHz			

► 外形尺寸

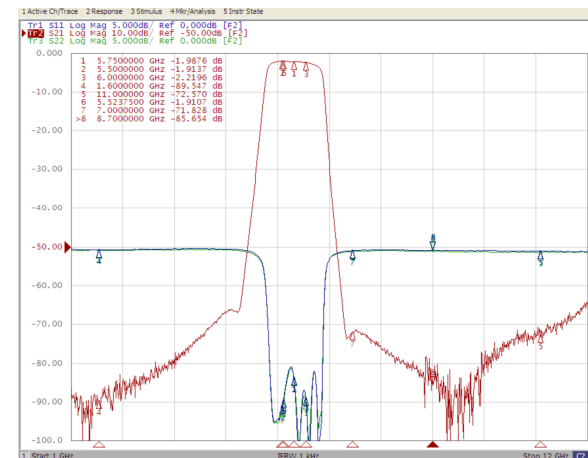


符号	数值	单位
L	8.5	mm
W	5.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

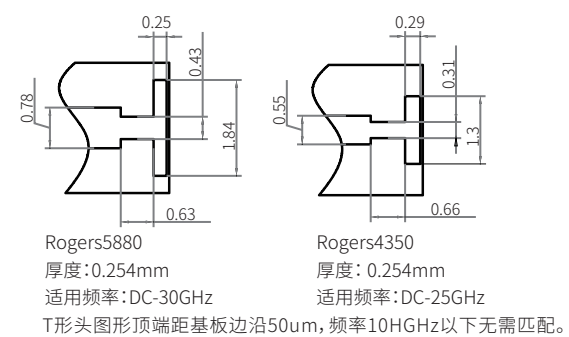


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP6000-4000-10

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

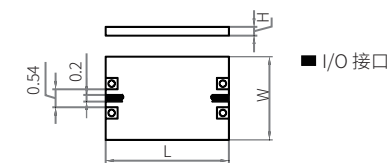
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

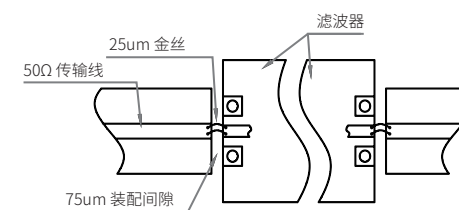
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	6	-	GHz
通带频率	4	-	8	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@3 GHz			
	≥45dB@9 GHz			

► 外形尺寸

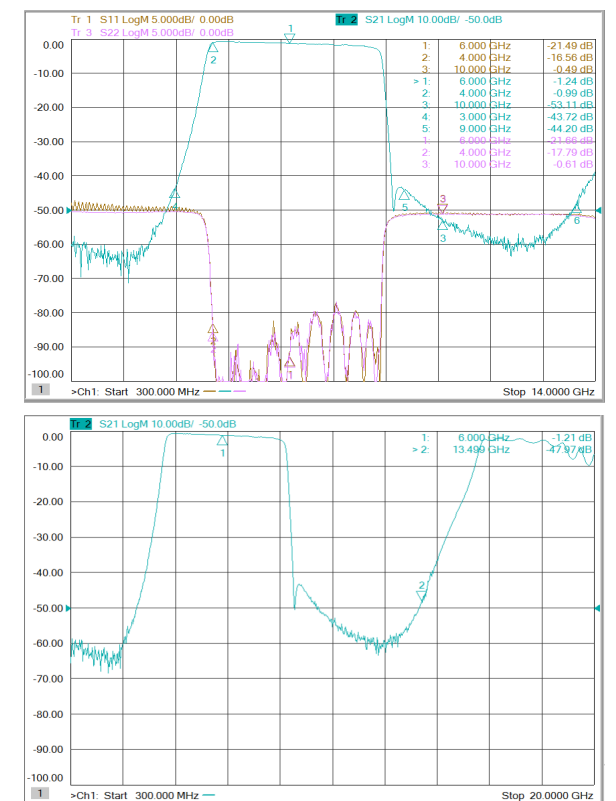


符号	数值	单位
L	7.5	mm
W	6	mm
H	0.381	mm

► 建议装配图

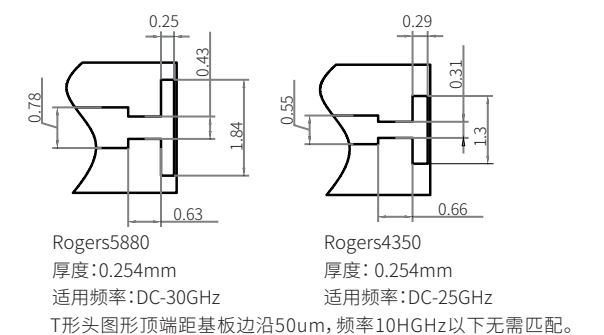


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP6050-300-6

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

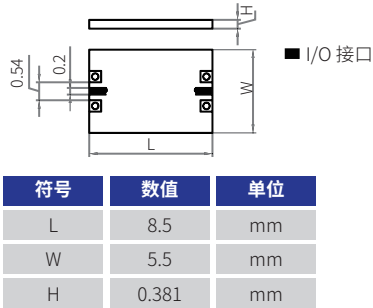
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

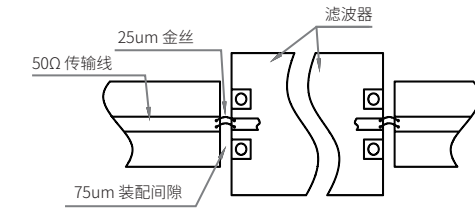
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	6.05	-	GHz
通带频率	5.9	-	6.2	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@5 GHz			
	≥60dB@7.25 GHz			

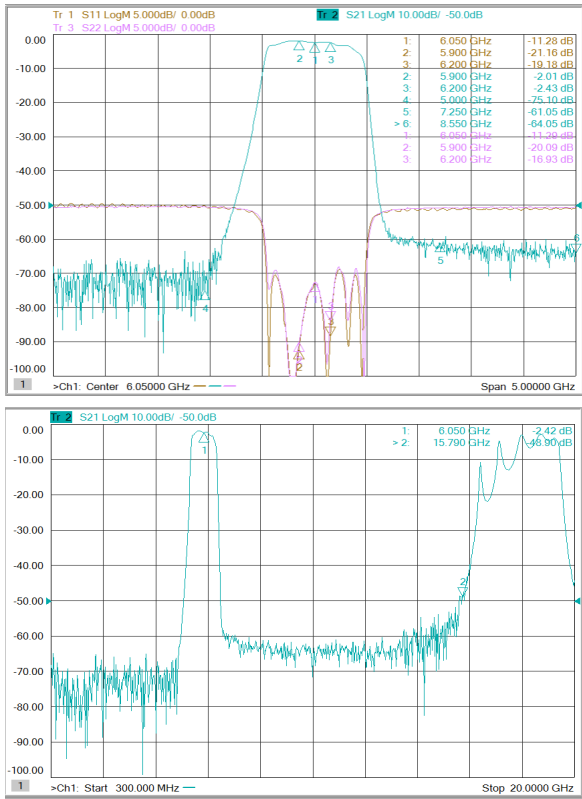
外形尺寸



建议装配图

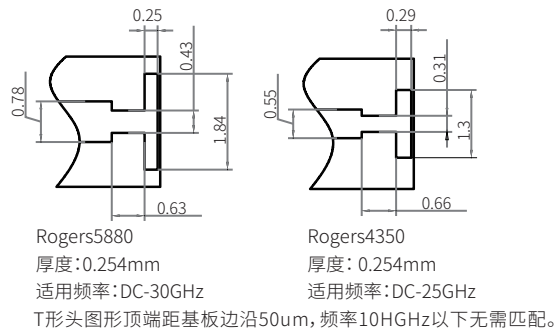


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP6150-300-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

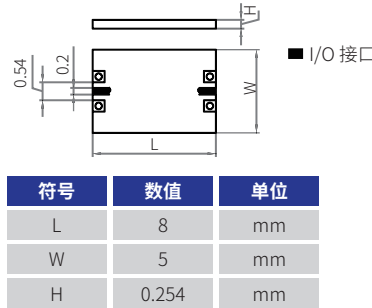
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

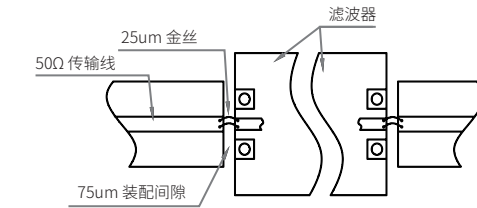
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	6.15	-	GHz
通带频率	6.0	-	6.3	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@3 GHz			
	≥40dB@9 GHz			

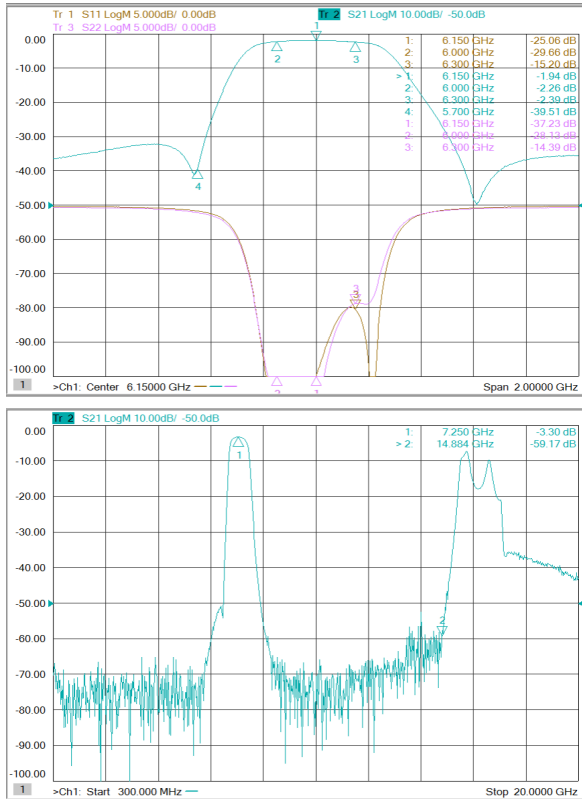
外形尺寸



建议装配图

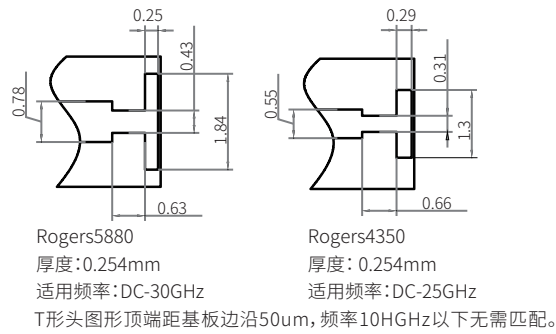


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP6820-1100-10DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

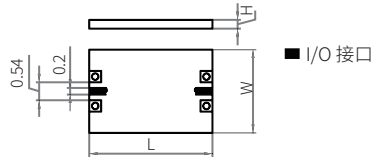
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

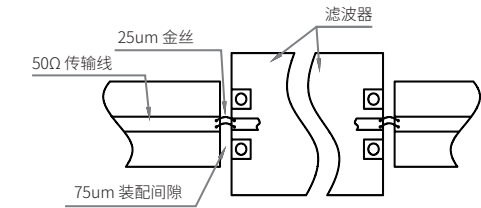
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	6.82	-	GHz
通带频率	6.26	-	7.36	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	0.6	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@5.31 GHz			
	≥45dB@8.59 GHz			

外形尺寸

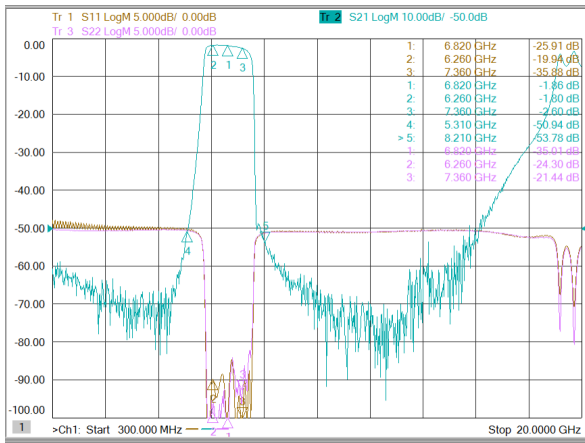


符号	数值	单位
L	8.5	mm
W	5.5	mm
H	0.254	mm

建议装配图

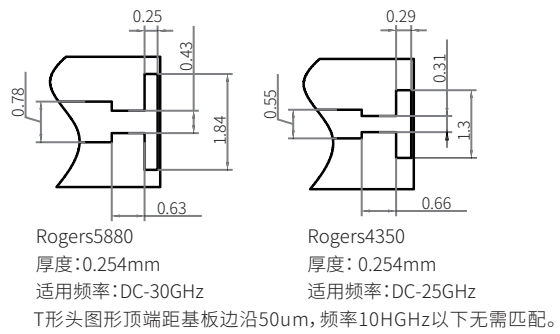


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP7170-1020-9SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

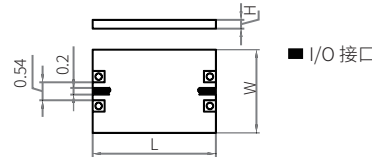
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

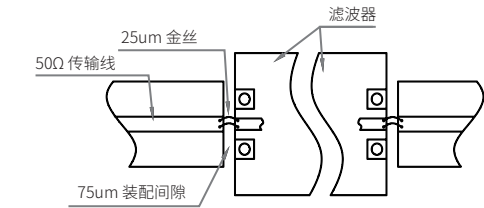
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	7.17	-	GHz
通带频率	6.66	-	7.68	GHz
中心插损	-	3	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@6.36GHz			
	≥40dB@8.64GHz			

外形尺寸

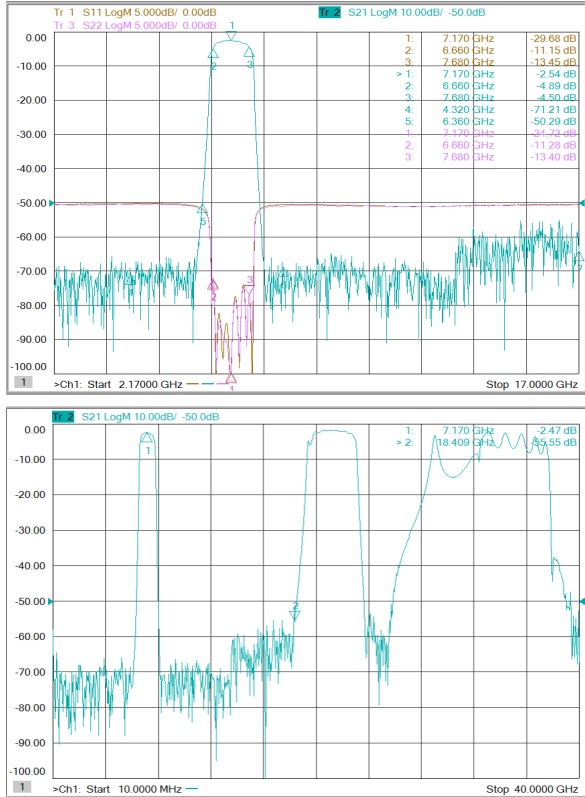


符号	数值	单位
L	8.5	mm
W	5.0	mm
H	0.254	mm

建议装配图

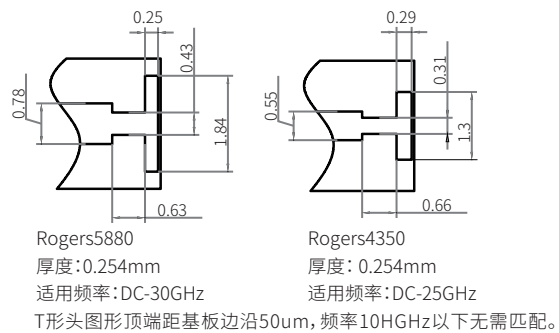


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP7250-500-6QA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

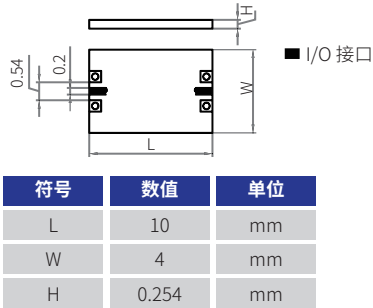
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

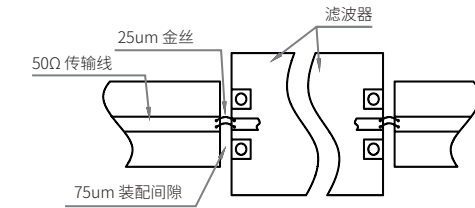
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	7.25	-	GHz
通带频率	7	-	7.5	GHz
中心插损	-	4.5	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@6.5 GHz			
	≥40dB@8 GHz			

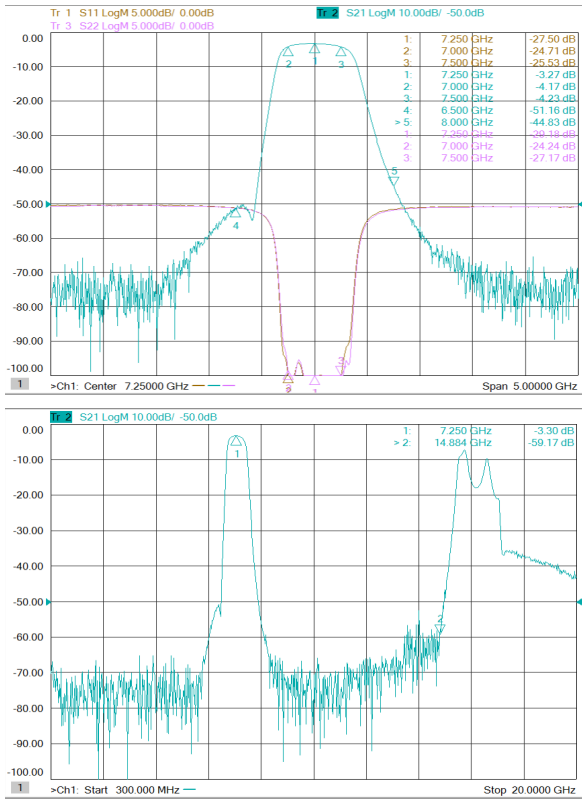
外形尺寸



建议装配图

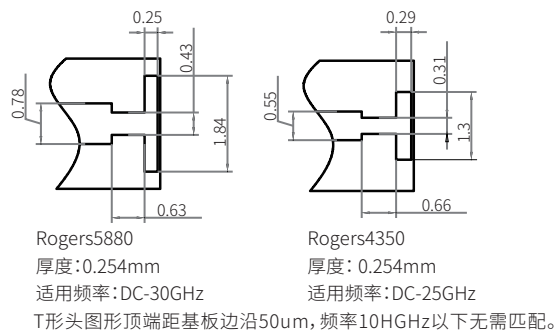


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP7250-2500-7DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

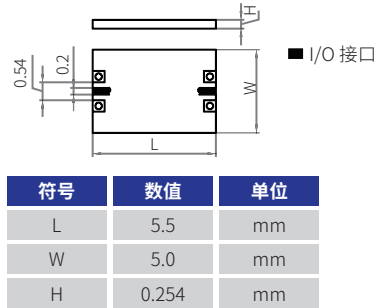
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

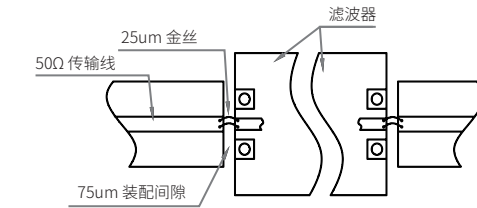
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	7.25	-	GHz
通带频率	6	-	8.5	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@4.0 GHz			
	≥40dB@10.5 GHz			

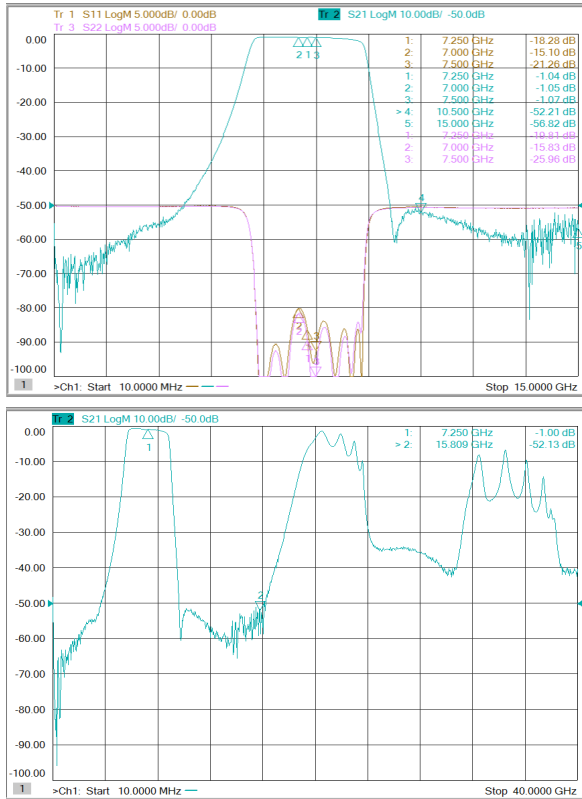
外形尺寸



建议装配图

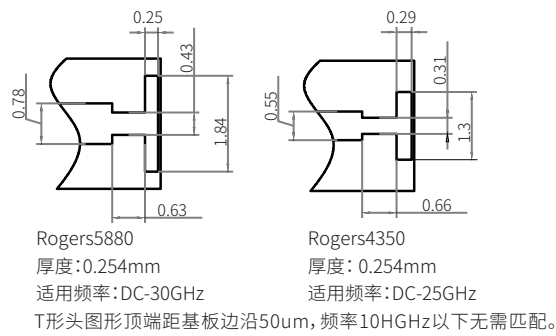


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP7800-800-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

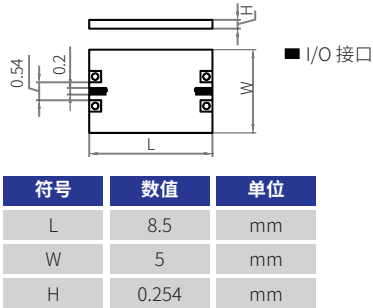
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

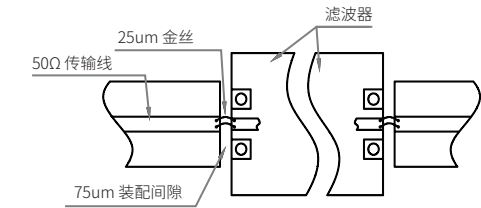
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	7.8	-	GHz
通带频率	7.4	-	8.2	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@6.4 GHz			
	≥45dB@9.2 GHz			

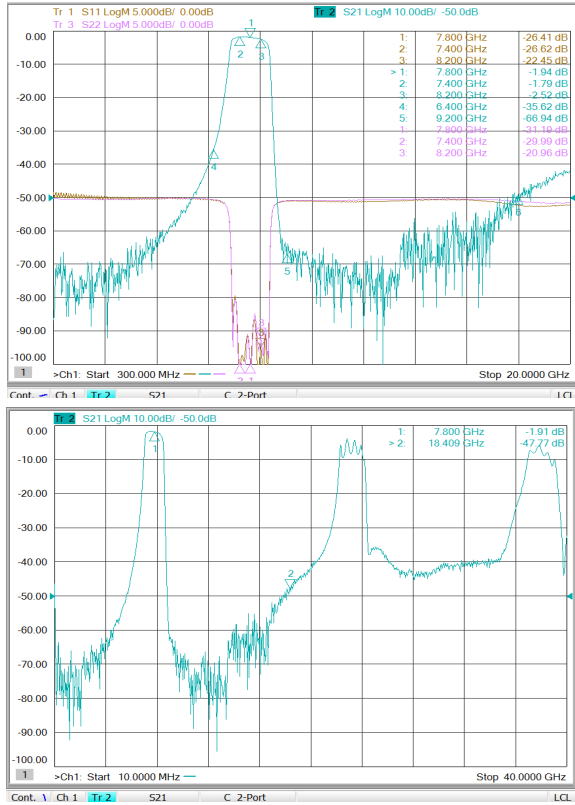
外形尺寸



建议装配图

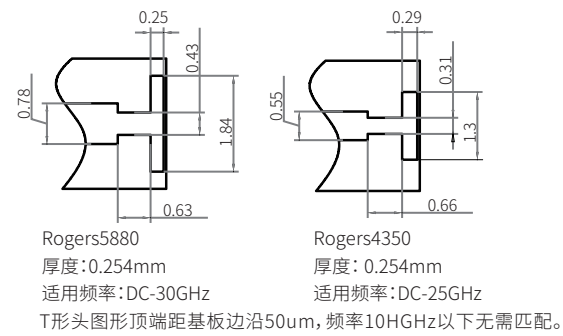


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP8000-4000-9JA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

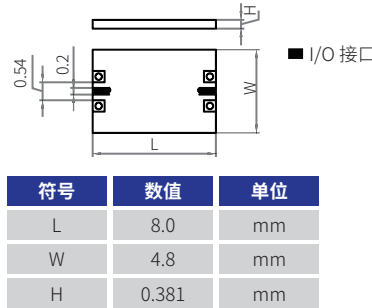
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

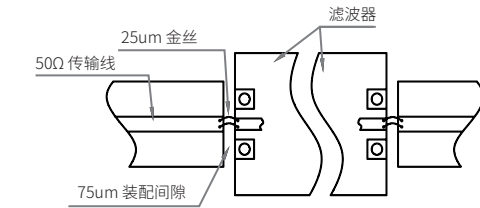
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	8.0	-	GHz
通带频率	6	-	10	GHz
中心插损	-	1.8	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@5.15 GHz			
	≥40dB@11.6 GHz			

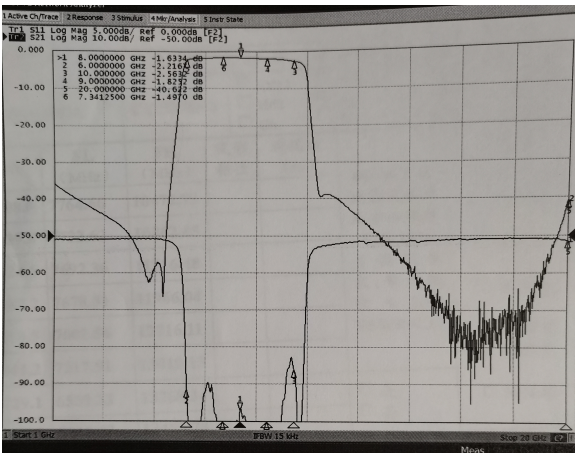
外形尺寸



建议装配图

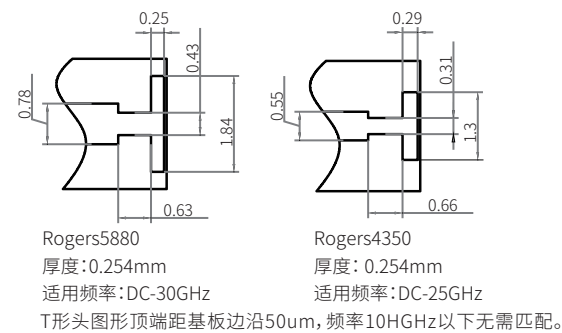


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP8000-4000-10DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

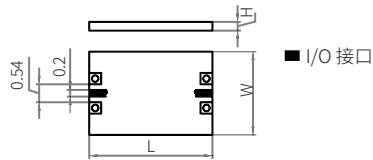
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

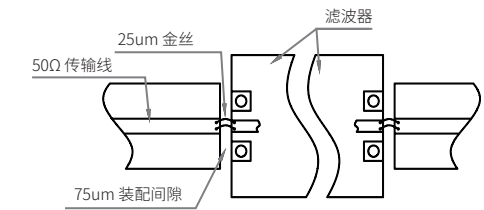
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	8	-	GHz
通带频率	6	-	10	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@4 GHz			
	≥40dB@11.5 GHz			

外形尺寸

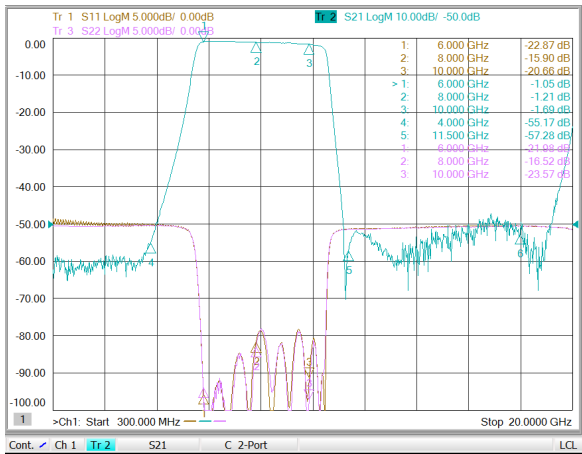


符号	数值	单位
L	7	mm
W	4.9	mm
H	0.381	mm

建议装配图

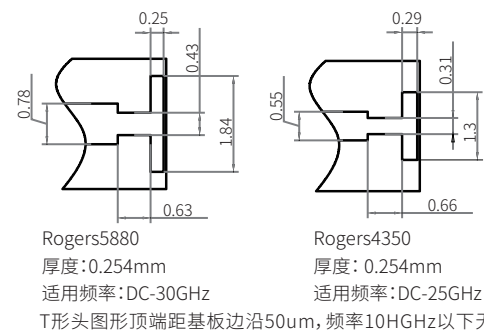


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP8000-4400-11DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

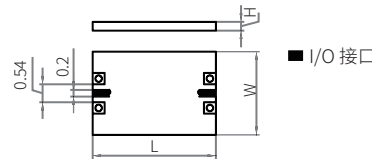
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

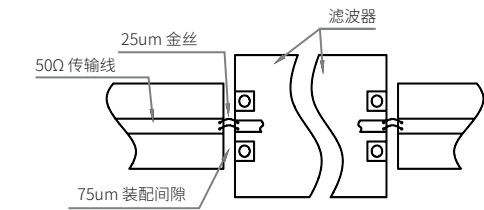
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	8	-	GHz
通带频率	5.8	-	10.2	GHz
中心插损	-	2	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@3.5 GHz			
	≥60dB@15 GHz			

外形尺寸

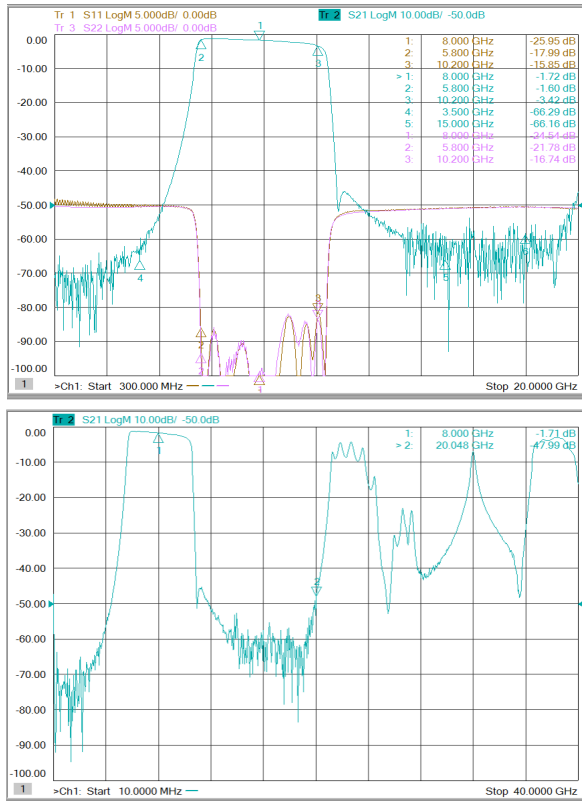


符号	数值	单位
L	7	mm
W	4.5	mm
H	0.254	mm

建议装配图

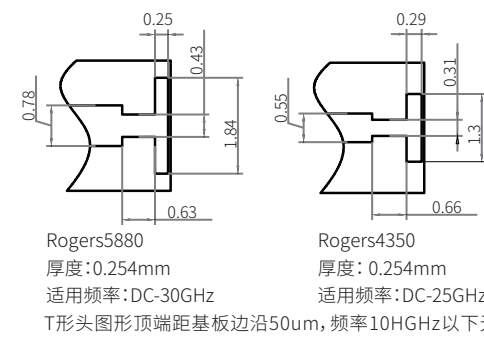


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP8170-1020-9SA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

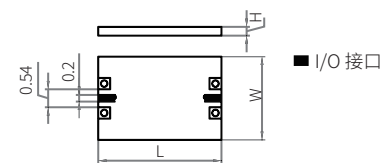
▶ 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

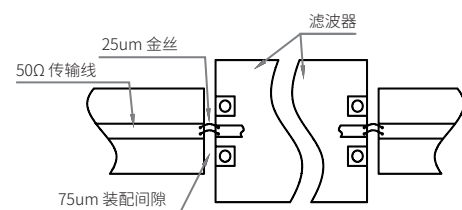
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	8.17	-	GHz
通带频率	7.66	-	8.68	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@7.36 GHz			
	≥40dB@10.64 GHz			

► 外形尺寸

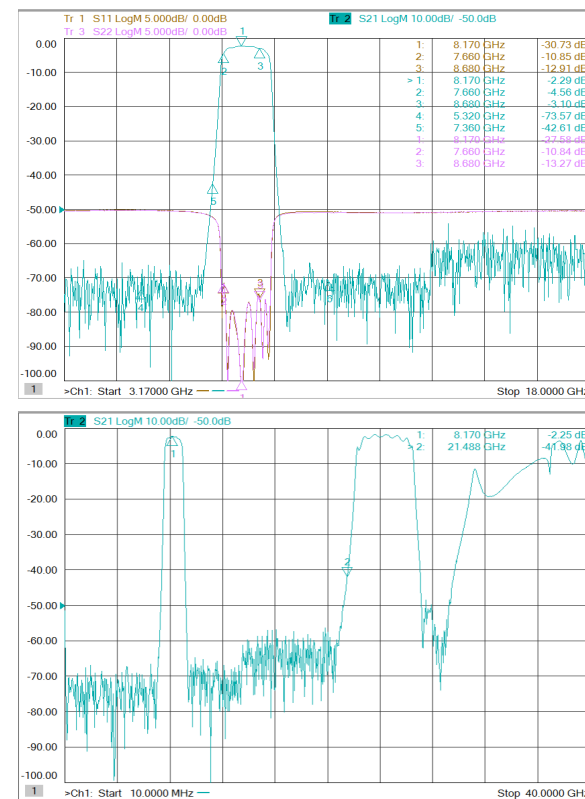


符号	数值	单位
L	8.5	mm
W	4.5	mm
H	0.254	mm

▶ 建议装配图

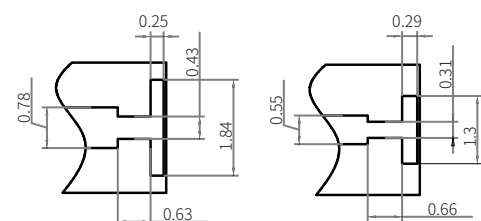


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



Rogers5880	Rogers4350
厚度:0.254mm	厚度:0.254mm
适用频率:DC-30GHz	适用频率:DC-25GHz
T形头图形顶端距基板边沿50um, 频率10GHz以下无需匹配。	

YZBP8250-500-7JA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

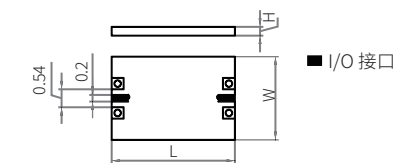
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

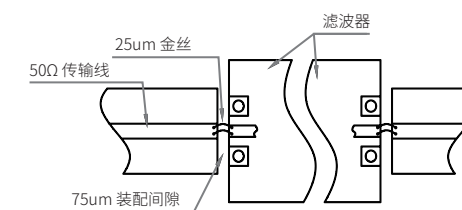
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	8.25	-	GHz
通带频率	8	-	8.5	GHz
中心插损	-	3.5	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@7.5 GHz			
	≥40dB@9.0 GHz			

► 外形尺寸

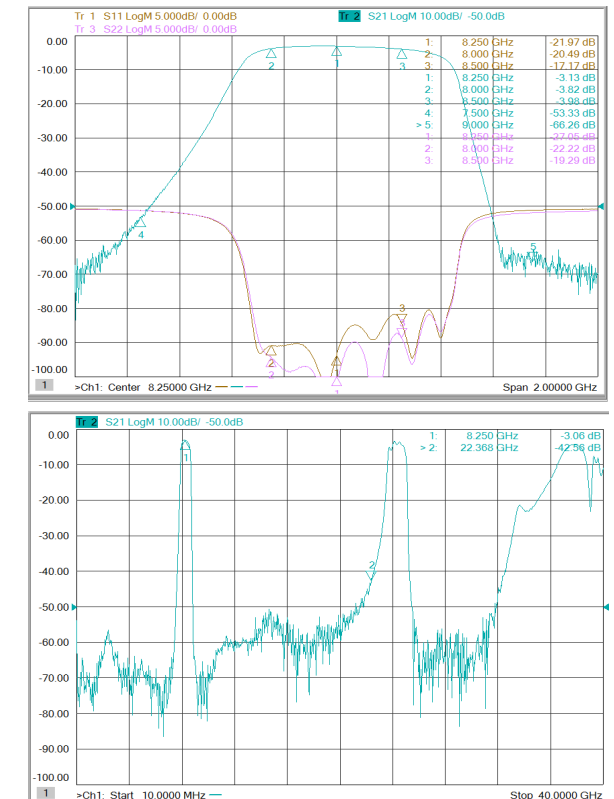


符号	数值	单位
L	10.0	mm
W	4.0	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

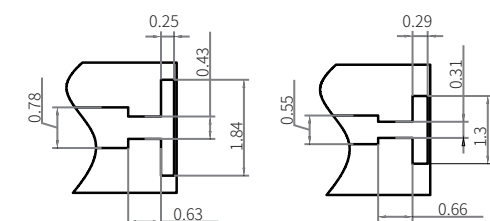


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



Rogers5880	Rogers4350
厚度:0.254mm	厚度:0.254mm
适用频率:DC-30GHz	适用频率:DC-25GHz

T形头图形顶端距基板边沿50um, 频率10GHGz以下无需匹配。

YZBP8750-2050-7

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

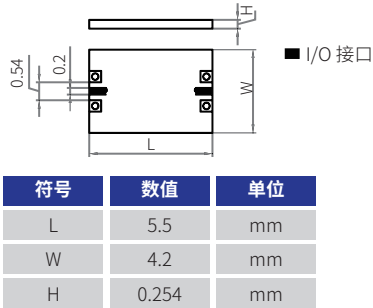
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

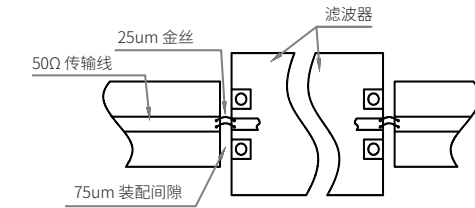
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	8.75	-	GHz
通带频率	7.7	-	9.8	GHz
中心插损	-	1.8	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@6.2 GHz			
	≥45dB@11.25 GHz			

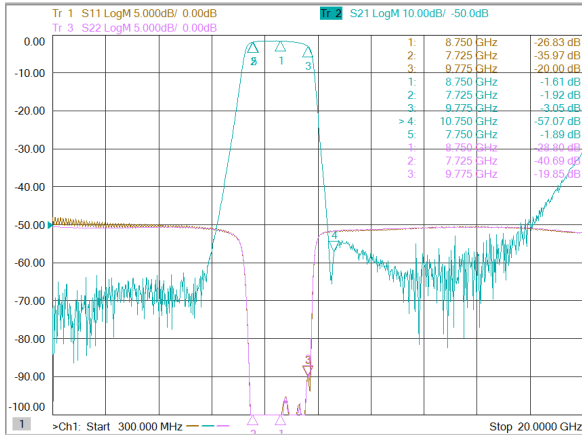
外形尺寸



建议装配图

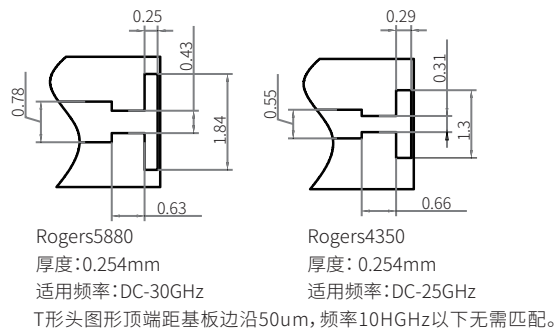


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9170A-1050-9SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

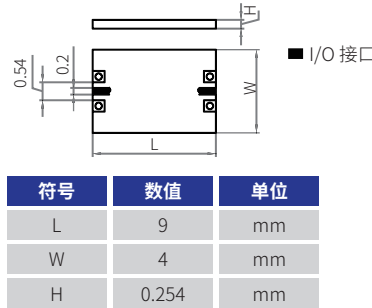
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

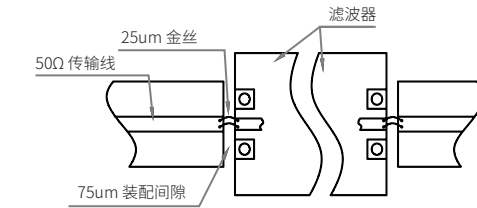
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.17	-	GHz
通带频率	8.66	-	9.68	GHz
中心插损	-	3	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@7.8 GHz			
	≥40dB@10.55 GHz			

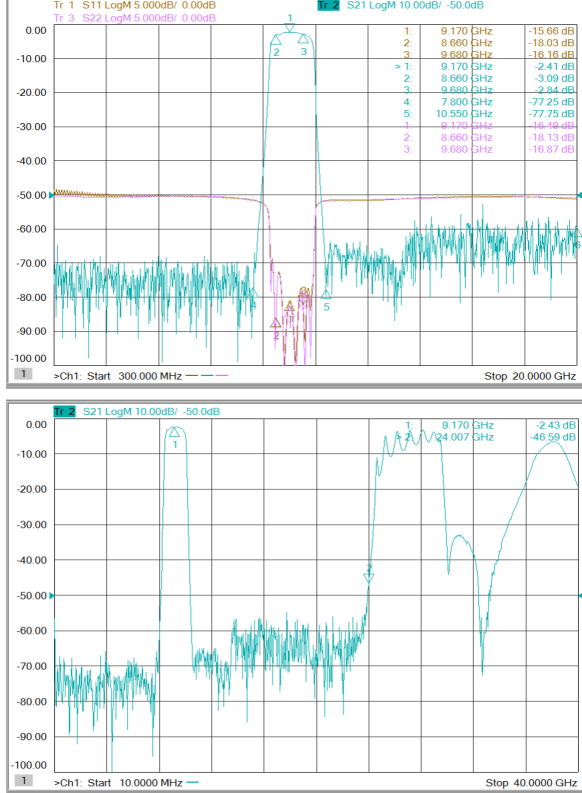
外形尺寸



建议装配图

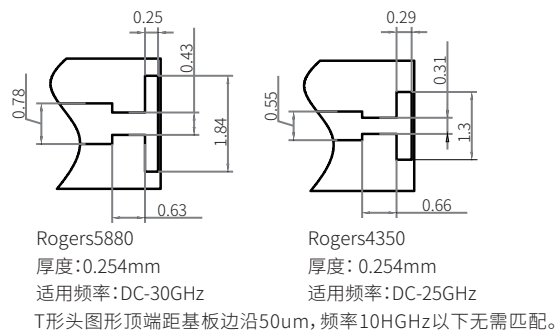


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9185-2370-7DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

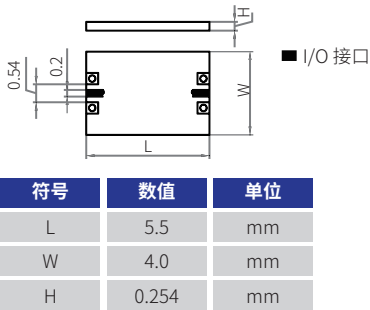
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

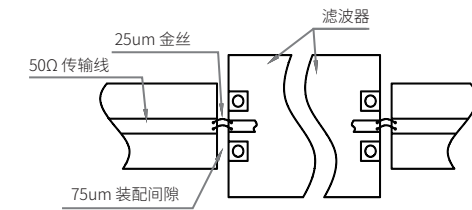
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.185	-	GHz
通带频率	8	-	10.37	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@6.2 GHz			
	≥40dB@12.2 GHz			

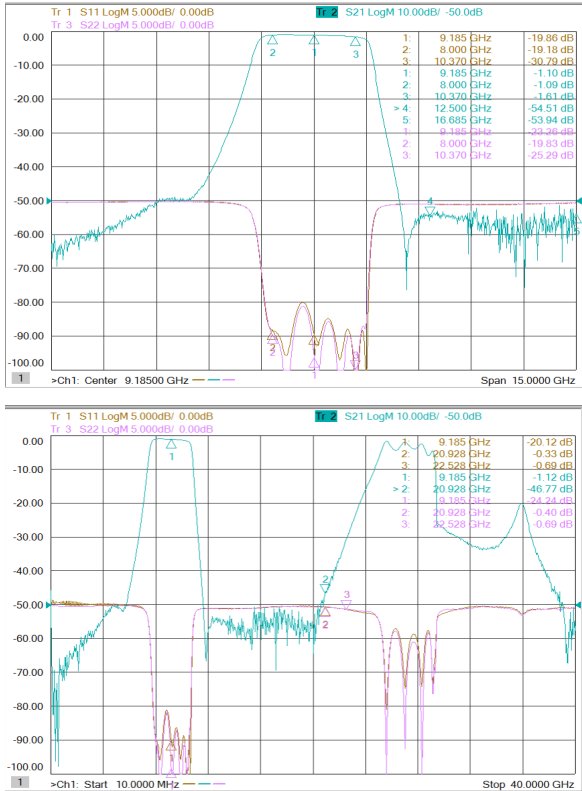
外形尺寸



建议装配图

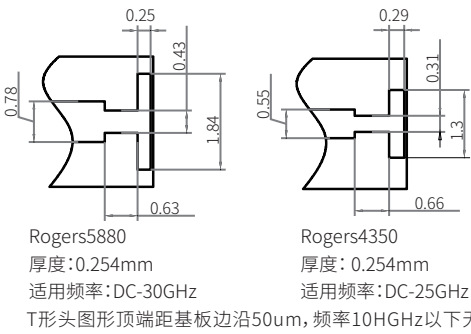


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9200-200-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

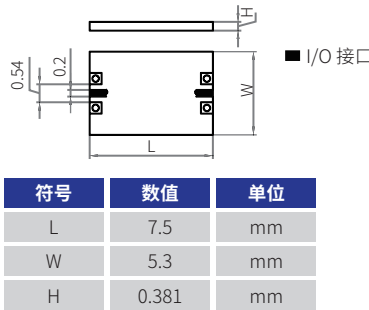
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

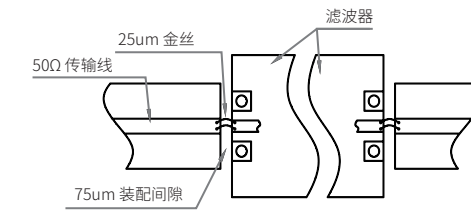
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.2	-	GHz
通带频率	9.1	-	9.3	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@8.26 GHz			
	≥50dB@10.14 GHz			

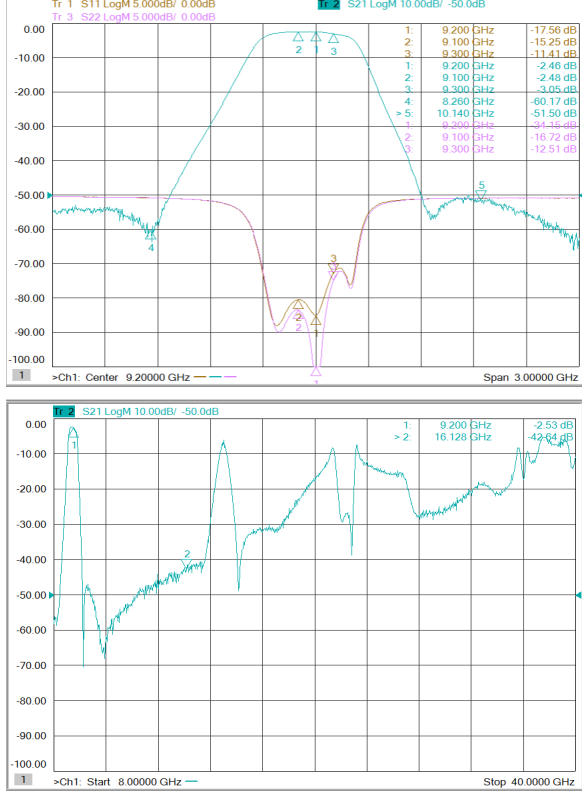
外形尺寸



建议装配图

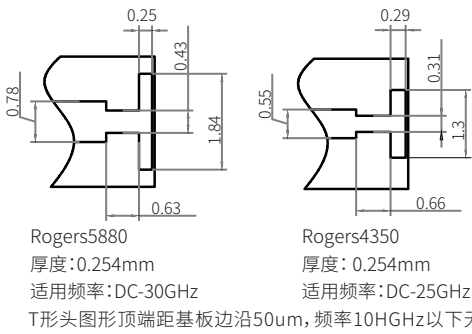


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9497.5-1835-6DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

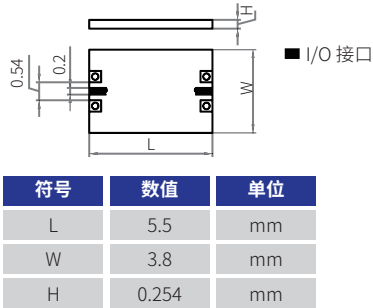
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

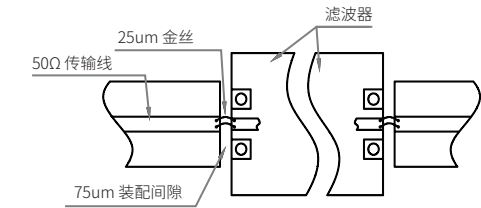
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.4975	-	GHz
通带频率	8.58	-	10.415	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@5.25 GHz			
	≥50dB@12.8 GHz			

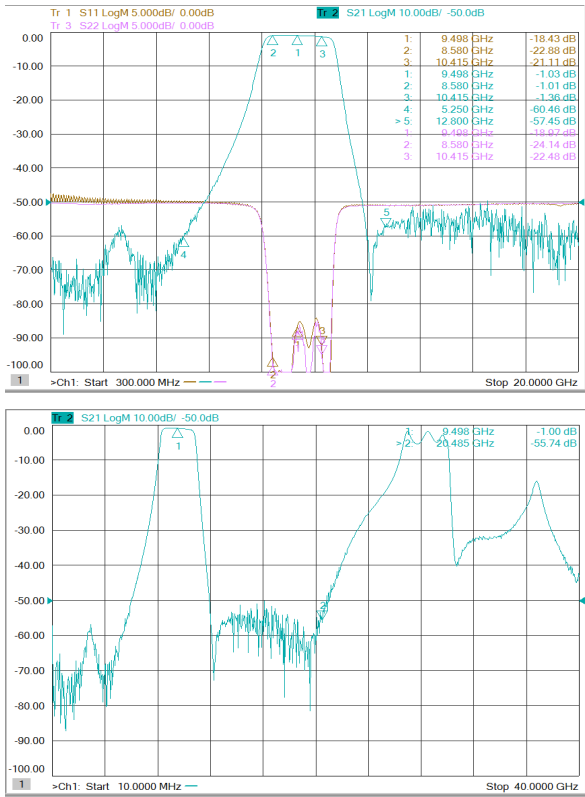
外形尺寸



建议装配图

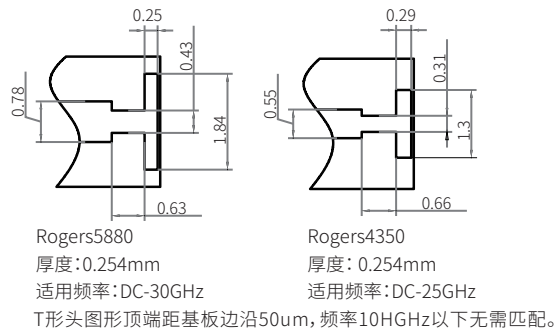


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9500-3500-10JA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

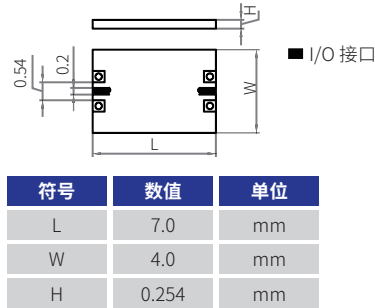
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

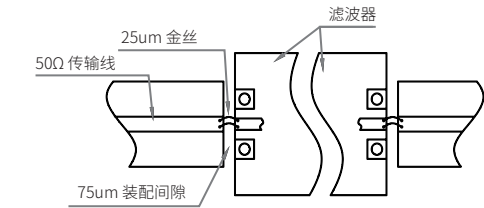
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.5	-	GHz
通带频率	7.75	-	11.25	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@DC~6 GHz			
	≥45dB@12.5~20 GHz			

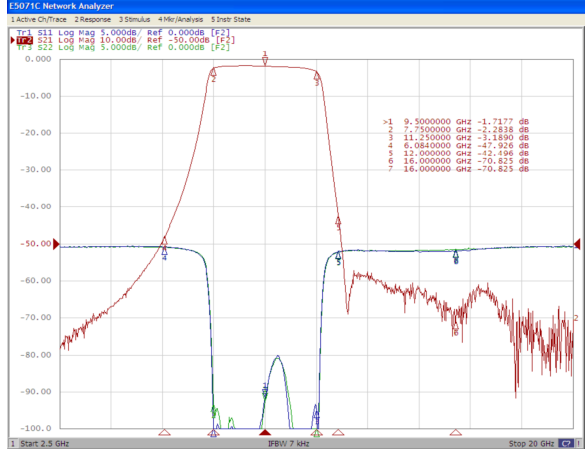
外形尺寸



建议装配图

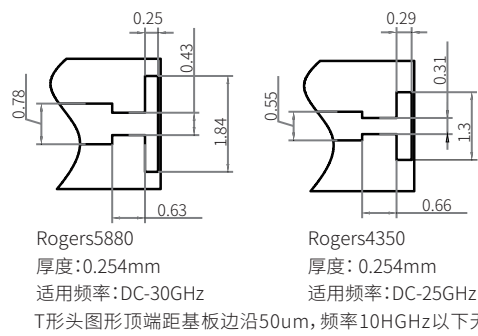


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9500-1000-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

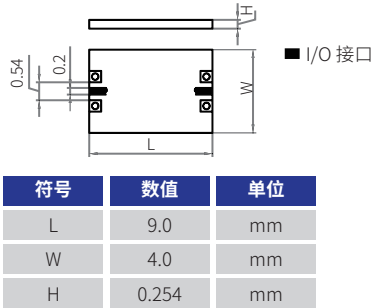
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

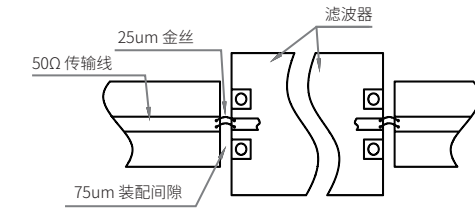
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.5	-	GHz
通带频率	9.0	-	10	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@8 GHz			
	≥60dB@12 GHz			

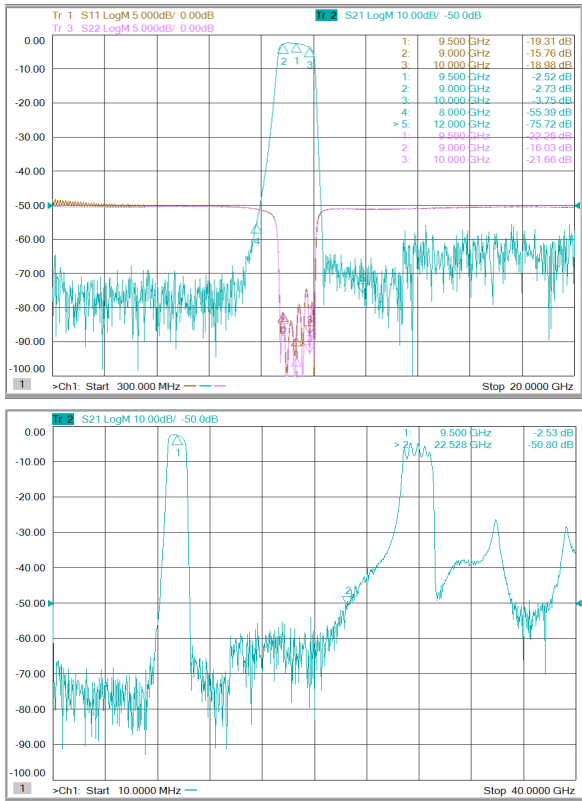
外形尺寸



建议装配图

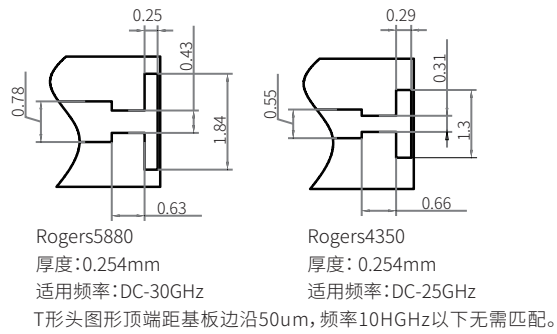


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9500-1800-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

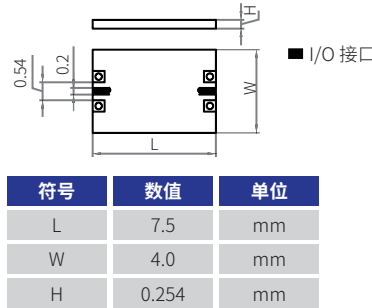
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

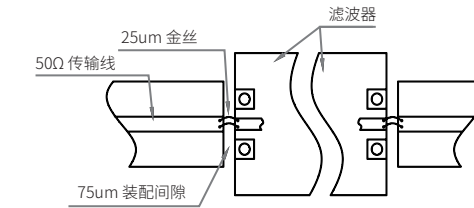
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.5	-	GHz
通带频率	8.6	-	10.4	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@5 GHz			
	≥60dB@12 GHz			

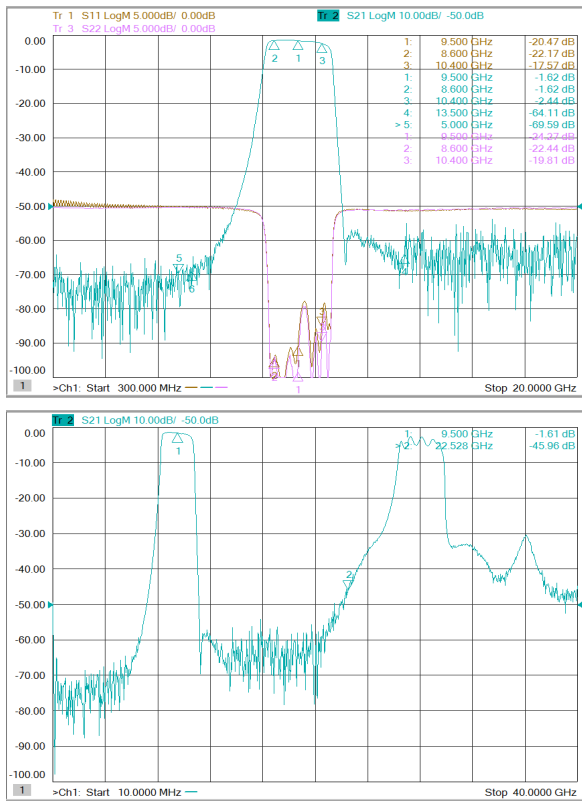
外形尺寸



建议装配图

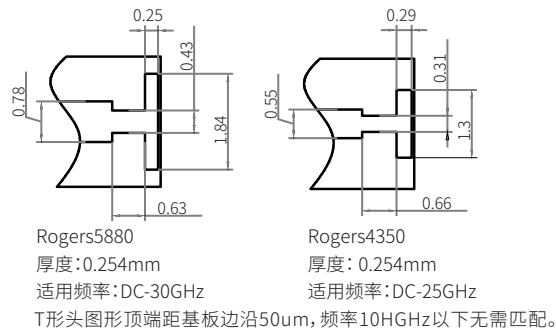


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9650-3900-7DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

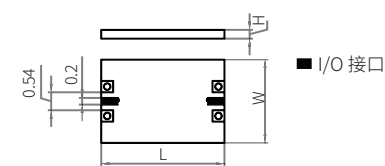
▶ 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

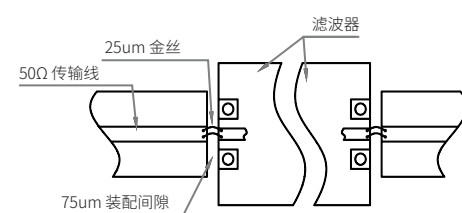
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.65	-	GHz
通带频率	7.7	-	11.6	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@4 GHz			
	≥50dB@16 GHz			

► 外形尺寸

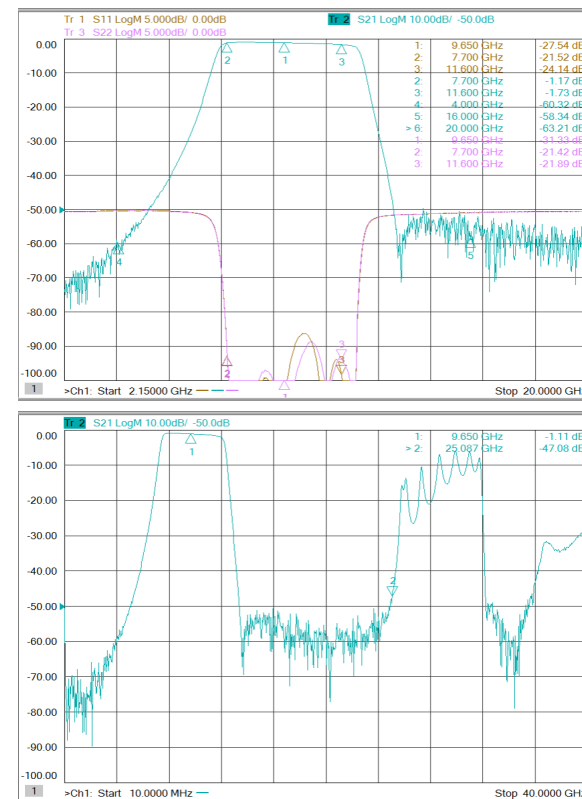


符号	数值	单位
L	6.5	mm
W	3.7	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

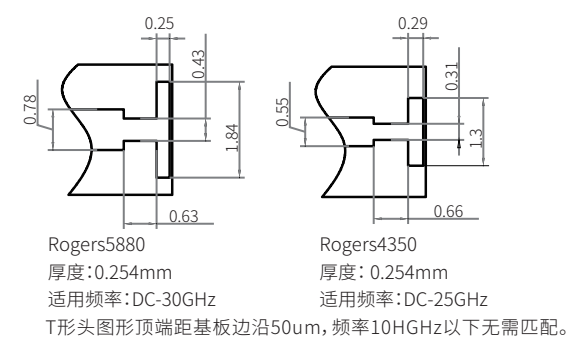


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP9750-100-5SA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

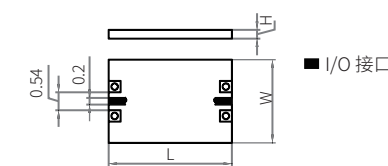
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

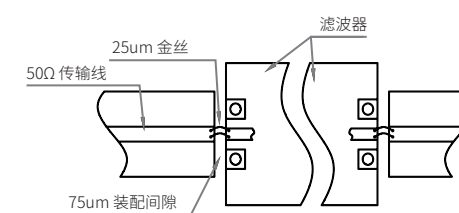
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	9.75	-	GHz
通带频率	9.7	-	9.8	GHz
中心插损	-	4.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@9 GHz			
	≥40dB@10.5 GHz			

► 外形尺寸

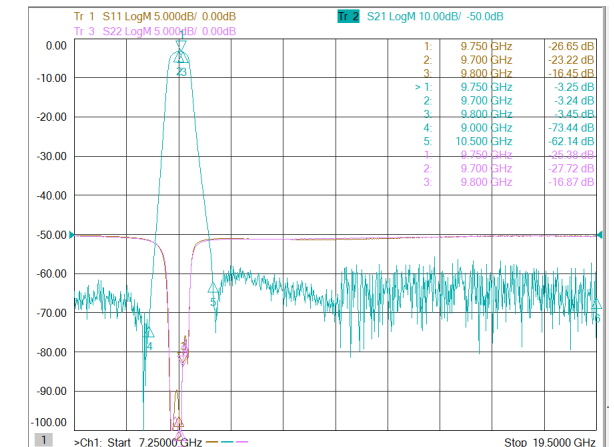


符号	数值	单位
L	5.5	mm
W	4.0	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

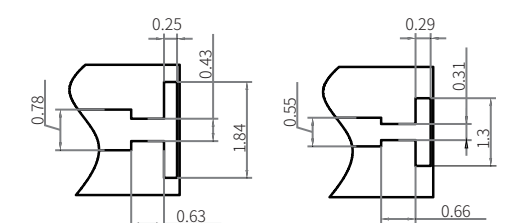


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



Rogers5880	Rogers4350
厚度:0.254mm	厚度: 0.254mm
适用频率:DC-30GHz	适用频率:DC-25GHz

T形头图形顶端距基板边沿50um, 频率10HGHz以下无需匹配。

YZBP10000-2200-8

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

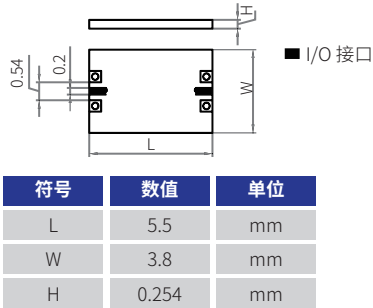
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

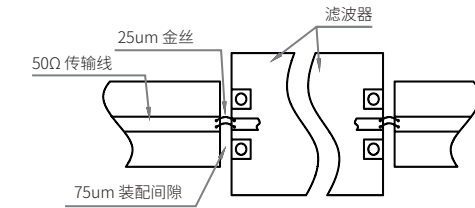
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10	-	GHz
通带频率	9	-	11	GHz
中心插损	-	2	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@7.5 GHz			
	≥45dB@12.45 GHz			

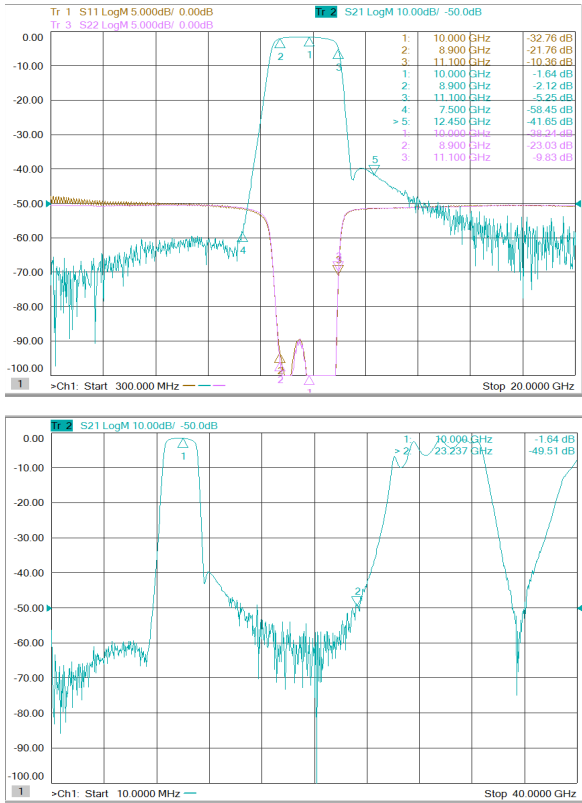
外形尺寸



建议装配图

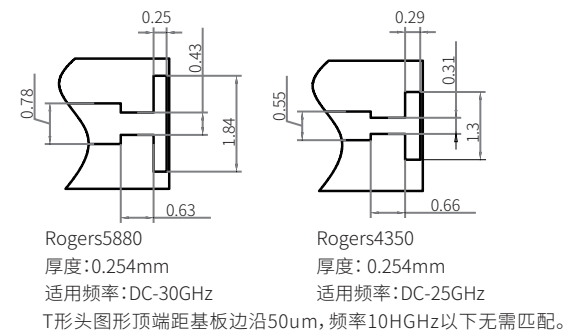


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10000-4500-10DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

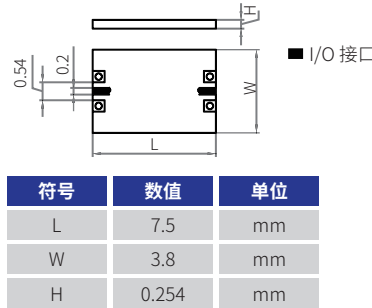
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

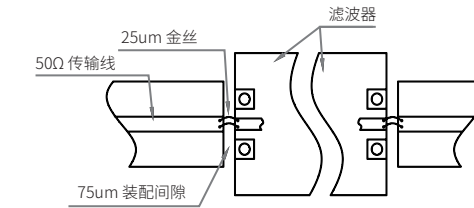
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10	-	GHz
通带频率	7.75	-	12.25	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@DC~6 GHz			
	≥45dB@14~24 GHz			

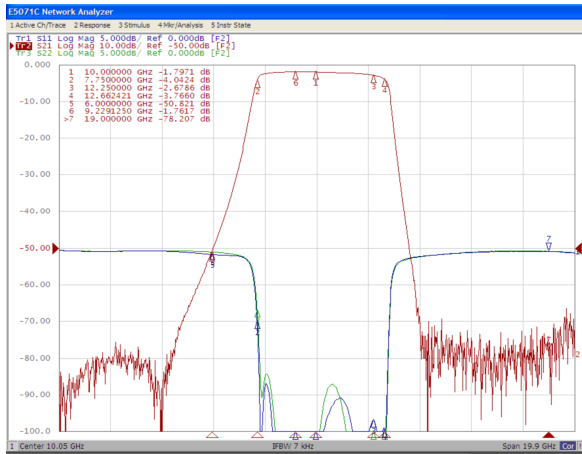
外形尺寸



建议装配图

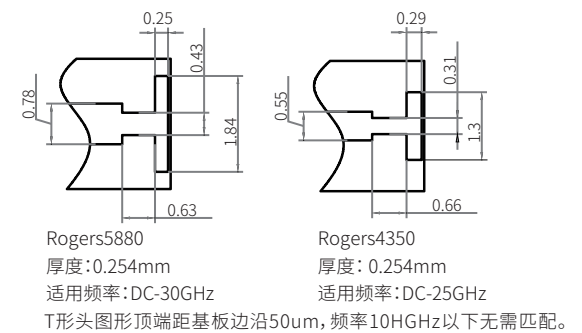


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10000-6000-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

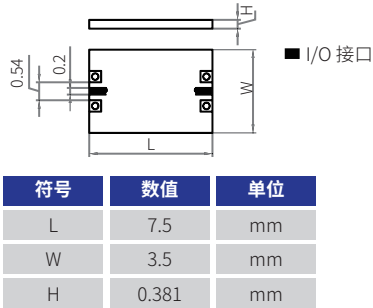
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

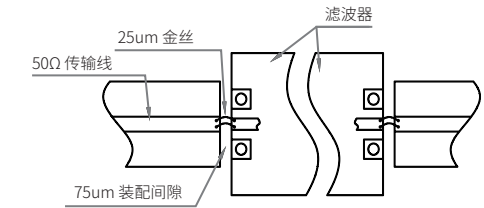
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10	-	GHz
通带频率	7	-	13	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	0.8	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@5GHz			
	≥35dB@16 GHz			

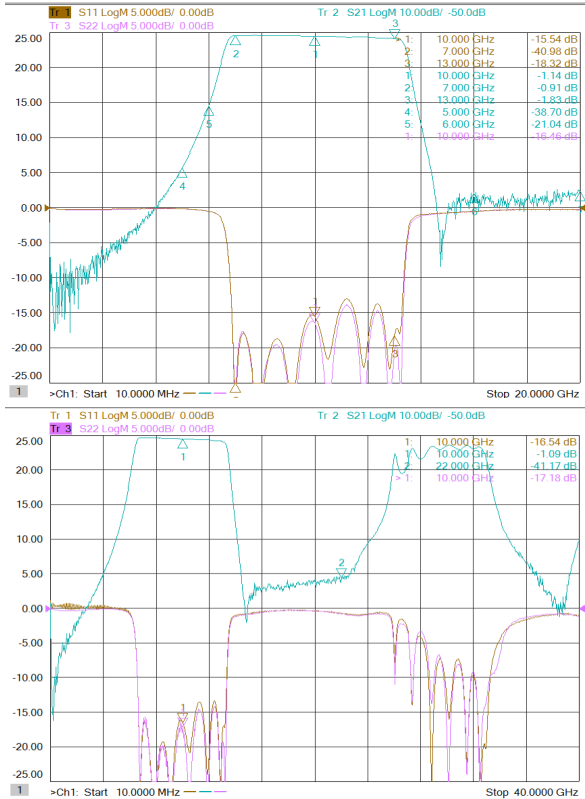
外形尺寸



建议装配图

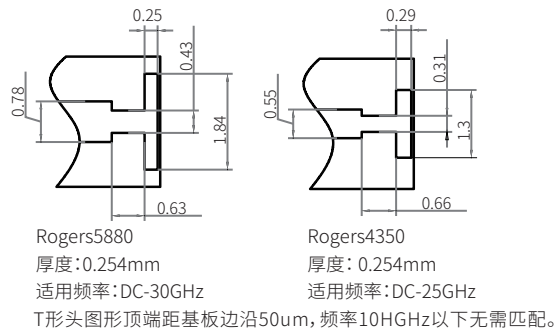


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10150-4900-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

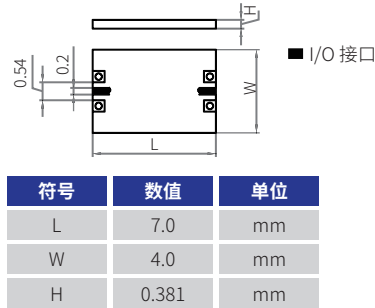
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

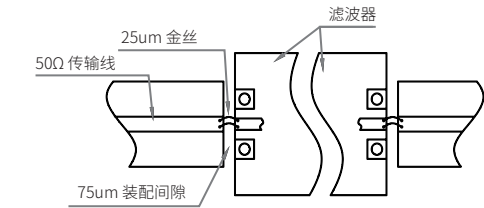
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10.15	-	GHz
通带频率	7.7	-	12.6	GHz
中心插损	-	1.8	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@4.8 GHz			
	≥45dB@15.6 GHz			

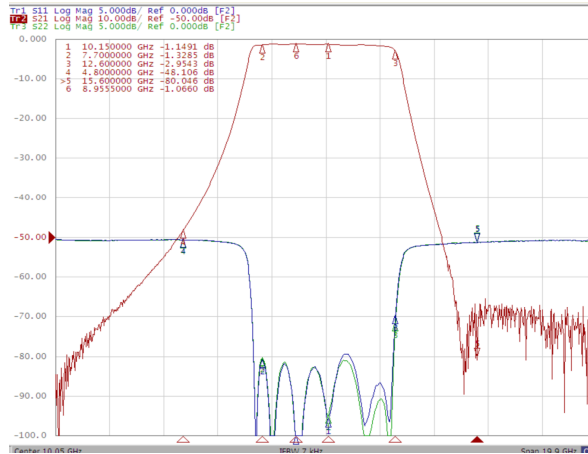
外形尺寸



建议装配图

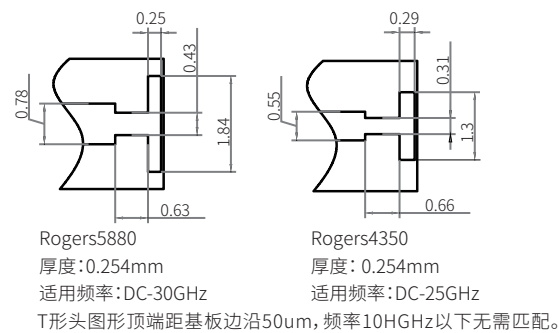


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10170-1020-9SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

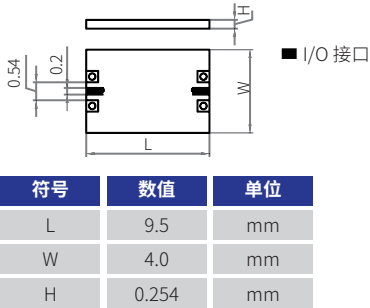
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

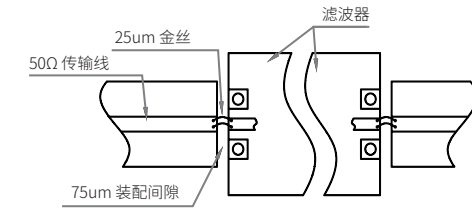
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10.17	-	GHz
通带频率	9.66	-	10.68	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@9.36 GHz			
	≥40dB@12.3 GHz			

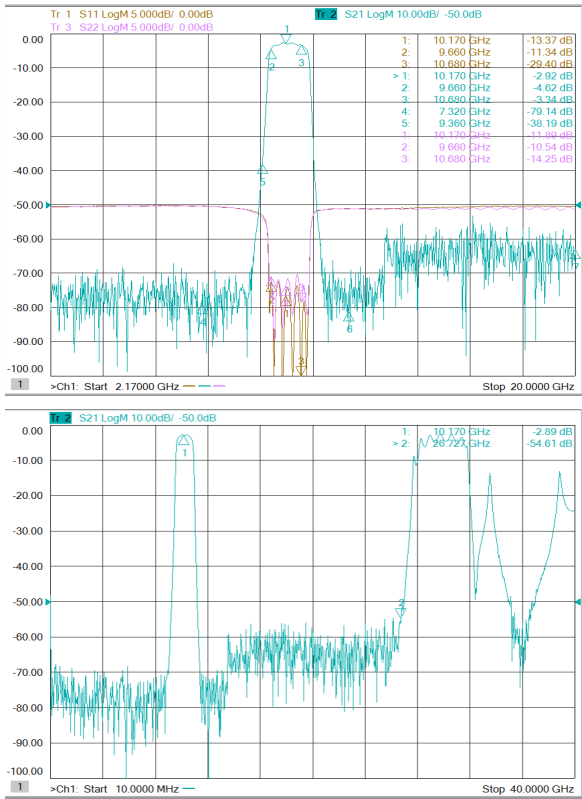
外形尺寸



建议装配图

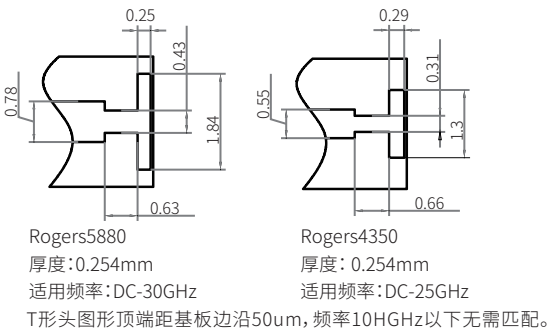


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10170A-1020-9SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

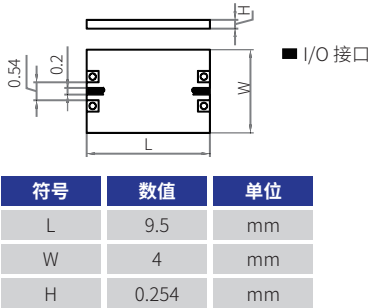
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

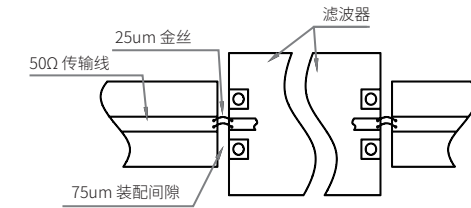
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10.17	-	GHz
通带频率	9.66	-	10.68	GHz
中心插损	-	3	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@8.7 GHz			
	≥40dB@11.65 GHz			

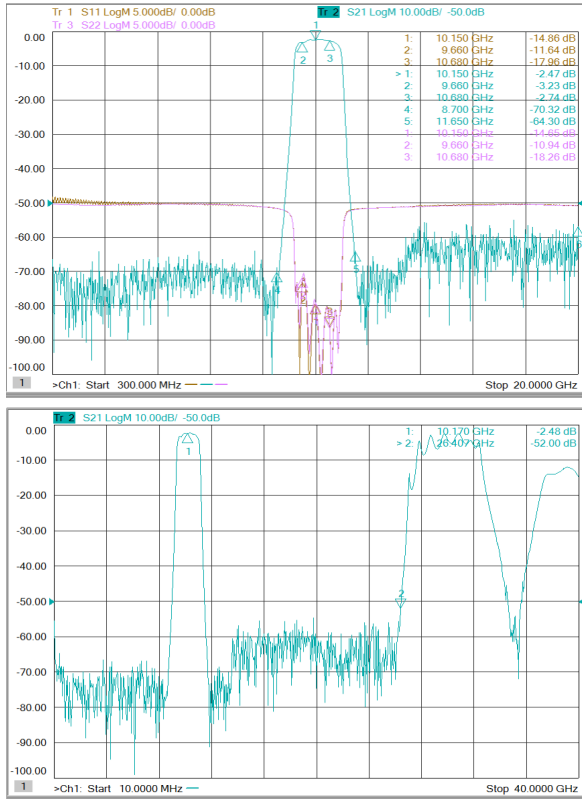
外形尺寸



建议装配图

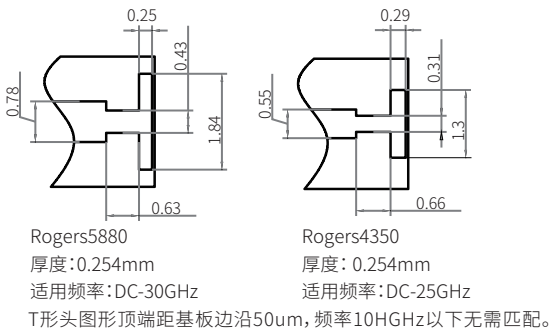


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10200-P-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

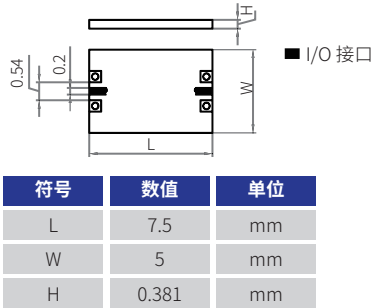
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

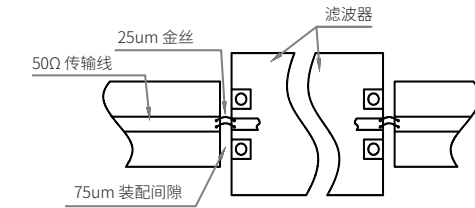
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10.2	-	GHz
通带频率	-	-	-	GHz
中心插损	-	3	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@9.24 GHz			
	≥50dB@11.16 GHz			

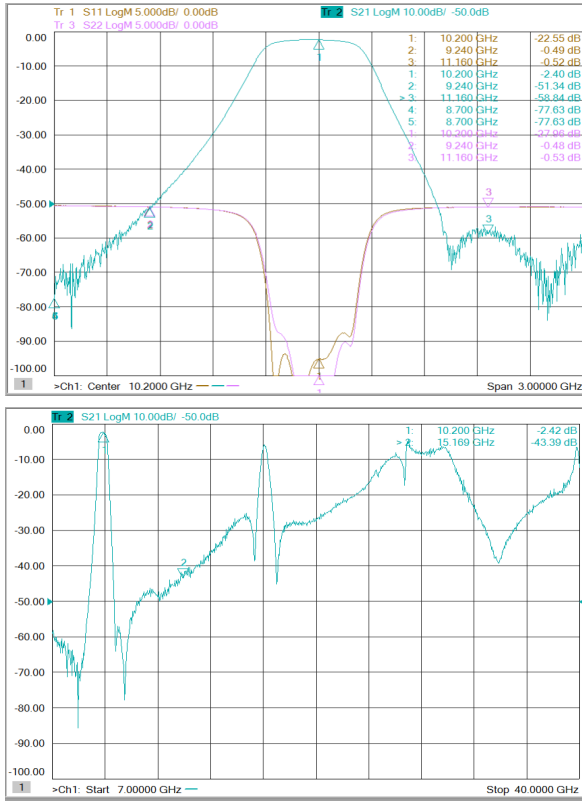
外形尺寸



建议装配图

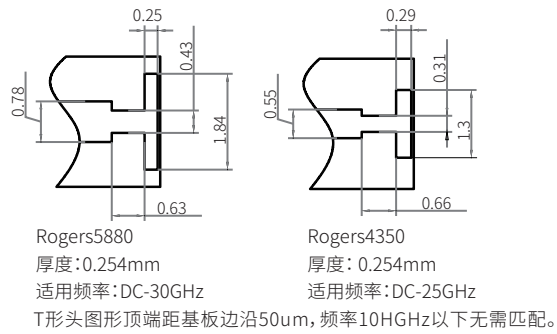


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10200-5000-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

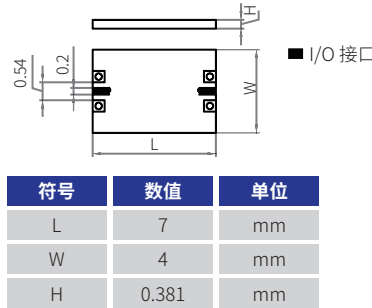
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

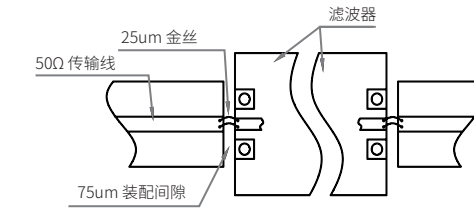
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10.2	-	GHz
通带频率	7.7	-	12.7	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@5.6 GHz			
	≥40dB@14.8 GHz			

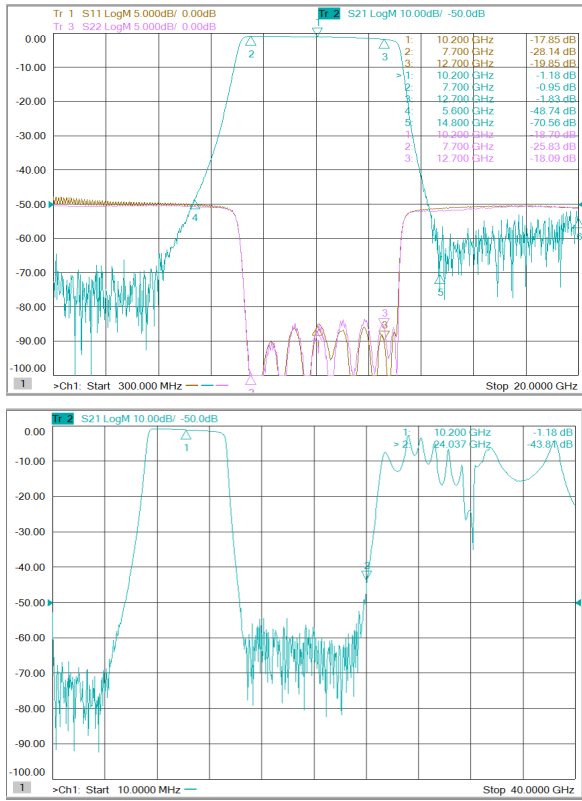
外形尺寸



建议装配图

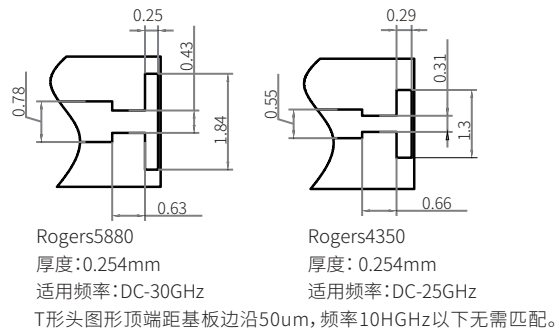


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP10920-P-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

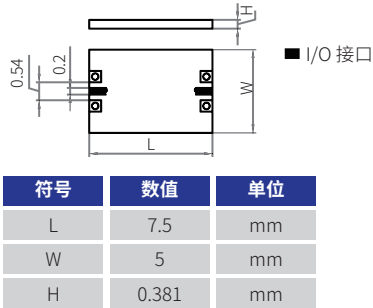
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

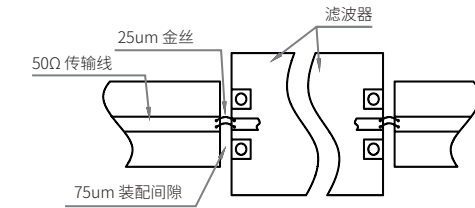
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	10.92	-	GHz
通带频率	-	-	-	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@9.94 GHz			
	≥40dB@11.88 GHz			

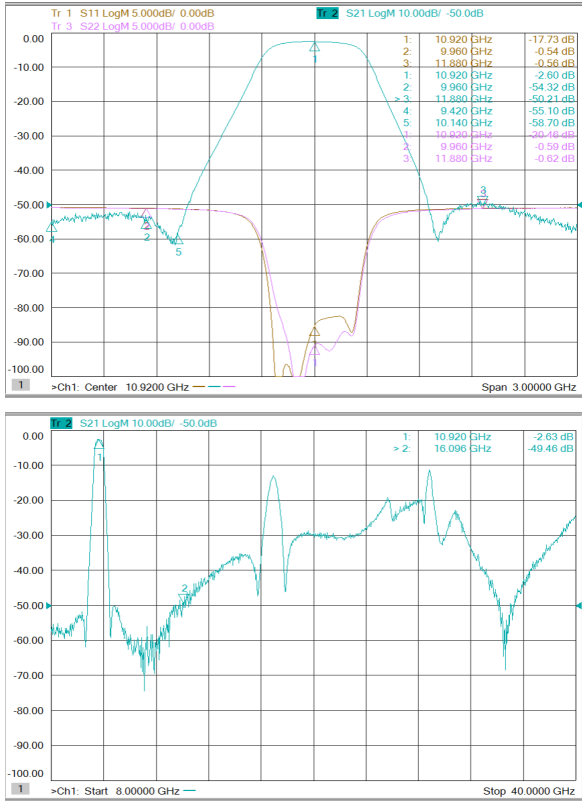
外形尺寸



建议装配图

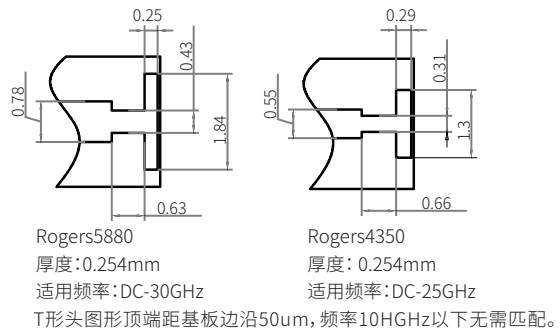


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP11000-2500-7DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

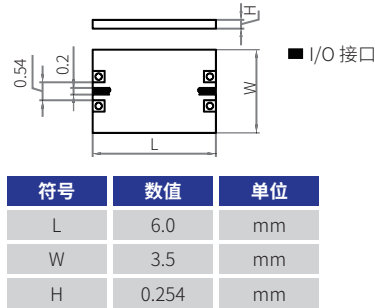
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

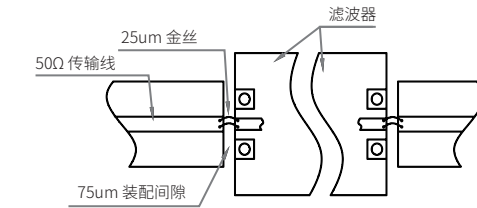
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	11	-	GHz
通带频率	9.75	-	12.25	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@7.8 GHz			
	≥40dB@14.2 GHz			

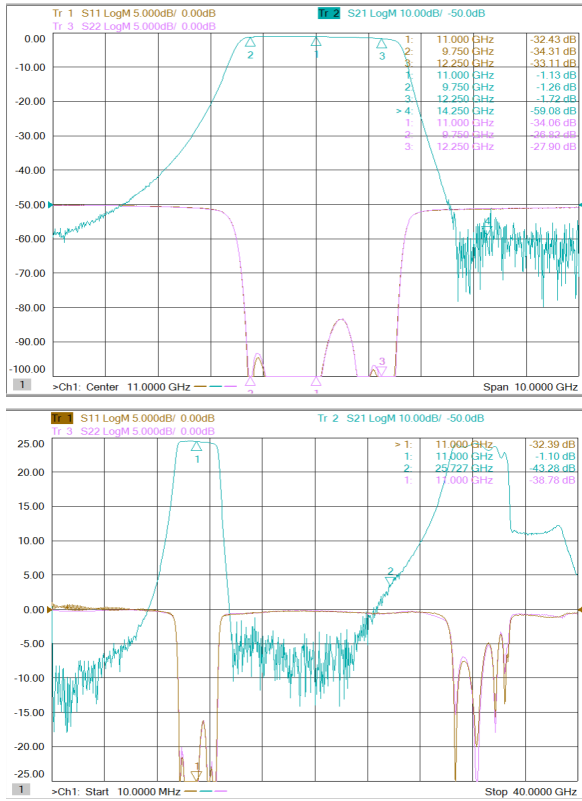
外形尺寸



建议装配图

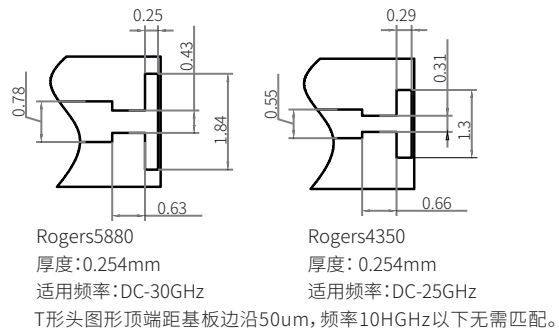


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP11000-6200-10DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

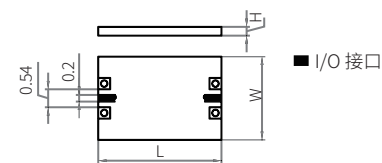
► 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

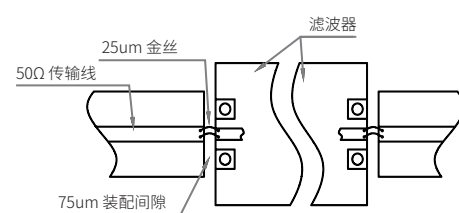
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	11	-	GHz
通带频率	7.9	-	14.1	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@4 GHz			
	≥40dB@16 GHz			

► 外形尺寸

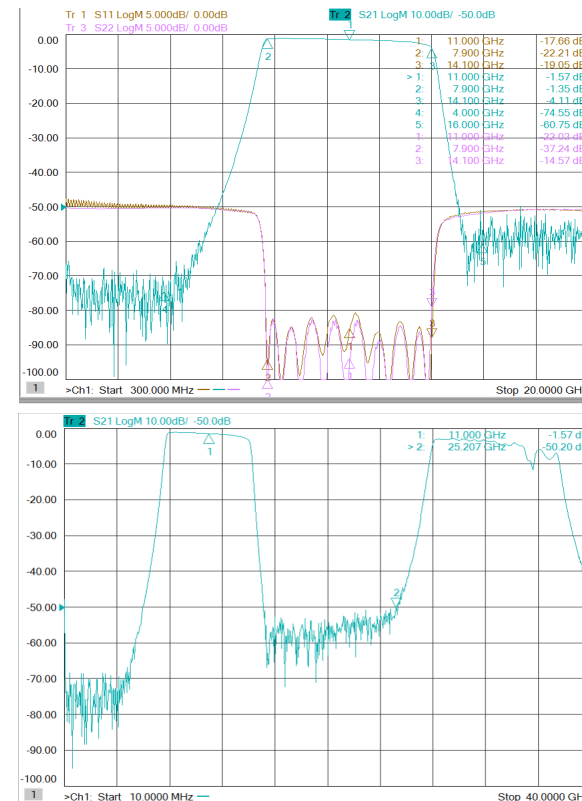


符号	数值	单位
L	9.0	mm
W	4.0	mm
H	0.381	mm

▶ 建议装配图

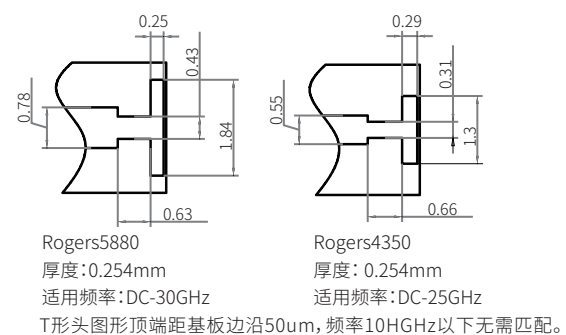


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP11200-400-7SA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

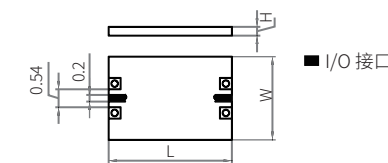
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

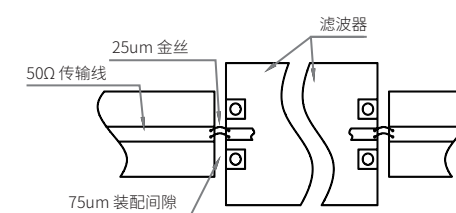
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	11.2	-	GHz
通带频率	10.9	-	11.5	GHz
中心插损	-	5.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@9.6 GHz			
	≥50dB@12.1 GHz			

► 外形尺寸

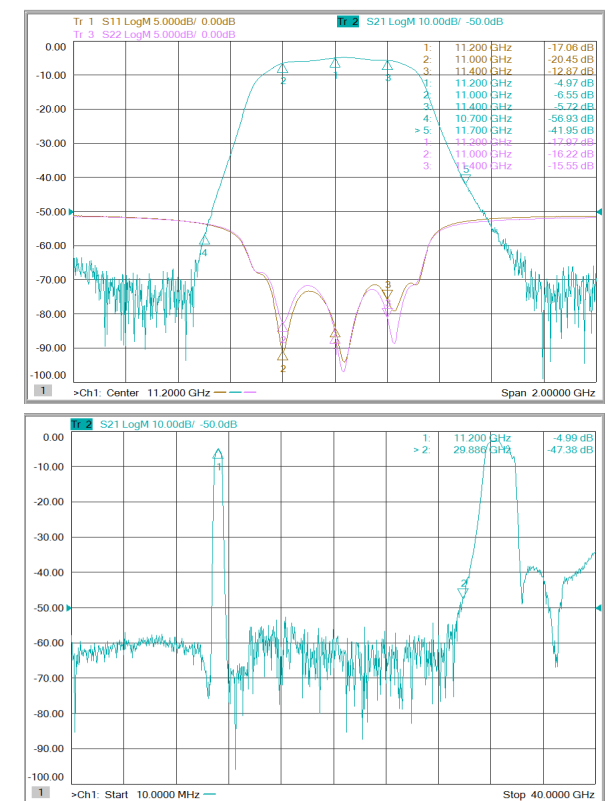


符号	数值	单位
L	7.5	mm
W	3.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

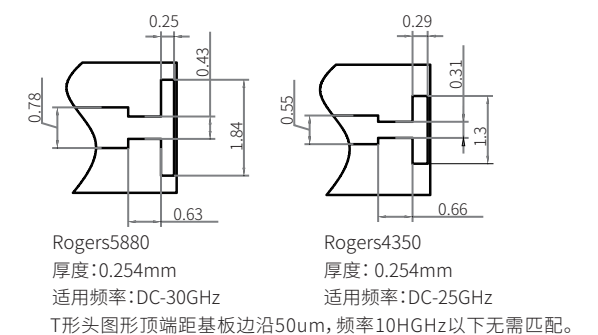


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP11300-1800-8JA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

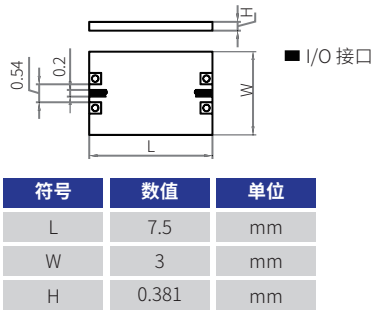
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

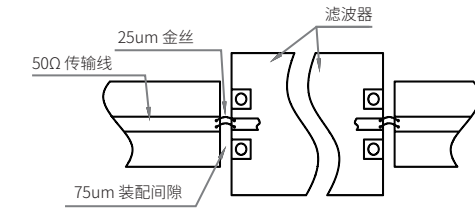
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	11.3	-	GHz
通带频率	10.4	-	12.2	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.7	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥20dB@9.8GHz			
	≥20dB@12.8 GHz			

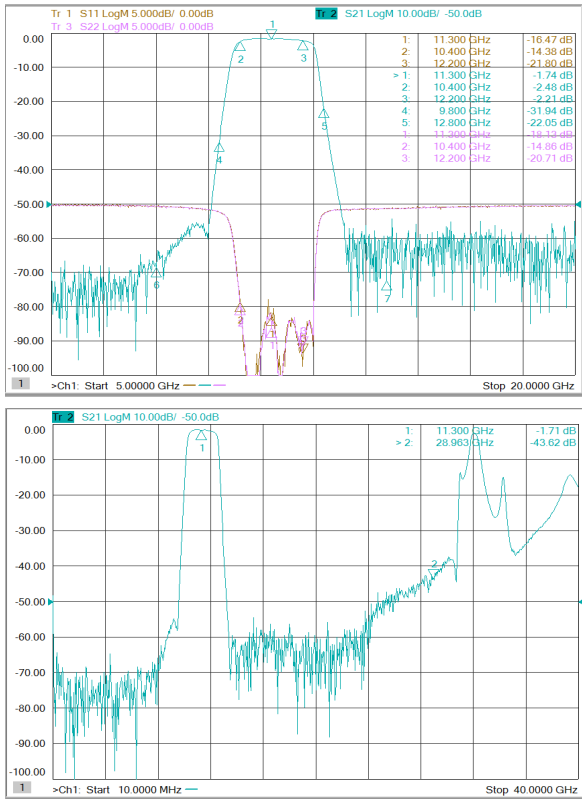
外形尺寸



建议装配图

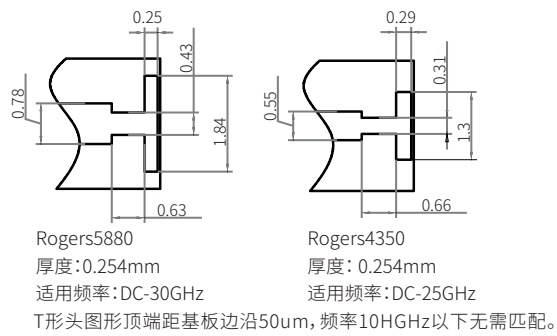


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP11400-2300-7

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

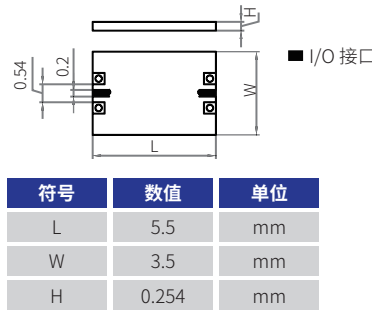
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

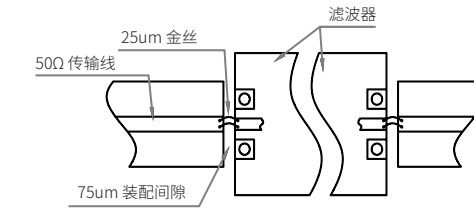
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	11.4	-	GHz
通带频率	10.2	-	12.6	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@8.8 GHz			
	≥40dB@13.85 GHz			

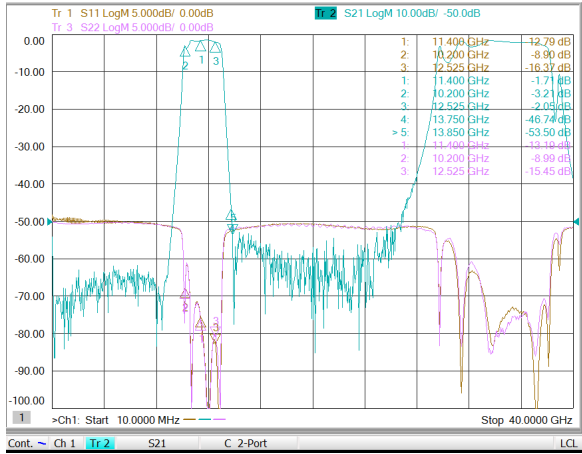
外形尺寸



建议装配图

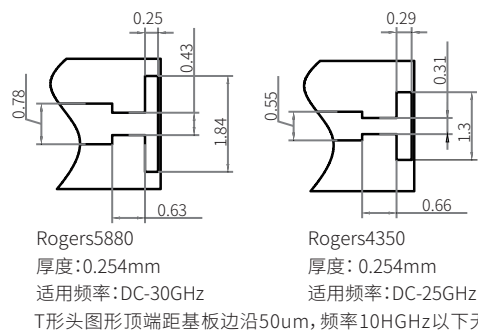


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP11600-100-5SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

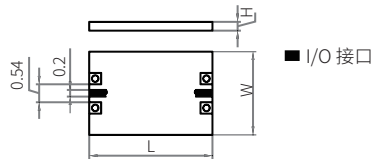
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

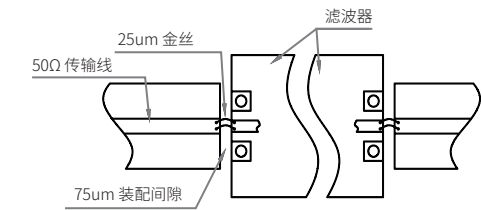
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	11.6	-	GHz
通带频率	11.55	-	11.6	GHz
中心插损	-	5.5	5	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	1.0	-
带外抑制	≥35dB@11 GHz			
	≥35dB@12.1 GHz			

外形尺寸

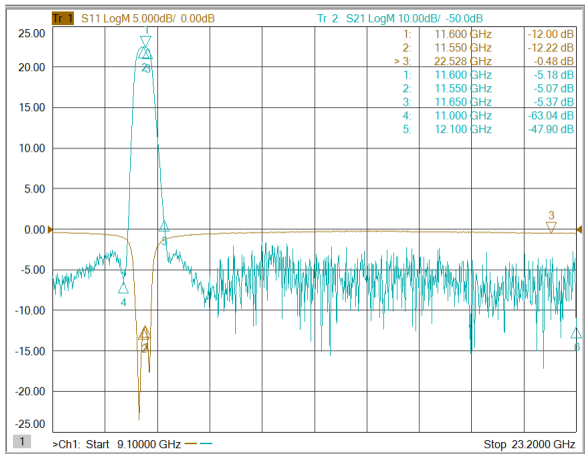


符号	数值	单位
L	5.5	mm
W	3.0	mm
H	0.254	mm

建议装配图

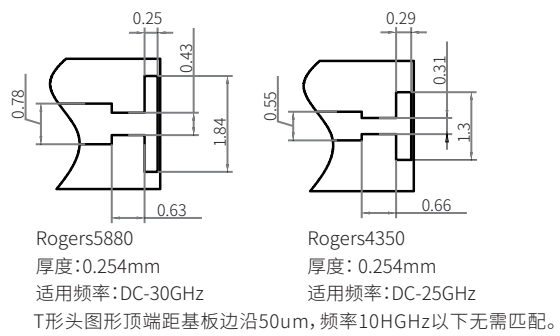


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP11860-200-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

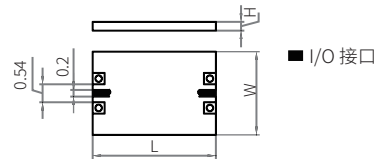
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

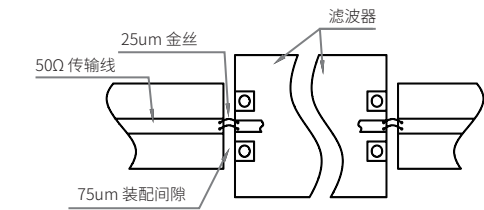
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	11.86	-	GHz
通带频率	11.76	-	11.96	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@10.92 GHz			
	≥50dB@12.8 GHz			

外形尺寸

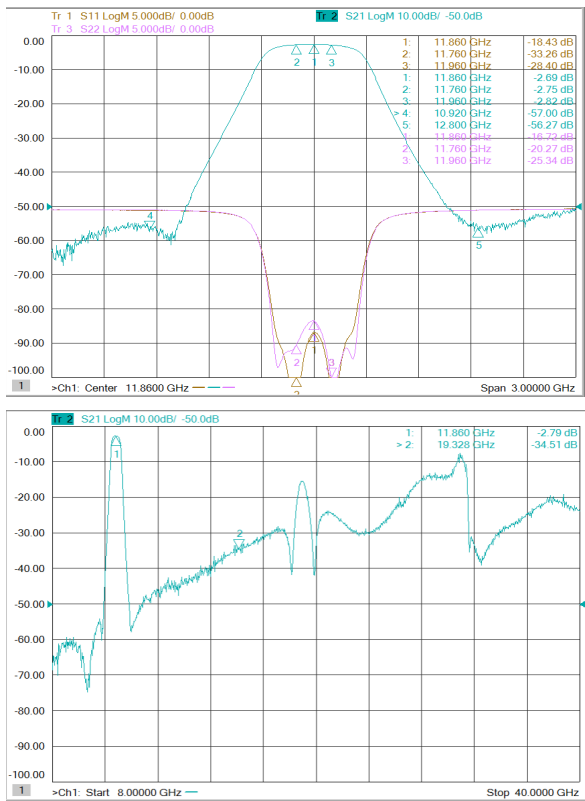


符号	数值	单位
L	7.5	mm
W	5	mm
H	0.381	mm

建议装配图

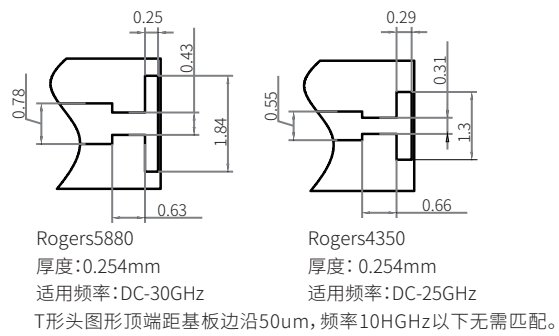


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP12000-3000-8JA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

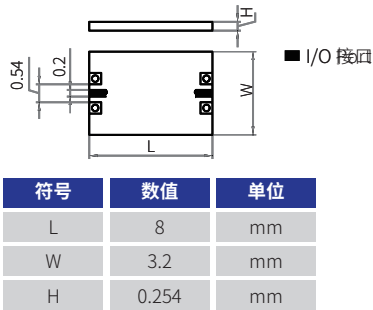
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

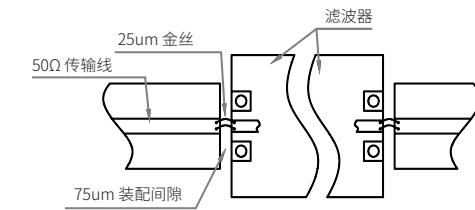
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	12	-	GHz
通带频率	10.5	-	13.5	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.5	-	-
带外抑制	≥35dB@9 GHz			
	≥40dB@15 GHz			

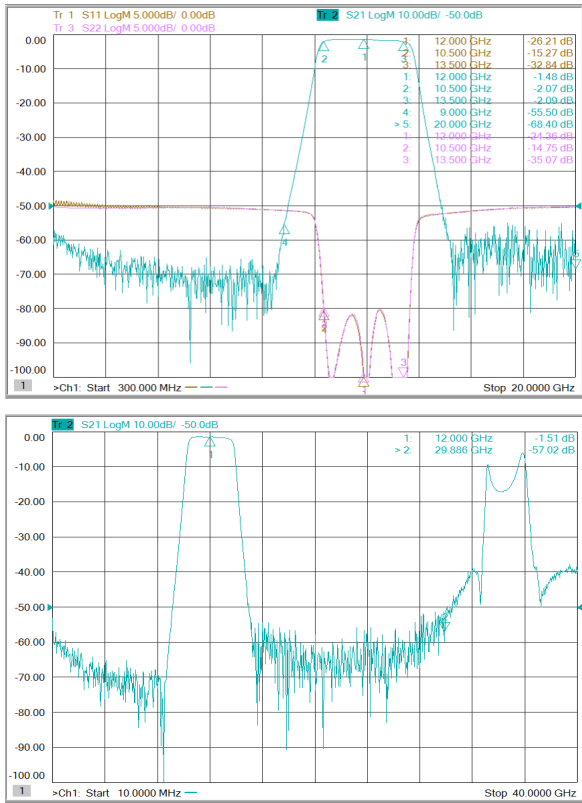
外形尺寸



建议装配图

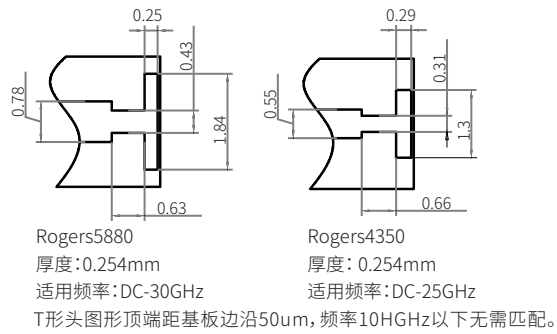


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP12000-4000-10DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

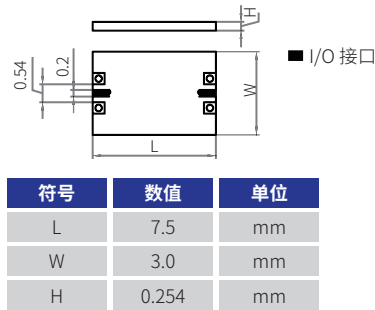
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

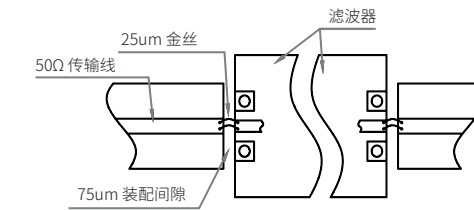
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	12	-	GHz
通带频率	9.8	-	14.2	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@5 GHz			
	≥60dB@20 GHz			

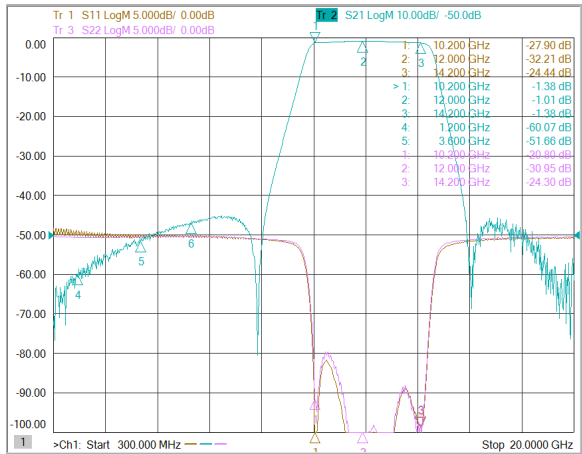
外形尺寸



建议装配图

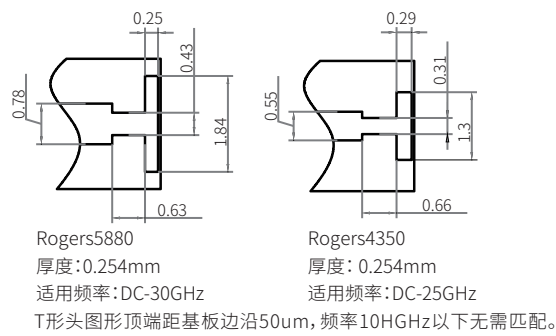


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP12400-2200-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

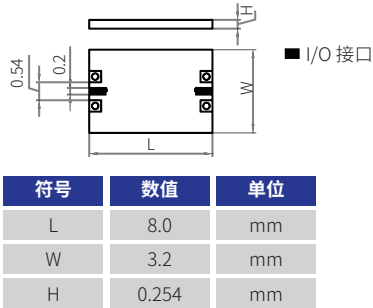
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

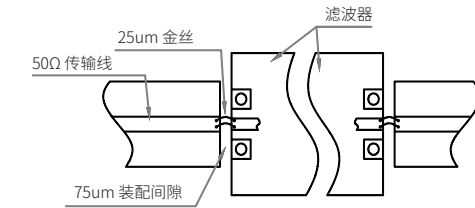
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	12.5	-	GHz
通带频率	11.3	-	13.5	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥35dB@DC~10 GHz			
	≥40dB@15~26.5 GHz			

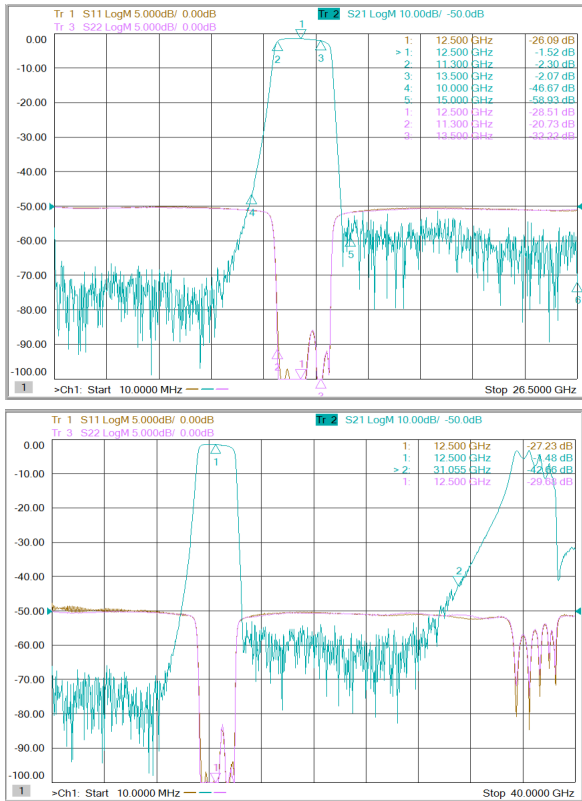
外形尺寸



建议装配图

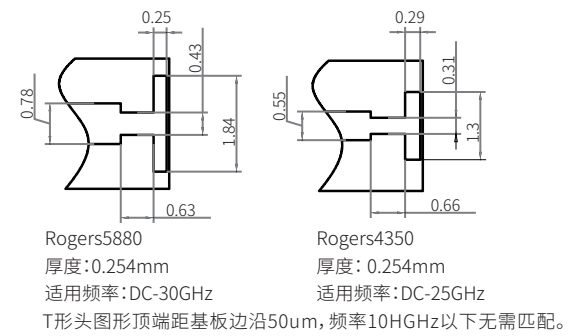


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP12450-4100-10A

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

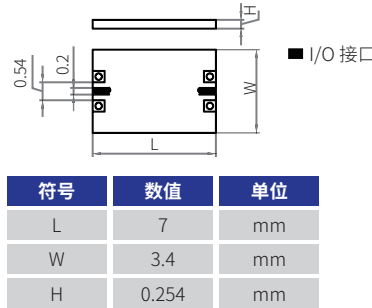
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

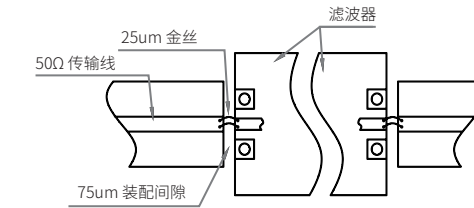
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	12.5	-	GHz
通带频率	10.75	-	14.25	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.3	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥47dB@9.458 GHz			
	≥46dB@15.9 GHz			

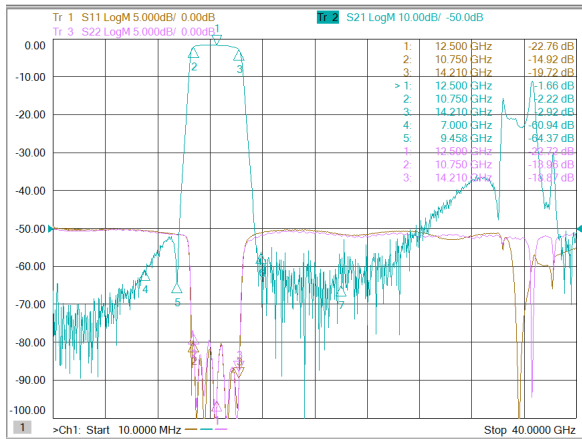
外形尺寸



建议装配图

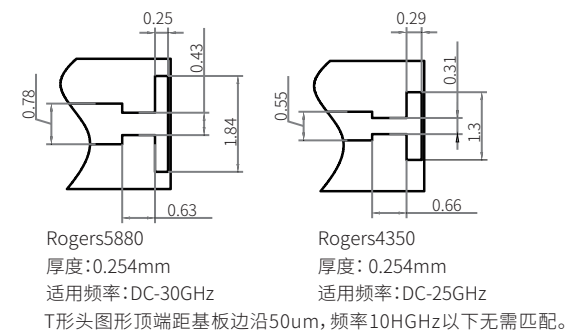


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP13000-1800-8JA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

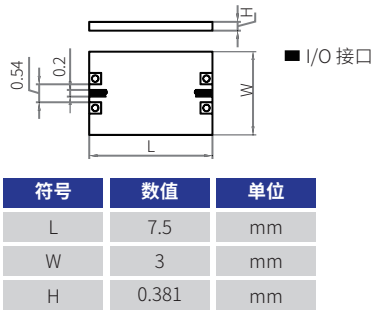
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

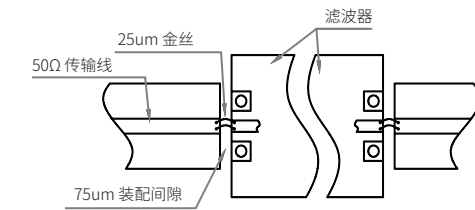
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	13	-	GHz
通带频率	12.1	-	13.9	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.7	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥20dB@11.5GHz			
	≥20dB@14.5GHz			

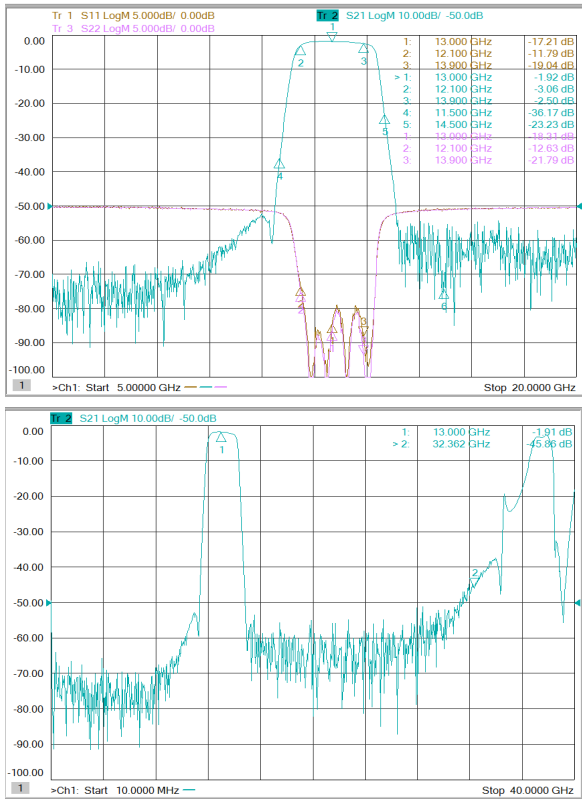
外形尺寸



建议装配图

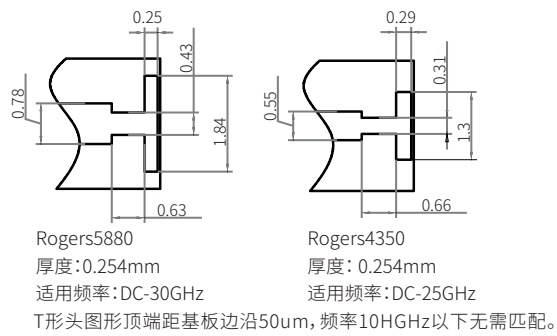


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP13000-2500-7DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

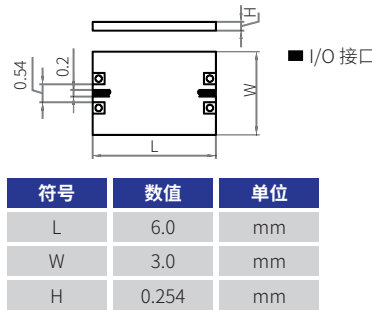
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

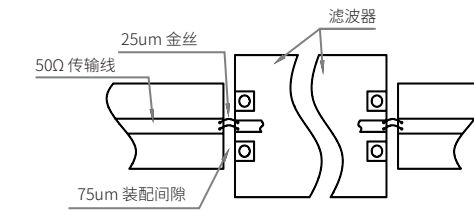
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	13	-	GHz
通带频率	11.75	-	14.2	GHz
中心插损	-	2.0	5	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	1.2	-
带外抑制	≥40dB@9.8 GHz			
	≥40dB@16.2 GHz			

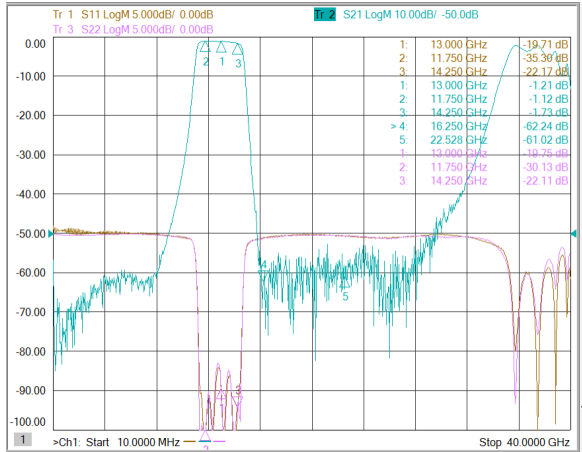
外形尺寸



建议装配图

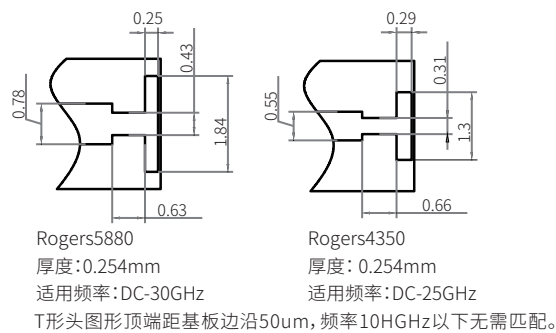


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP13000-4000-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

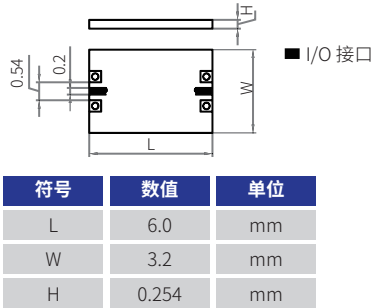
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

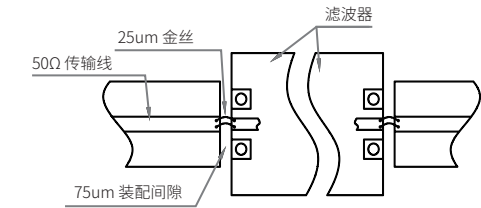
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	13	-	GHz
通带频率	11	-	15	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@8.5 GHz			
	≥50dB@16.8 GHz			

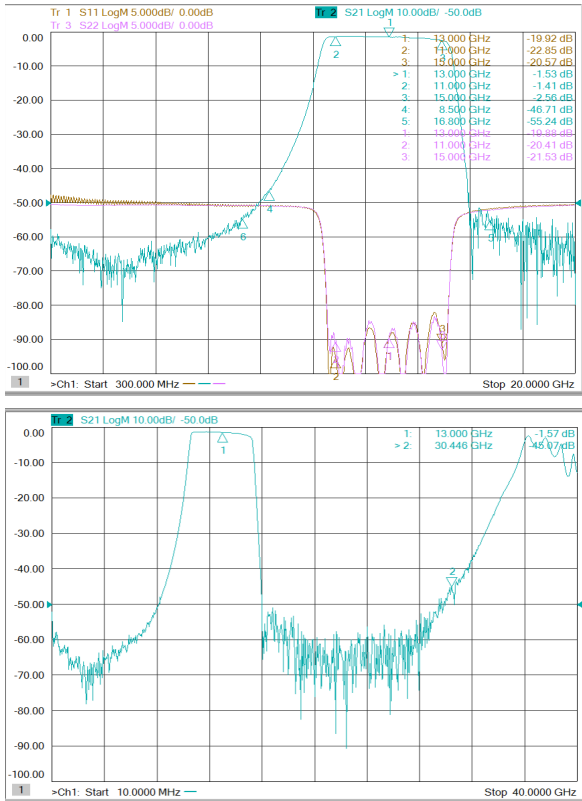
外形尺寸



建议装配图

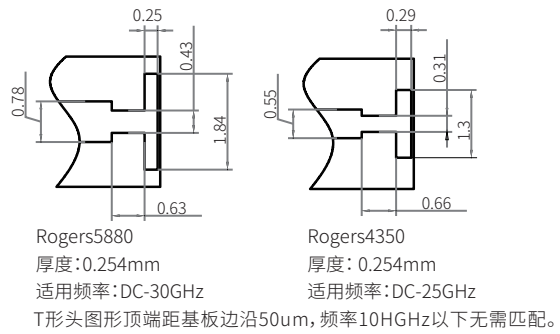


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP13325-2000-7SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

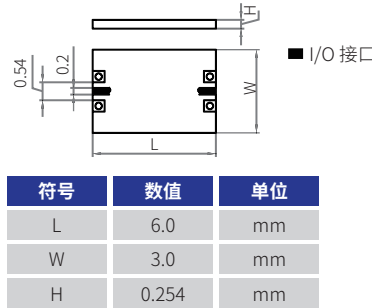
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

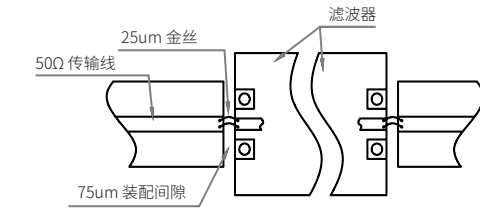
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	13.325	-	GHz
通带频率	13.225	-	13.425	GHz
中心插损	-	6.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@12.225 GHz			
	≥50dB@14.425 GHz			

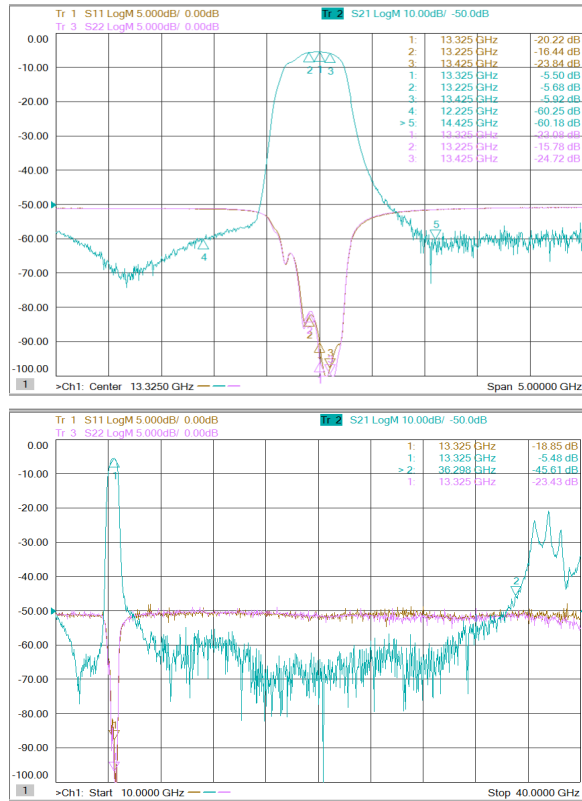
外形尺寸



建议装配图

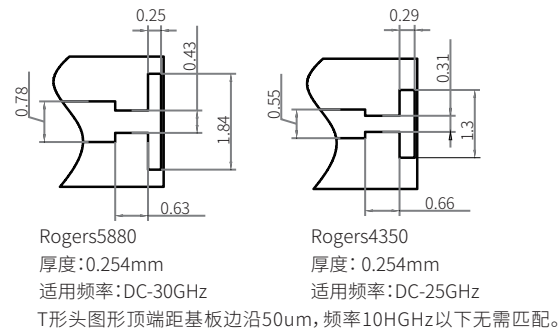


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP13500-400-7SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

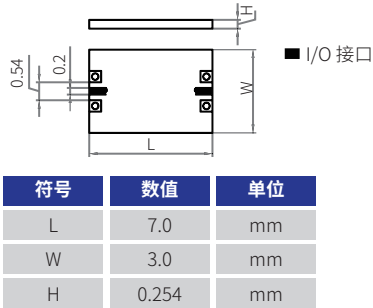
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

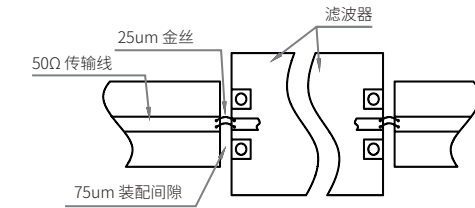
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	13	-	GHz
通带频率	13.1	-	13.7	GHz
中心插损	-	6.0	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥35dB@13 GHz			
	≥35dB@14 GHz			

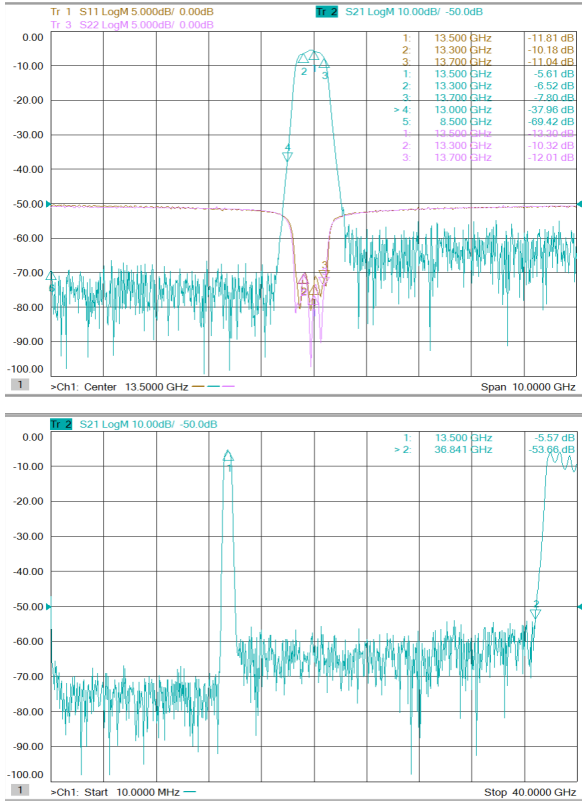
外形尺寸



建议装配图

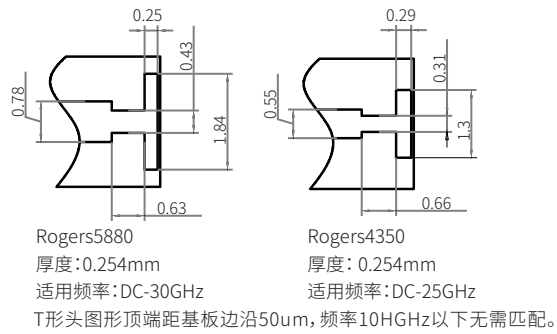


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP14250-3500-6DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

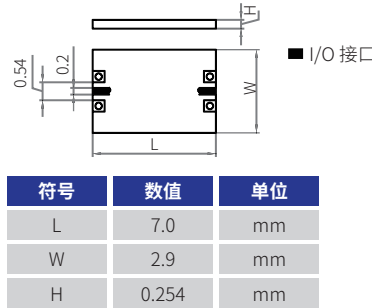
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

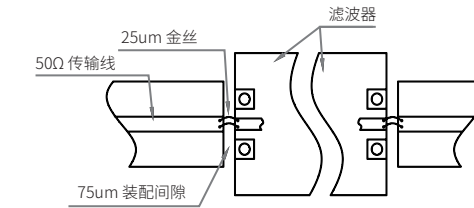
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	14.25	-	GHz
通带频率	12.5	-	16	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@4.8 GHz			
	≥45dB@15.6 GHz			

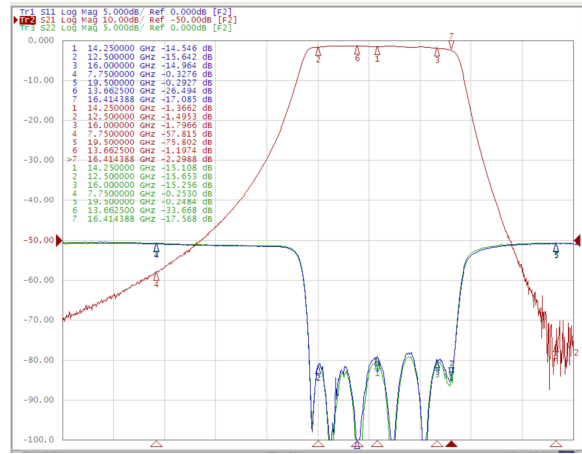
外形尺寸



建议装配图

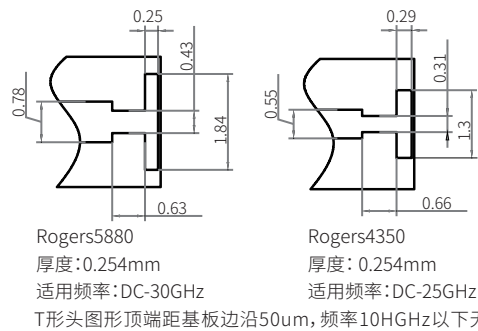


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP14400-20-6DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

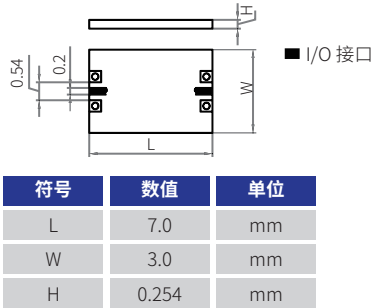
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

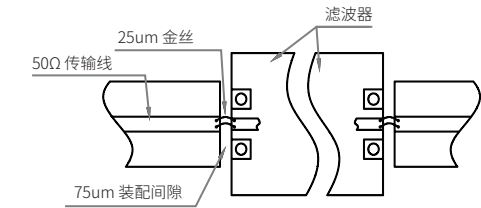
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	14.4	-	GHz
通带频率	14.39	-	14.41	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@10.8 GHz			
	≥40dB@18 GHz			

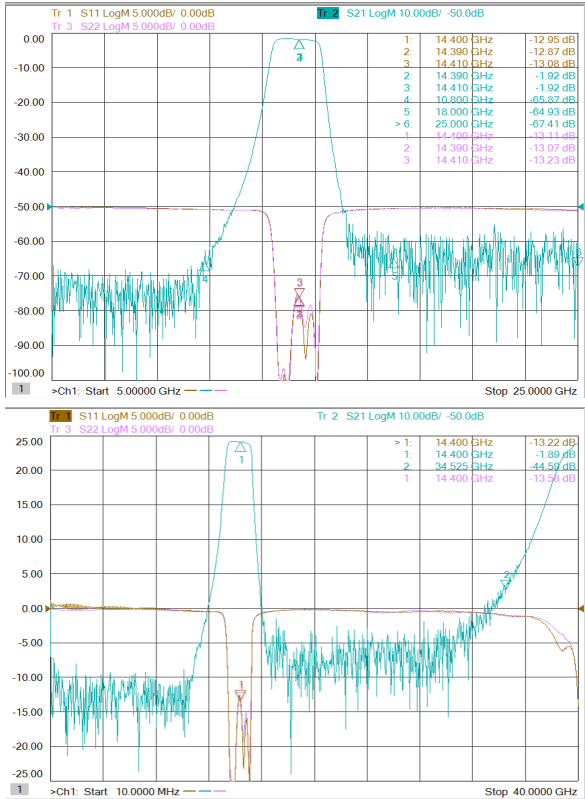
外形尺寸



建议装配图

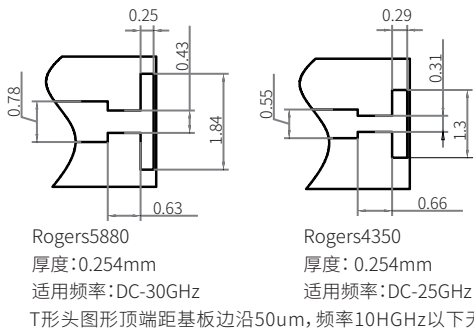


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP14450-900-8SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

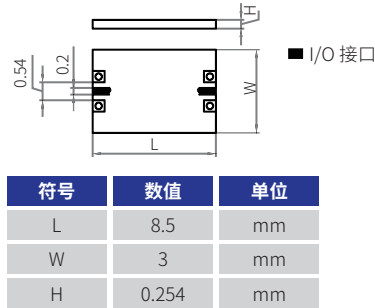
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

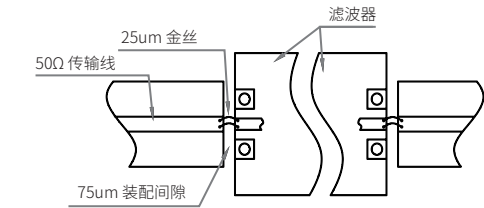
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	14.45	-	GHz
通带频率	14	-	14.9	GHz
中心插损	-	3	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@12.6 GHz			
	≥50dB@15.4 GHz			

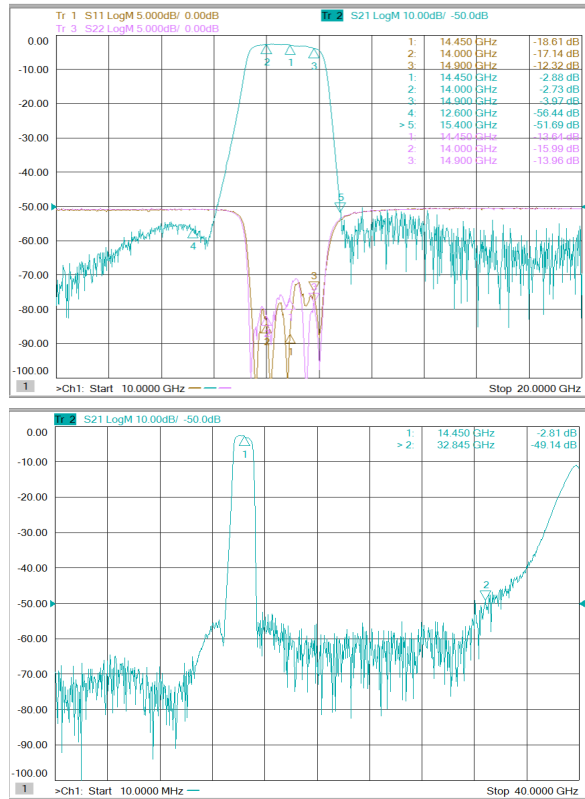
外形尺寸



建议装配图

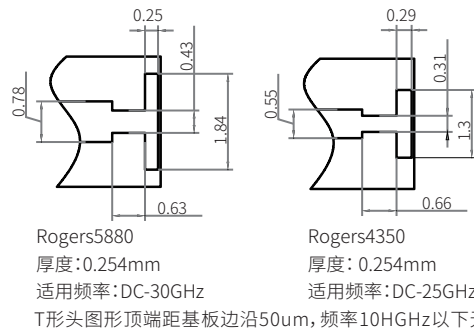


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP14500-7000-9DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

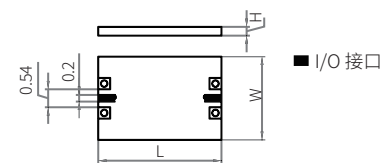
► 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

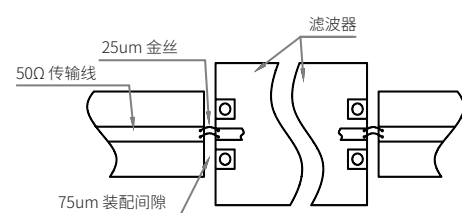
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	14.5	-	GHz
通带频率	11	-	18	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	0.8	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@8 GHz			
	≥35dB@22 GHz			

▶ 外形尺寸

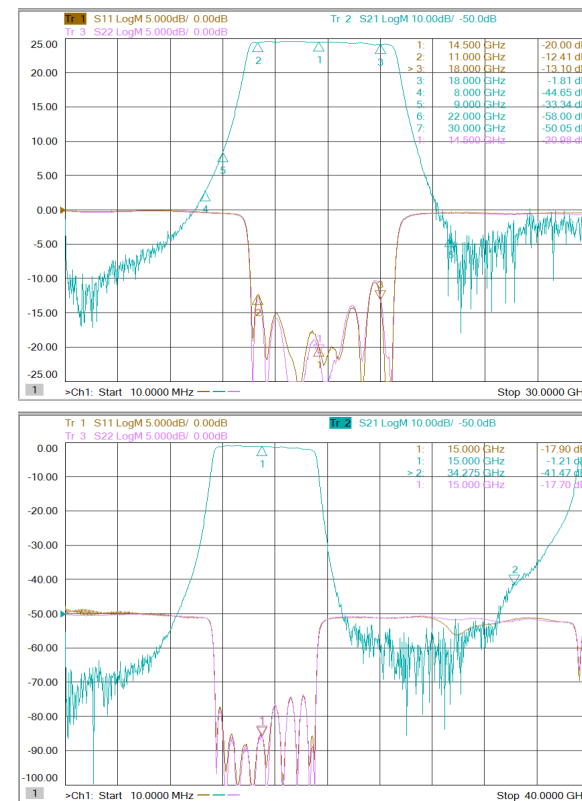


符号	数值	单位
L	7.5	mm
W	2.5	mm
H	0.381	mm

▶ 建议装配图

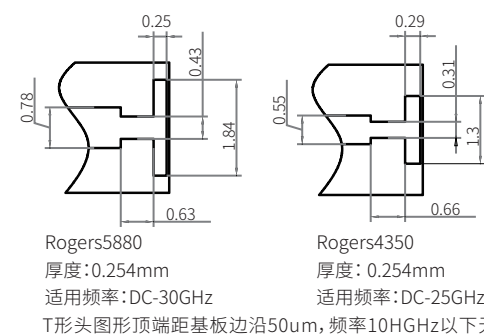


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP14700-1800-8JA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

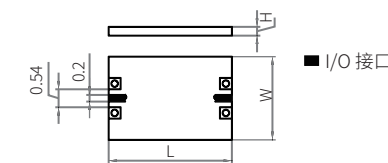
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

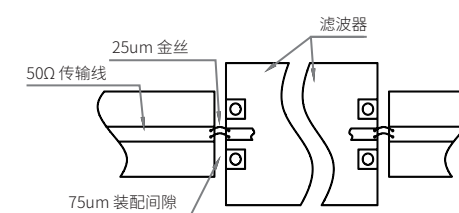
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	14.7	-	GHz
通带频率	13.8	-	15.6	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.7	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥20dB@13.2 GHz			
	≥20dB@16.2 GHz			

► 外形尺寸

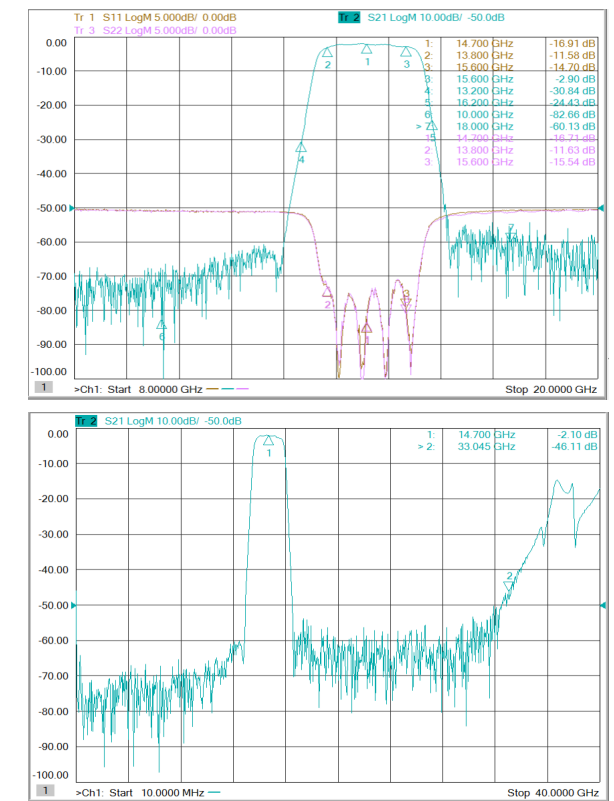


符号	数值	单位
L	7.5	mm
W	3	mm
H	0.381	mm

► 建议装配图

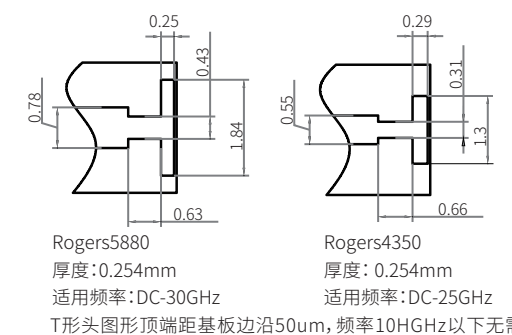


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP14750-2500-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω 共面波导输出

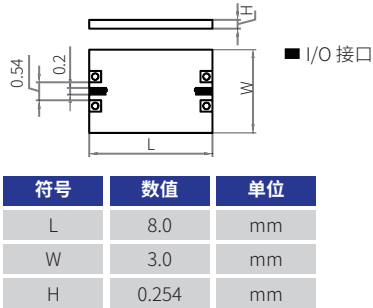
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

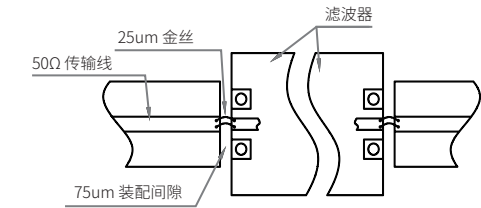
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	14.75	-	GHz
通带频率	13.5	-	16	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥30dB@12.5 GHz			
	≥30dB@17 GHz			

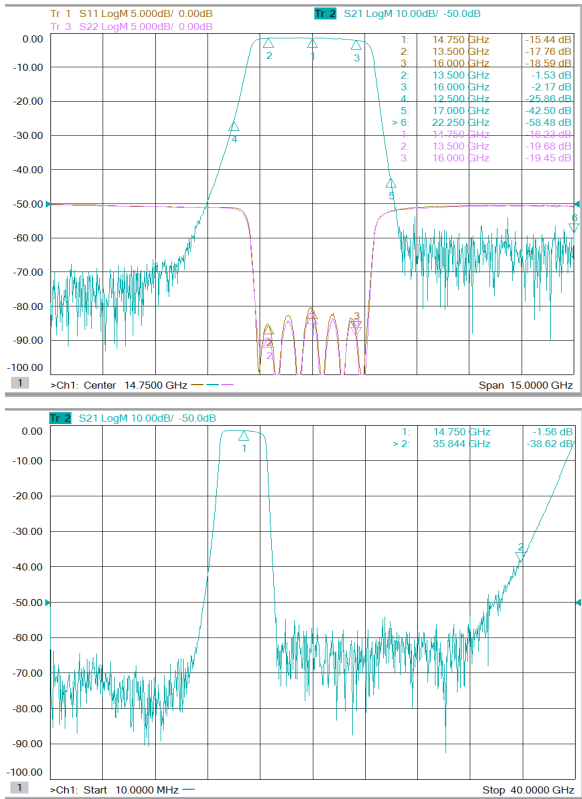
外形尺寸



建议装配图

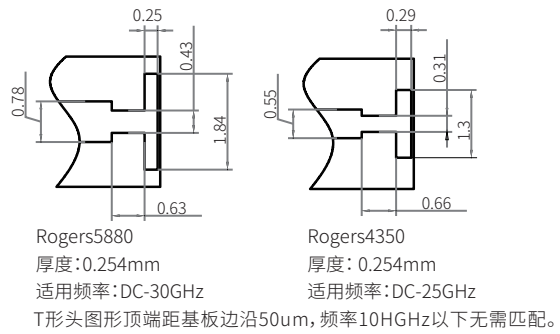


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP14900-1050-6SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω 共面波导输出

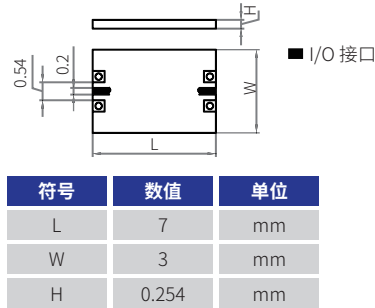
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

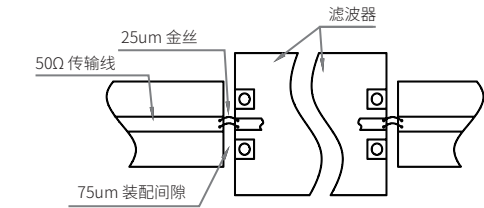
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	14.9	-	GHz
通带频率	14.4	-	15.45	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@13.2 GHz			
	≥40dB@16.85 GHz			

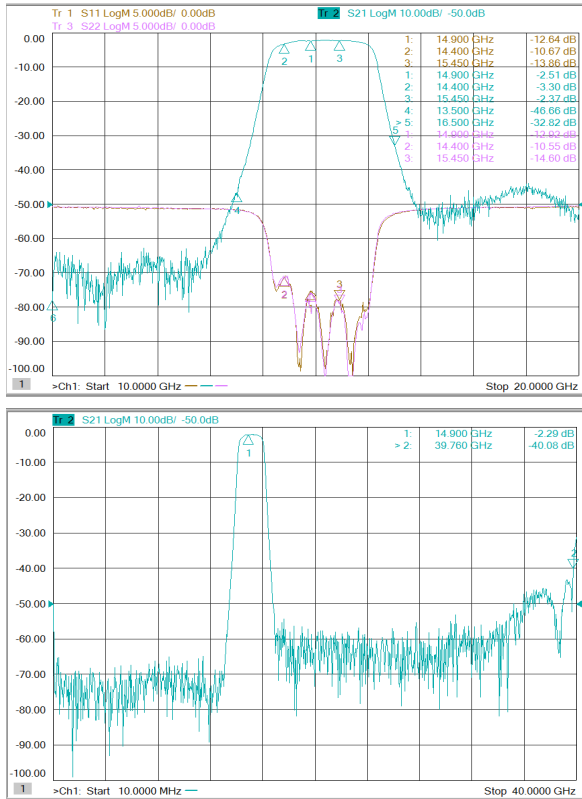
外形尺寸



建议装配图

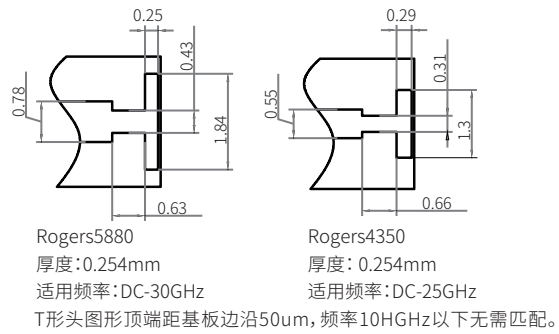


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP15000-2000-6DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

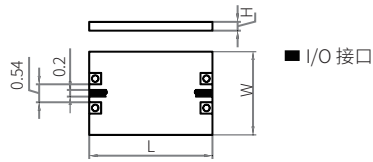
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

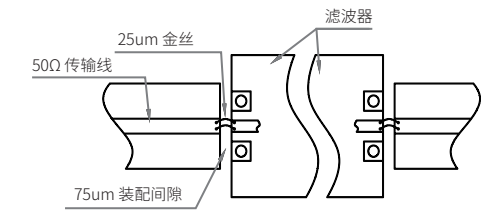
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	15	-	GHz
通带频率	14	-	16	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@7.5 GHz			
	≥50dB@22.5 GHz			

外形尺寸

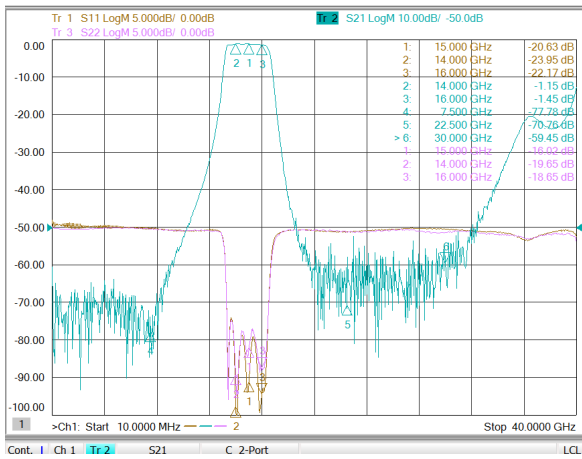


符号	数值	单位
L	7	mm
W	3	mm
H	0.254	mm

建议装配图

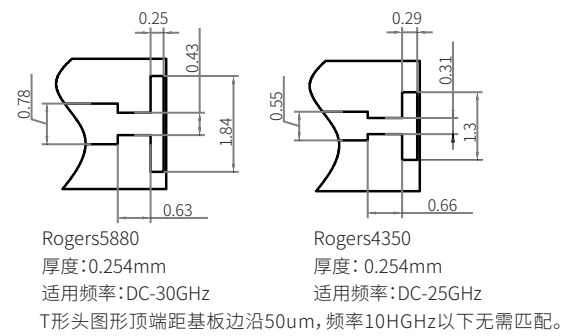


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下：



YZBP15000-2500-7DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

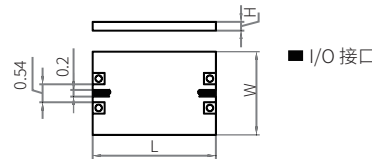
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

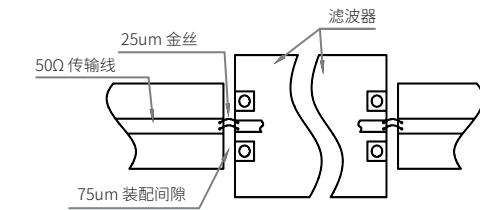
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	15	-	GHz
通带频率	13.75	-	16.25	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@11GHz			
	≥45dB@19 GHz			

外形尺寸

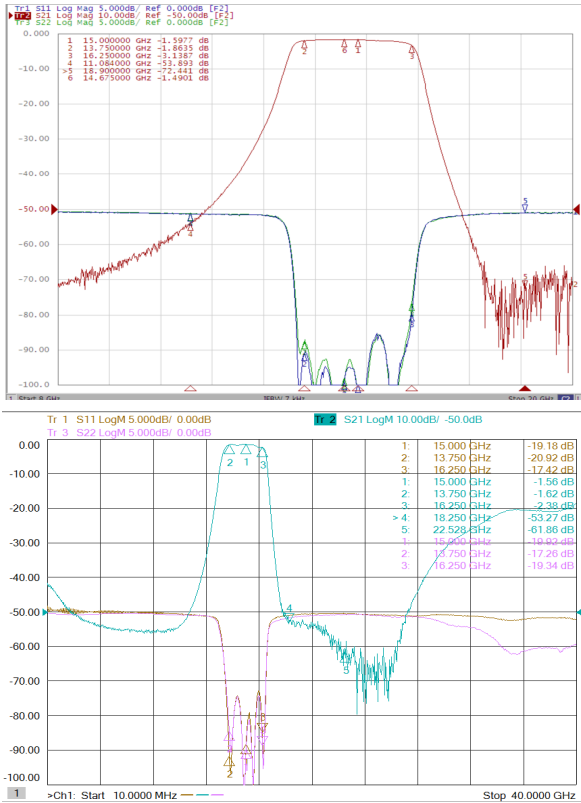


符号	数值	单位
L	7.0	mm
W	3.0	mm
H	0.254	mm

建议装配图

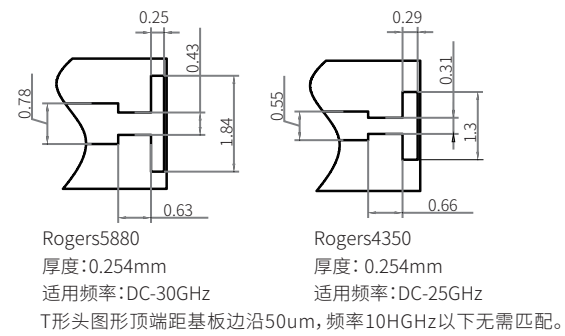


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下：



YZBP15000-6500-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

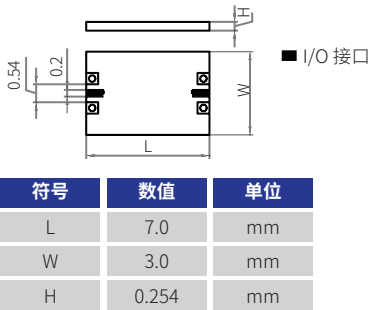
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

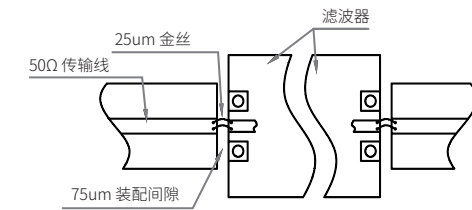
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	15	-	GHz
通带频率	11.75	-	18.25	GHz
中心插损	-	1.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@DC~8.2 GHz			
	≥60dB@21.5~28 GHz			

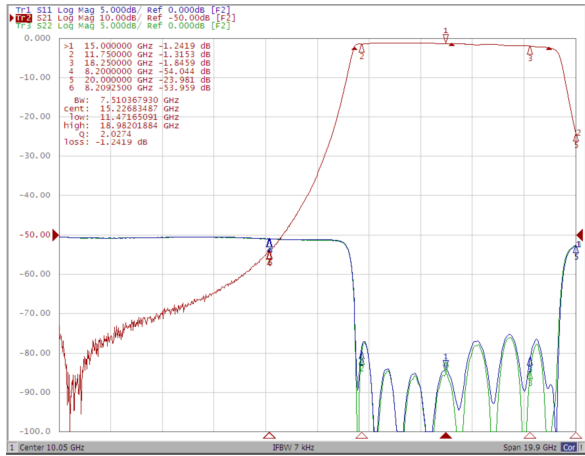
外形尺寸



建议装配图

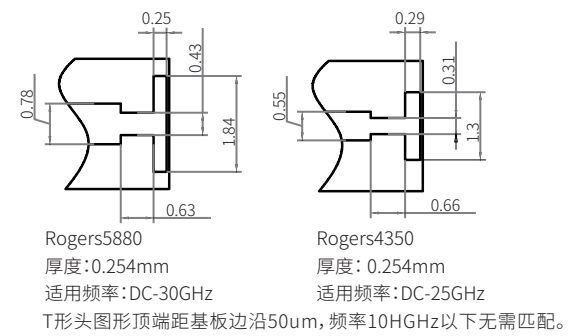


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上,载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时,建议微带线键合处采用T型结构进行匹配,T型头尺寸如下：



YZBP15500-3400-8SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

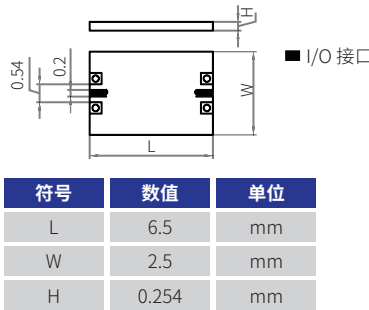
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

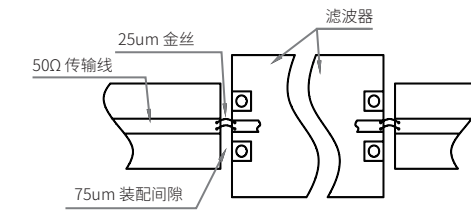
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	15.5	-	GHz
通带频率	13.8	-	17.2	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@9 GHz			
	≥60dB@21 GHz			

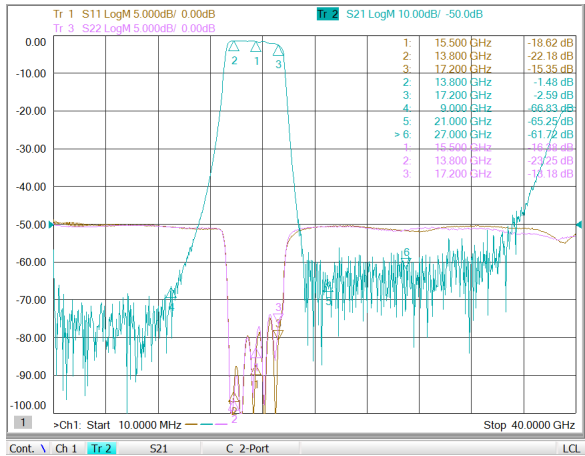
外形尺寸



建议装配图

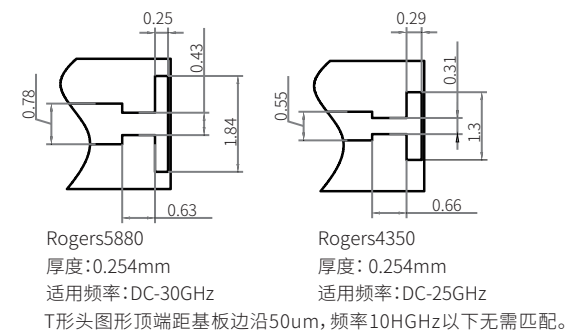


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上,载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时,建议微带线键合处采用T型结构进行匹配,T型头尺寸如下：



YZBP15750-4700-10DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

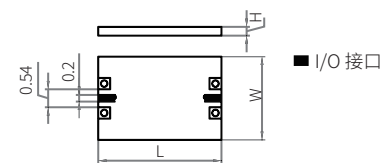
► 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

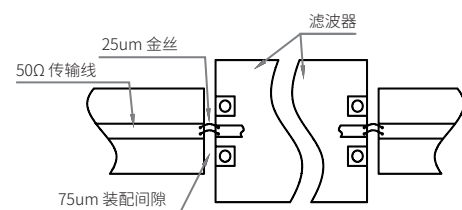
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	15.75	-	GHz
通带频率	13.5	-	18	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥55dB@9GHz			
	≥50dB@20.5 GHz			

► 外形尺寸

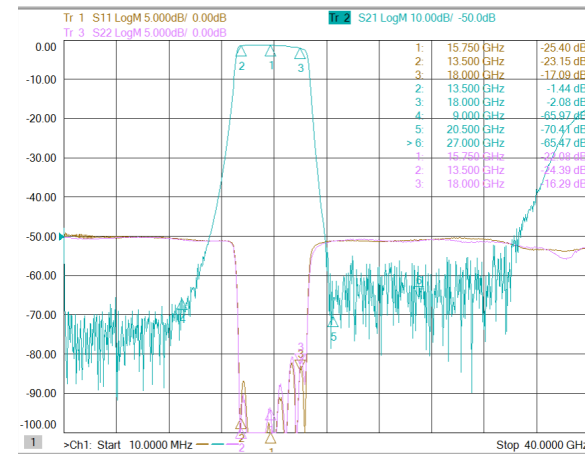


符号	数值	单位
L	7.0	mm
W	3.0	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

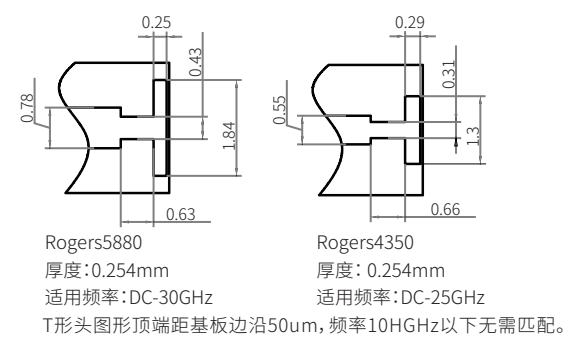


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP16000-4000-10DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

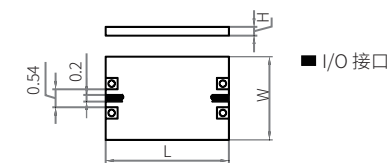
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

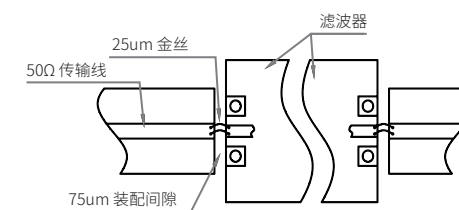
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	16.0	-	GHz
通带频率	14	-	18	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥20dB@13 GHz			
	≥20dB@19 GHz			

► 外形尺寸

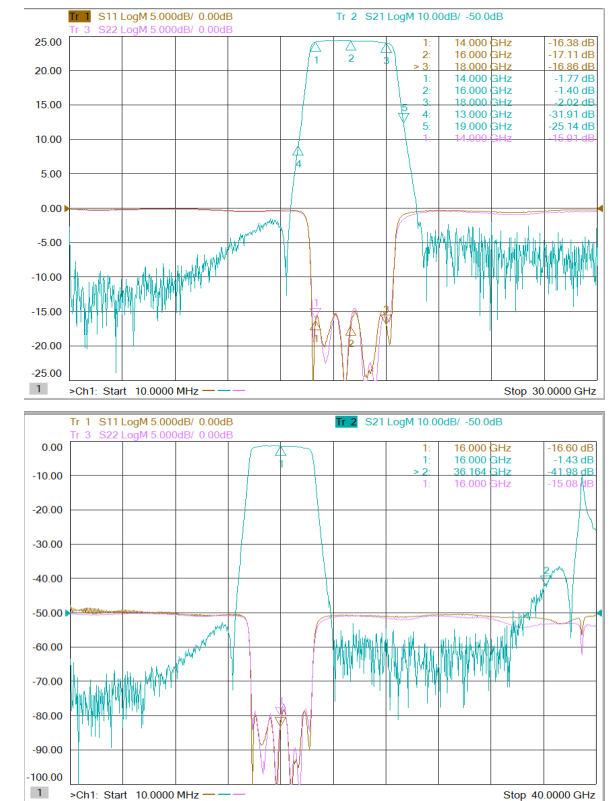


代号	数值	单位
L	8.0	mm
W	2.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

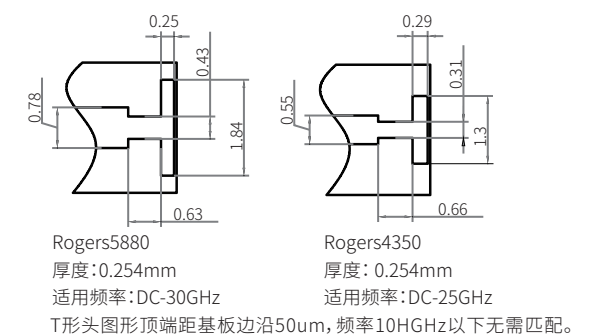


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP16155-980-8SA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

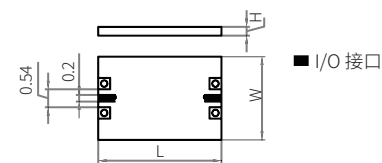
► 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

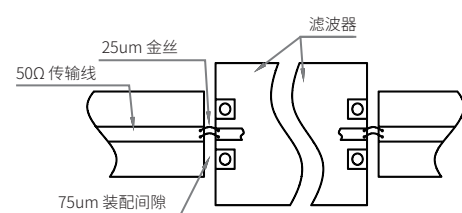
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	16.155	-	GHz
通带频率	15.71	-	16.69	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@14.9 GHz			
	≥40dB@17.4 GHz			

► 外形尺寸

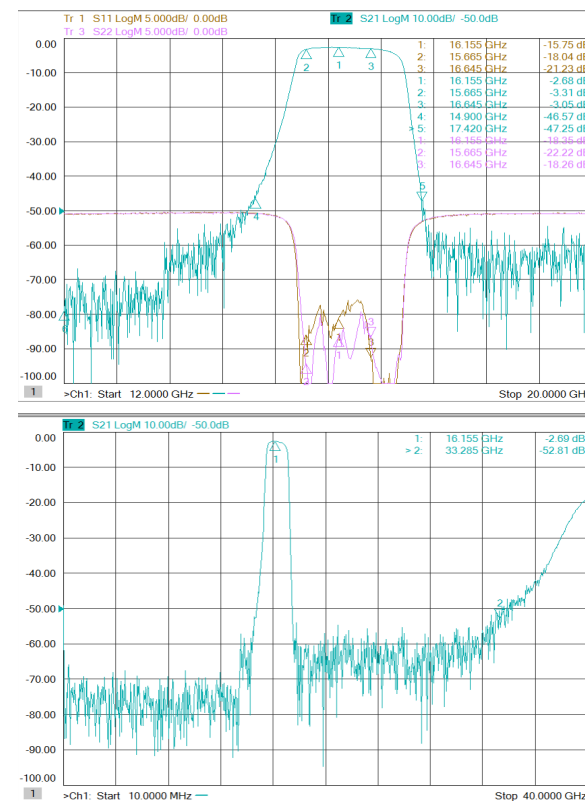


符号	数值	单位
L	8.5	mm
W	3	mm
H	0.254	mm

▶ 建议装配图

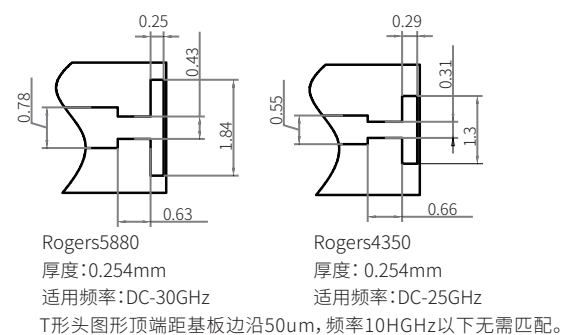


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP16500-3500-8DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

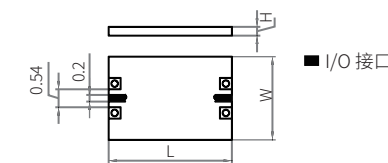
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

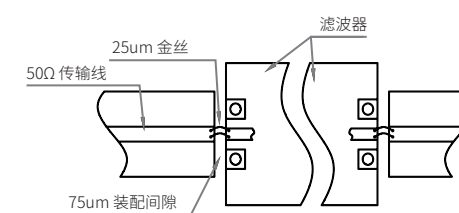
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	16.5	-	GHz
通带频率	14.75	-	18.25	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@11GHz			
	≥50dB@20.5 GHz			

► 外形尺寸

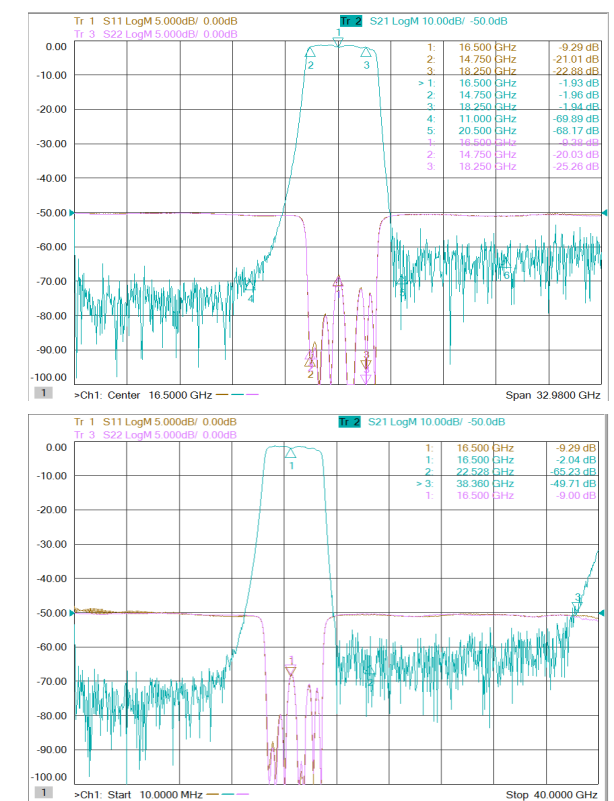


符号	数值	单位
L	8.0	mm
W	2.7	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

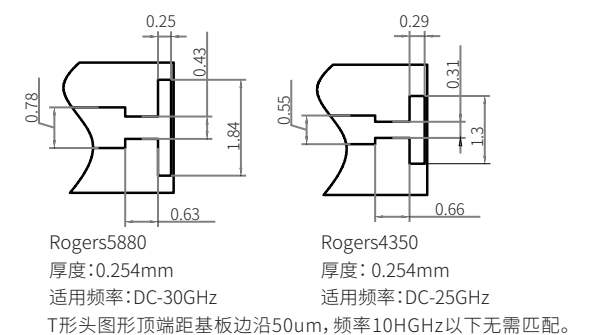


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP16500-7000-12DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

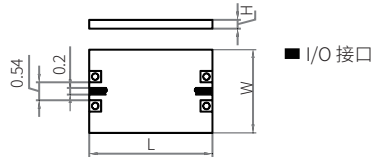
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

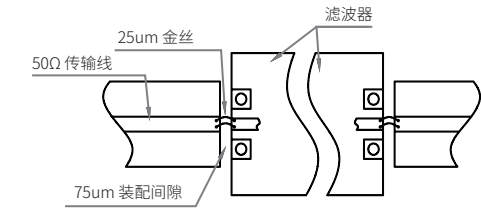
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	16.5	-	GHz
通带频率	13	-	20	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@10GHz			
	≥50dB@22.3 GHz			

外形尺寸

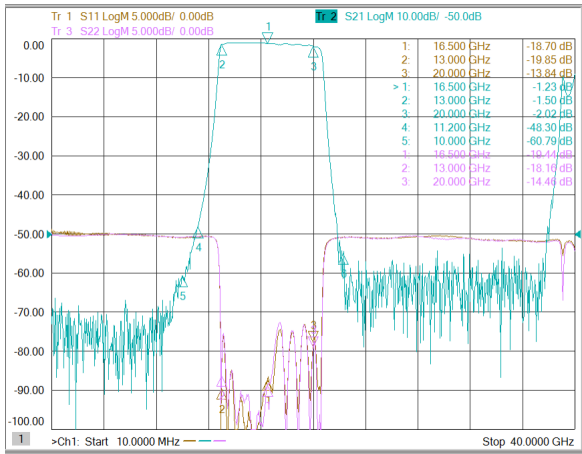


符号	数值	单位
L	9.5	mm
W	3	mm
H	0.381	mm

建议装配图

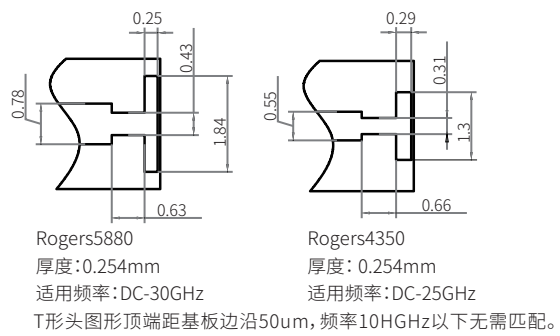


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP16650-4900-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

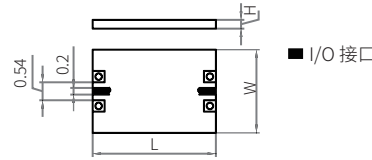
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

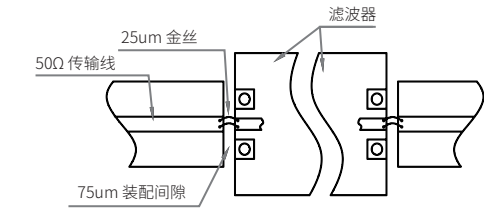
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	16.65	-	GHz
通带频率	14.3	-	19.1	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@11GHz			
	≥40dB@20.5 GHz			

外形尺寸

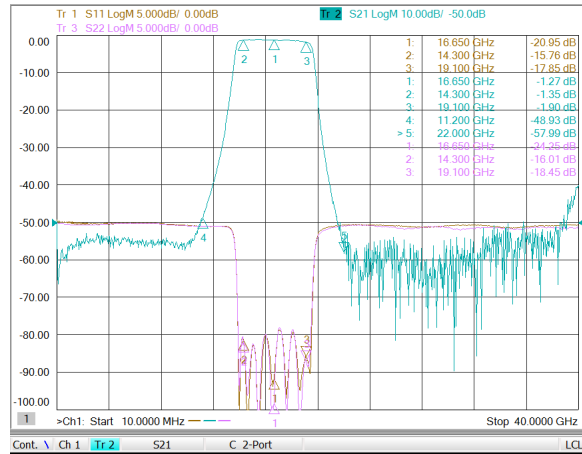


符号	数值	单位
L	6	mm
W	2.7	mm
H	0.254	mm

建议装配图

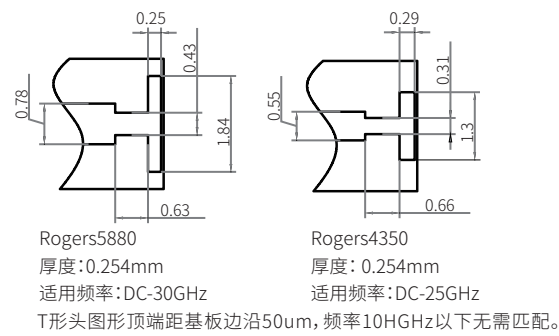


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP16975-2450-9DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

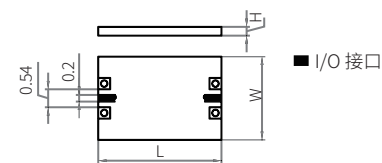
► 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

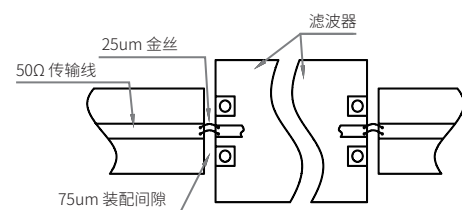
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	16.975	-	GHz
通带频率	15.75	-	18.2	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@13GHz			
	≥50dB@20 GHz			

► 外形尺寸

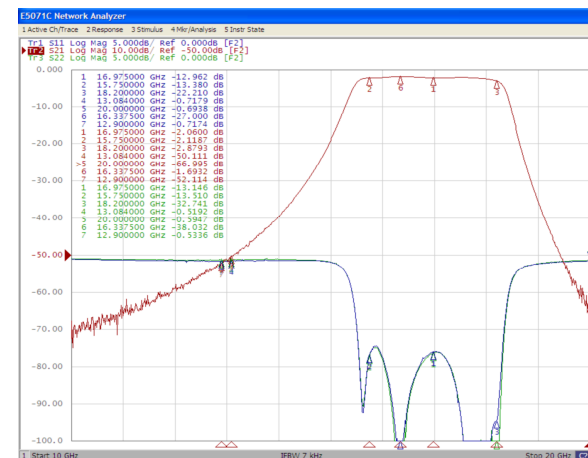


符号	数值	单位
L	7.0	mm
W	2.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

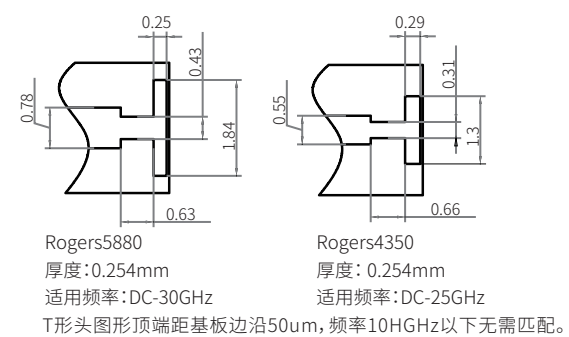


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP17250-4500-8DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

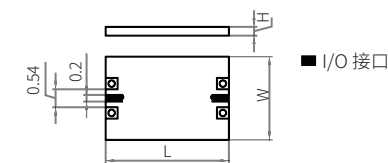
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

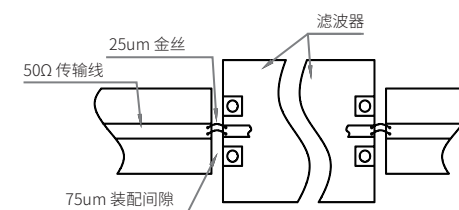
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	17.25	-	GHz
通带频率	15	-	19.5	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@12GHz			
	≥40dB@23GHz			

► 外形尺寸

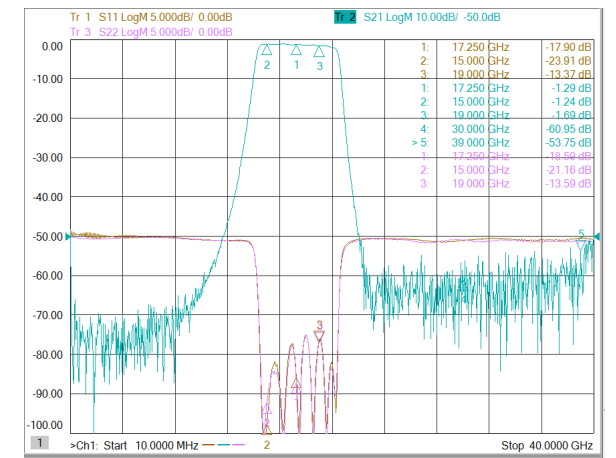


符号	数值	单位
L	5.6	mm
W	2.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

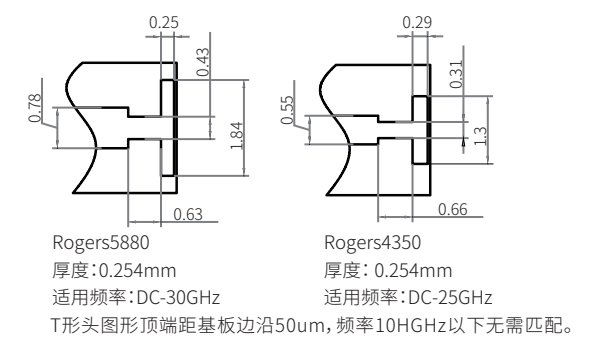


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP17350-2700-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

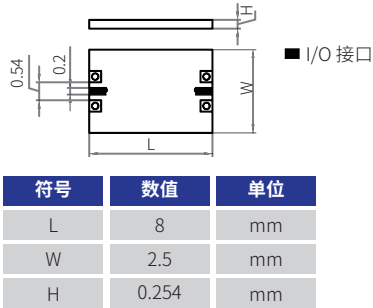
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

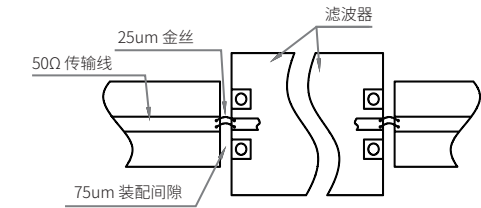
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	17.35	-	GHz
通带频率	16	-	18.7	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥35dB@15GHz			
	≥35dB@19.5GHz			

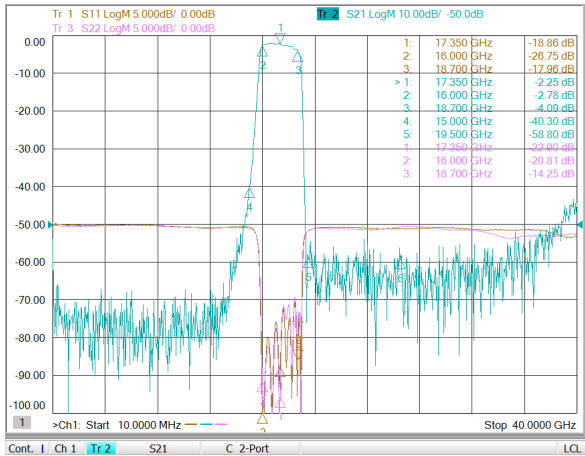
外形尺寸



建议装配图

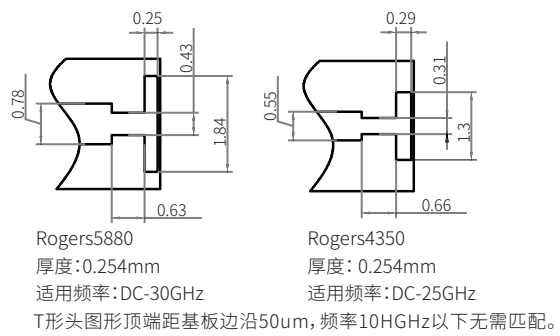


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP17850-4250-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

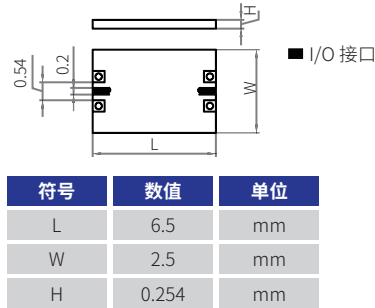
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

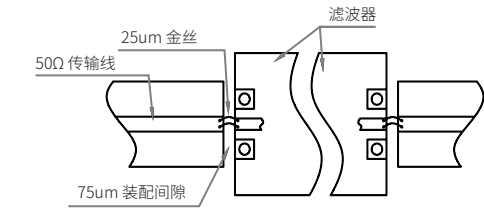
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	17.875	-	GHz
通带频率	15.75	-	20	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@12.5GHz			
	≥40dB@23.5GHz			

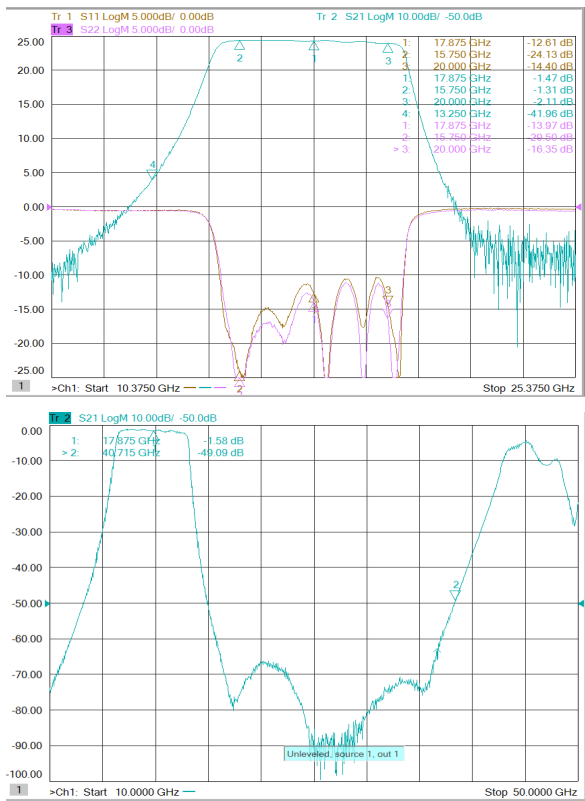
外形尺寸



建议装配图

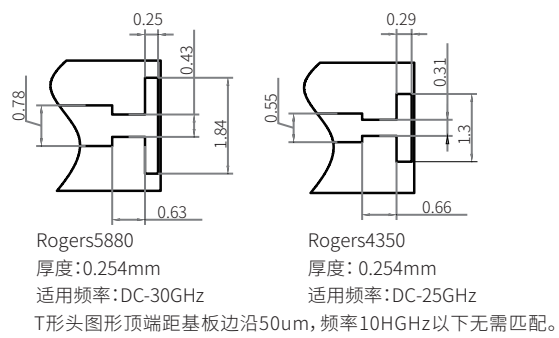


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP18000-4000-8DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

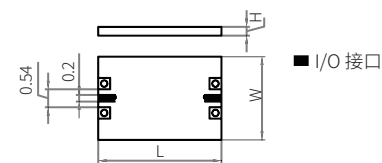
► 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

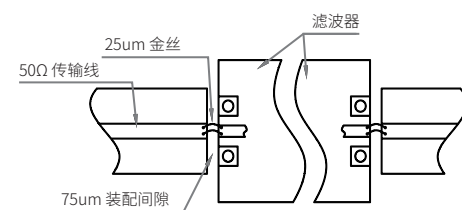
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	18	-	GHz
通带频率	16		20	GHz
中心插损	-	2	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻 波	-	1.8		-
带外抑制	≥45dB@11 GHz			
	≥45dB@23 GHz			

► 外形尺寸

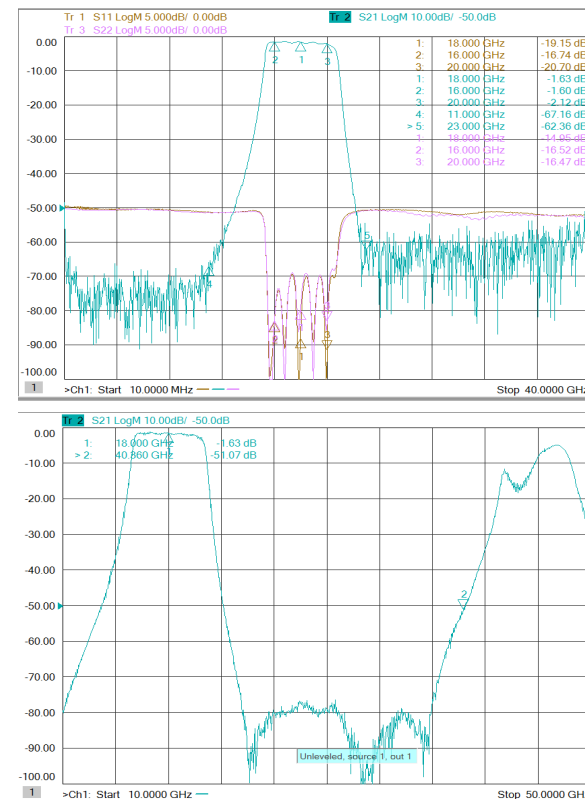


符号	数值	单位
L	6	mm
W	2.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

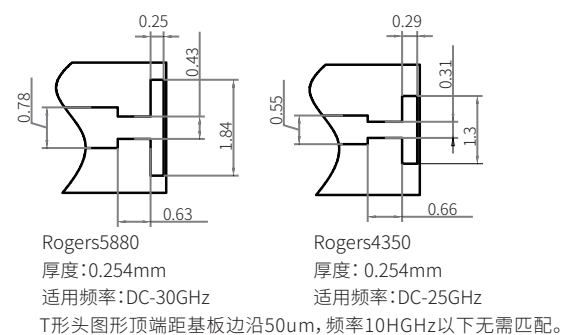


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP18000-4400-9DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

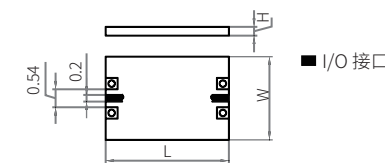
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

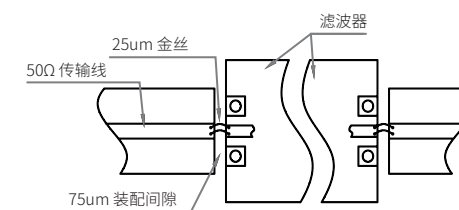
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	18	-	GHz
通带频率	15.8	-	20.2	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@11 GHz			
	≥50dB@24 GHz			

► 外形尺寸

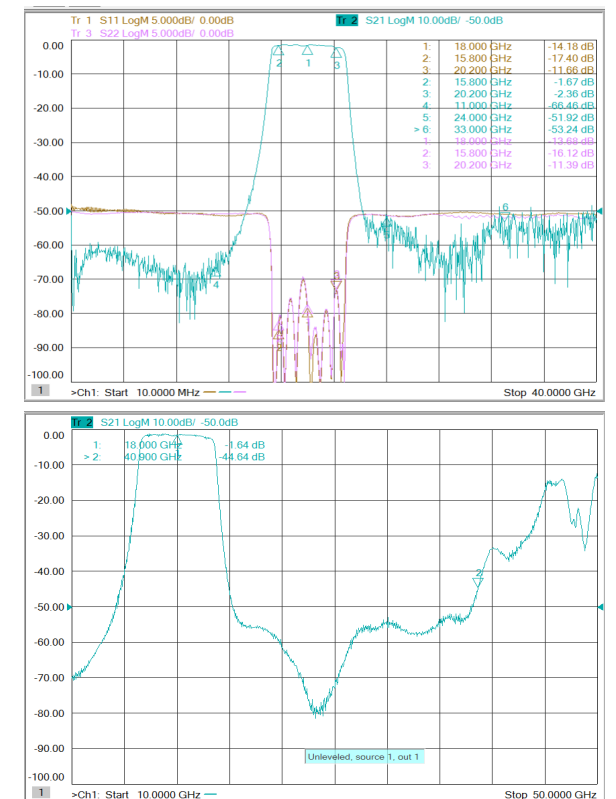


符号	数值	单位
L	8.0	mm
W	2.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

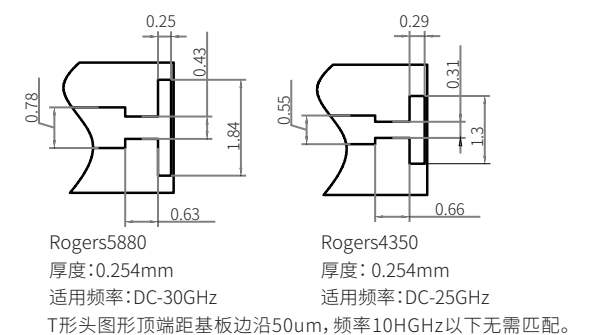


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP18500-3400-8SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

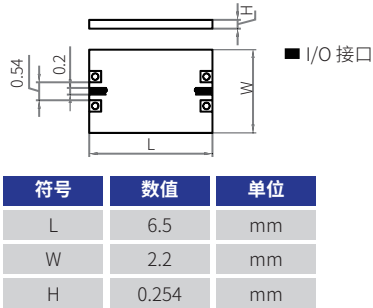
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

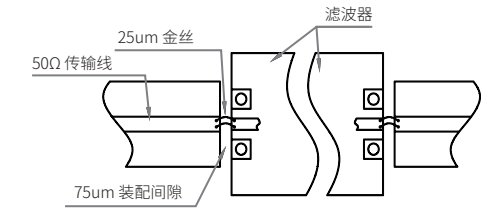
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	18.5	-	GHz
通带频率	16.8	-	20.2	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@12 GHz			
	≥60dB@25 GHz			

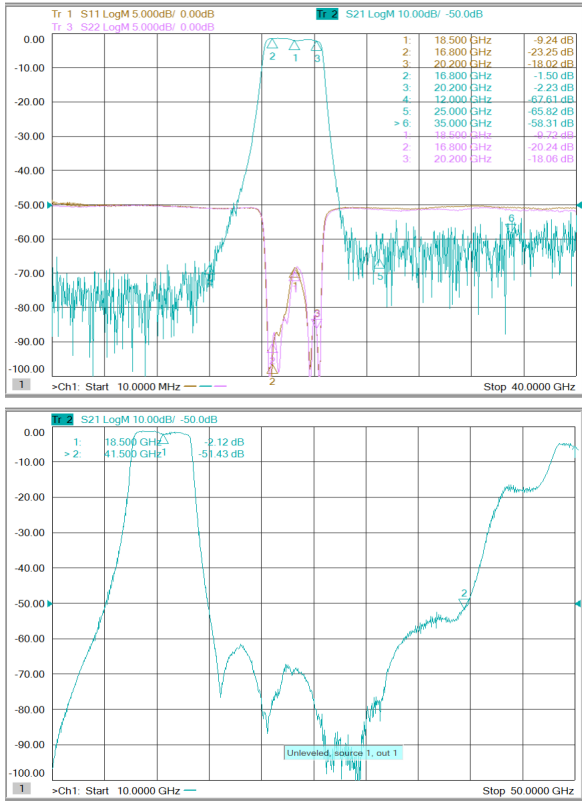
外形尺寸



建议装配图

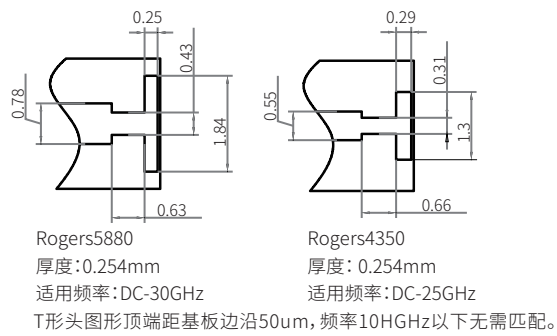


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP19000-2300-8JA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

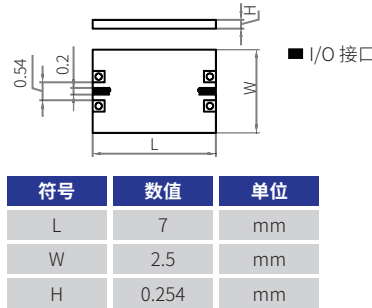
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

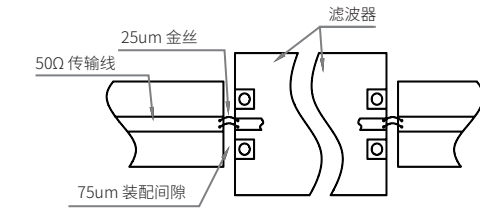
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	19	-	GHz
通带频率	17.85	-	20.15	GHz
中心插损	-	3	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥46dB@15 GHz			
	≥46dB@23 GHz			

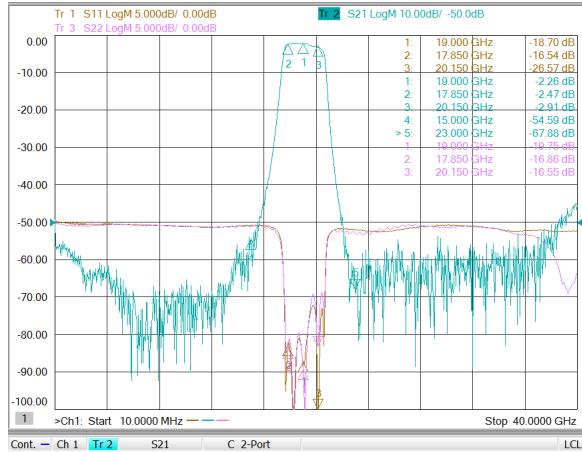
外形尺寸



建议装配图

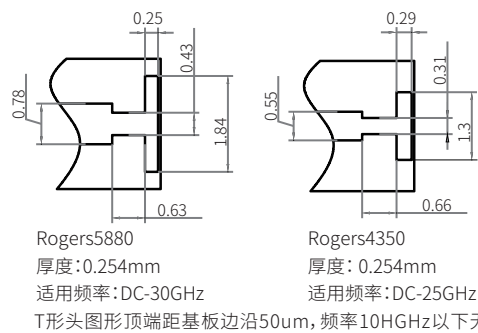


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP20328.4-20-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

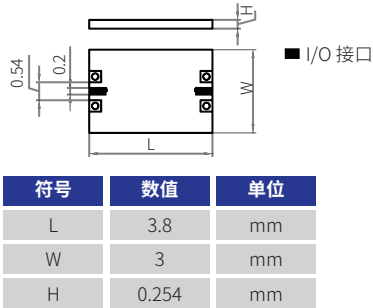
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

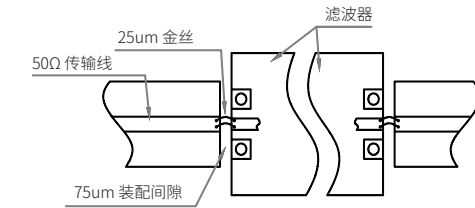
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	20.3284	-	GHz
通带频率	20.3184	-	20.3384	GHz
中心插损	-	6	-	dB
带内波动	-	-	0.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@19.4068 GHz			
	≥40dB@21.25 GHz			

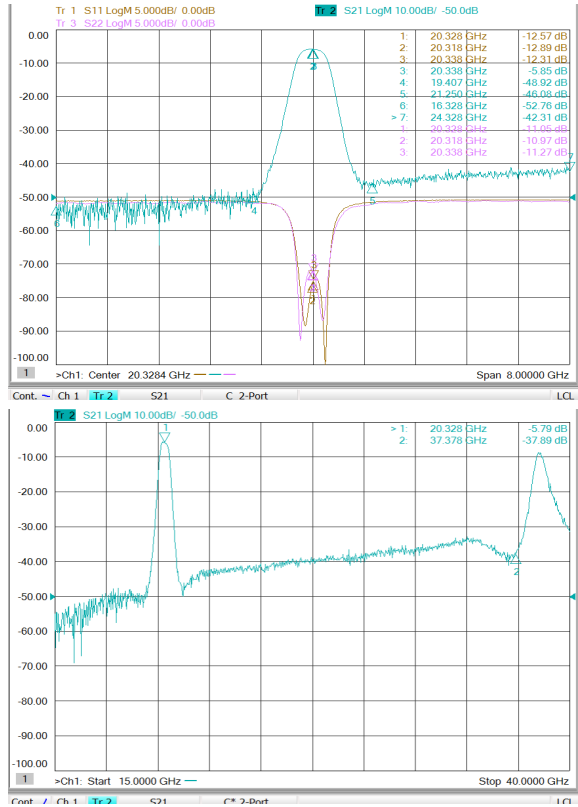
外形尺寸



建议装配图

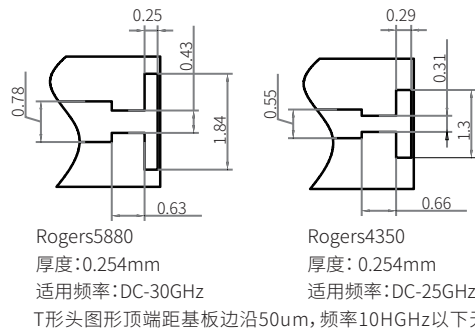


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP20500-7000-11DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

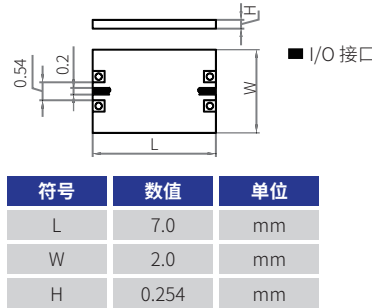
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

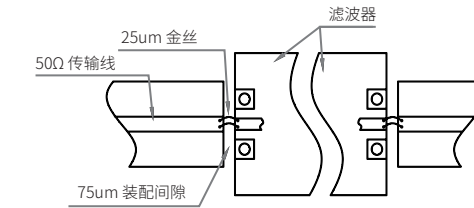
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	20.5	-	GHz
通带频率	17	-	24	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@12GHz			
	≥35dB@25.5GHz			

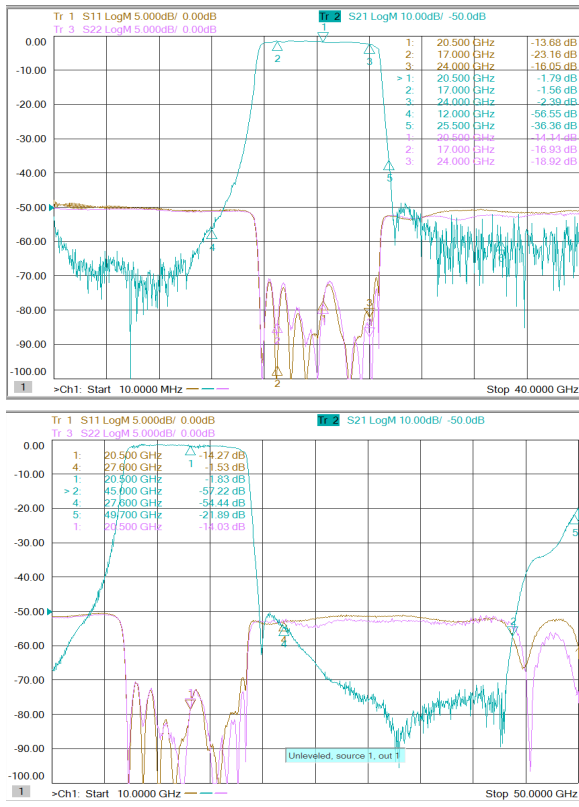
外形尺寸



建议装配图

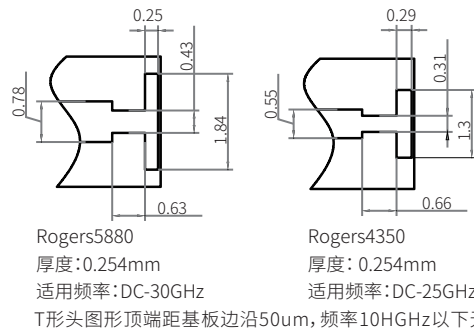


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP20750-6500-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

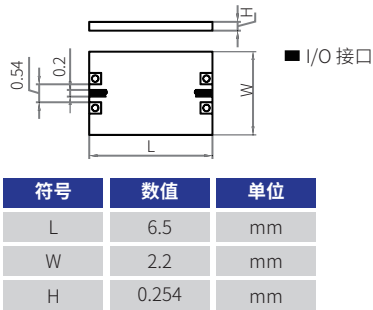
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

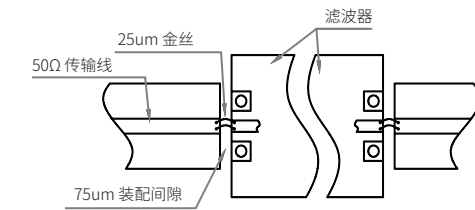
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	20.75	-	GHz
通带频率	17.5	-	24	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@12GHz			
	≥40dB@27GHz			

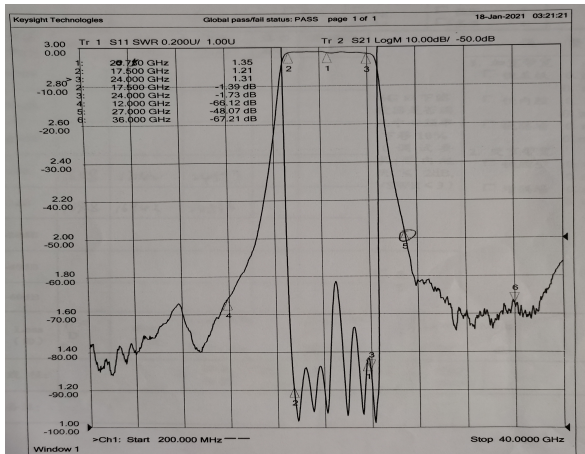
外形尺寸



建议装配图

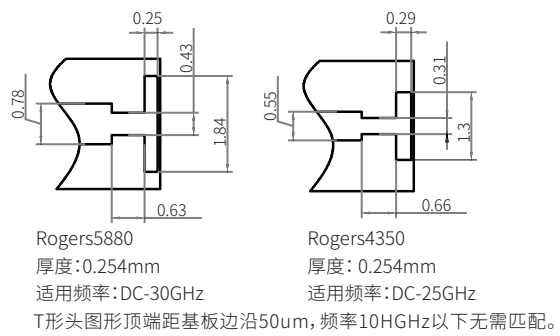


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP20828.4-20-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

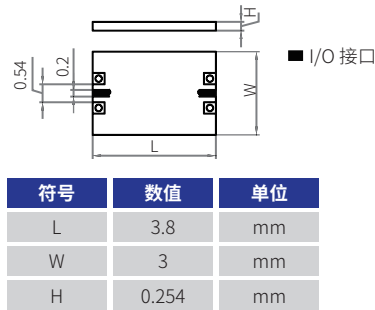
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

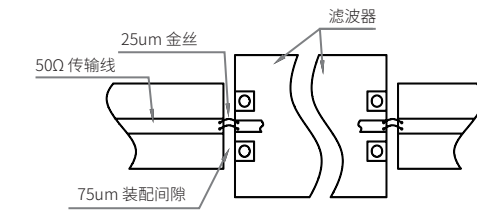
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	20.8284	-	GHz
通带频率	20.8184	-	20.8384	GHz
中心插损	-	7.0	-	dB
带内波动	-	-	0.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@19.9068 GHz			
	≥40dB@21.75 GHz			

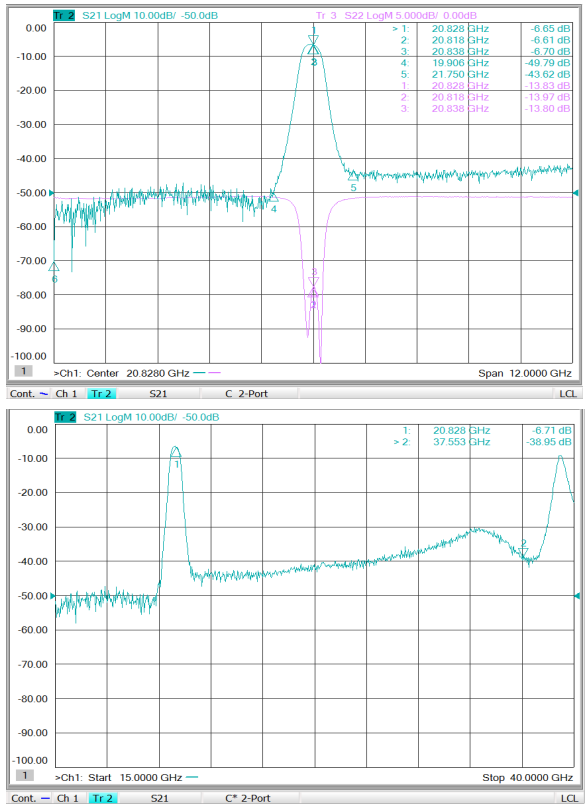
外形尺寸



建议装配图

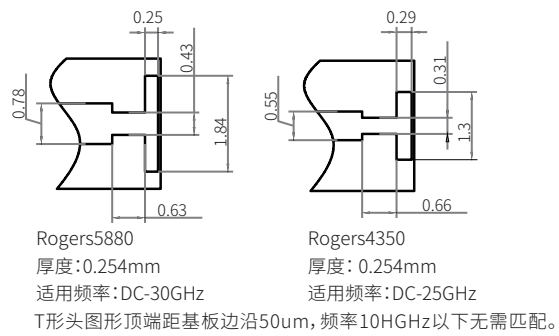


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP21900-1600-6PA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

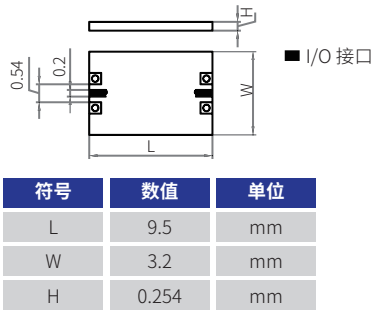
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

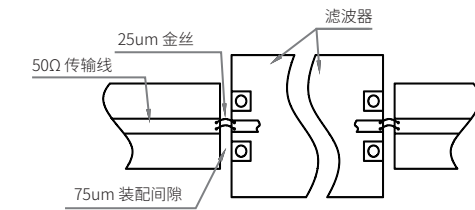
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	21.9	-	GHz
通带频率	21.1	-	22.7	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥35dB@20GHz			
	≥35dB@24GHz			

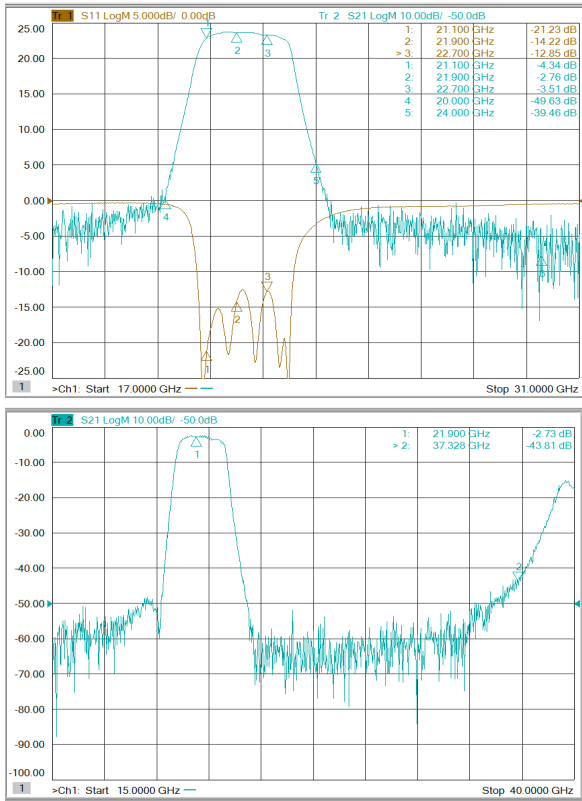
外形尺寸



建议装配图

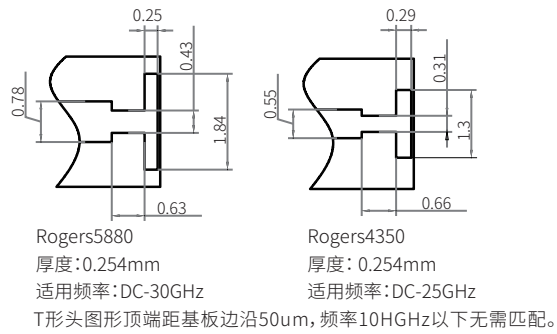


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP22000-4400-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

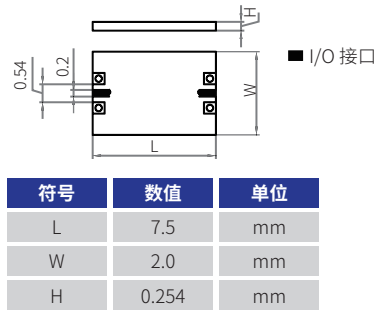
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

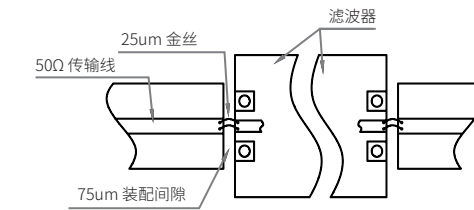
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	22	-	GHz
通带频率	19.8	-	24.2	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@15GHz			
	≥50dB@28.5GHz			

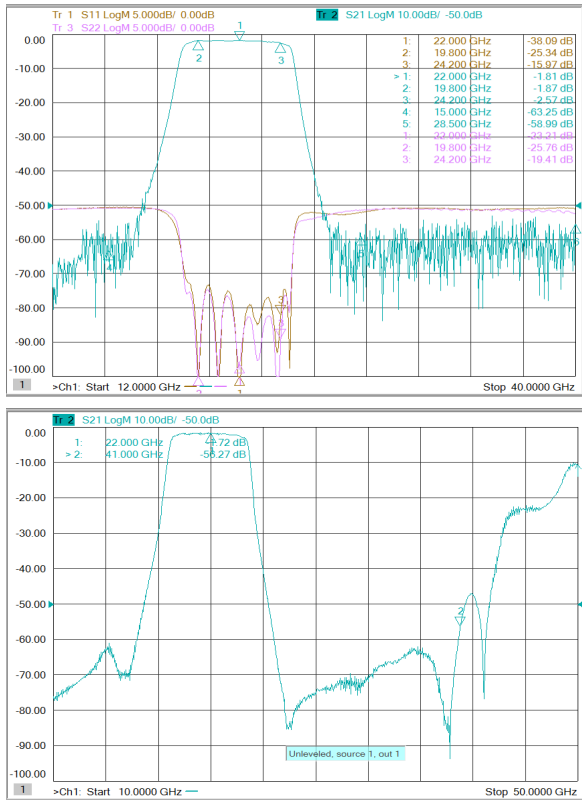
外形尺寸



建议装配图

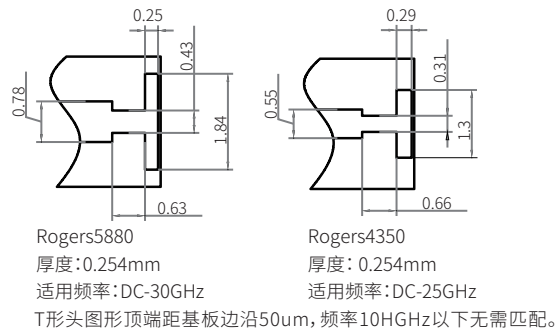


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP22250-8400-10DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

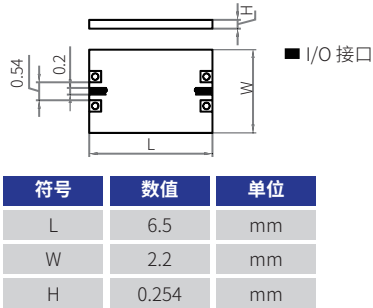
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

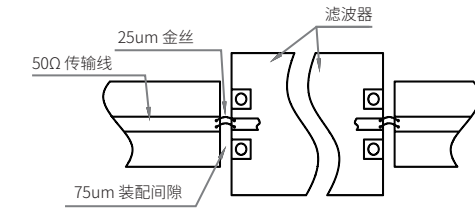
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	20.75	-	GHz
通带频率	17.5	-	24	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@12GHz			
	≥40dB@27GHz			

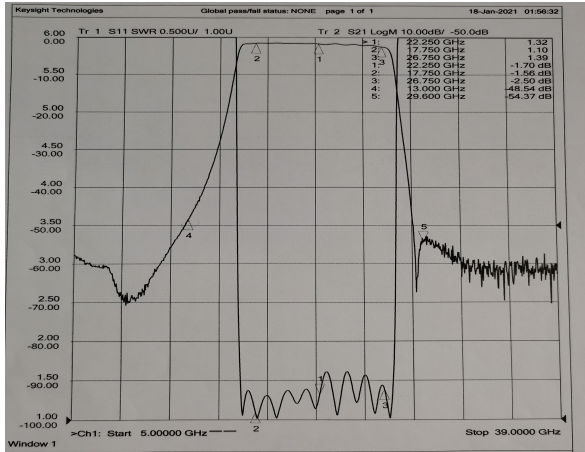
外形尺寸



建议装配图

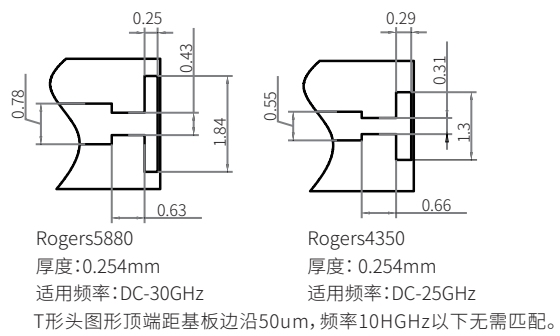


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP22250-9000-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

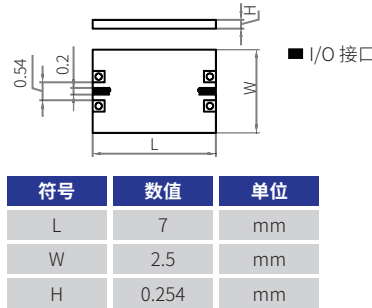
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

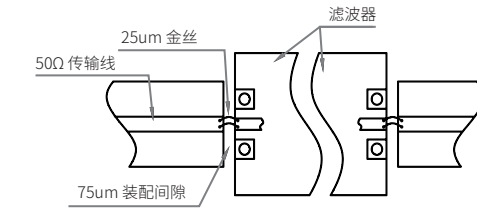
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	22.25	-	GHz
通带频率	17.75	-	26.75	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@13GHz			
	≥27dB@29.6GHz			

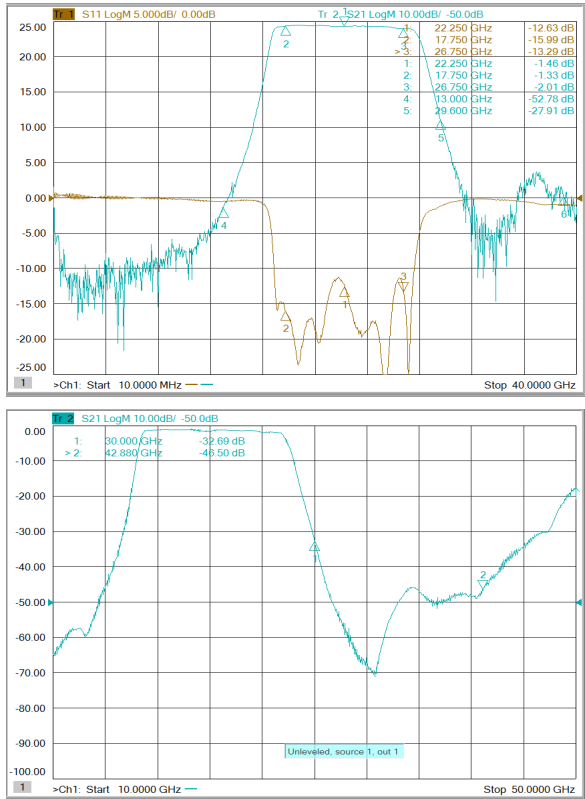
外形尺寸



建议装配图

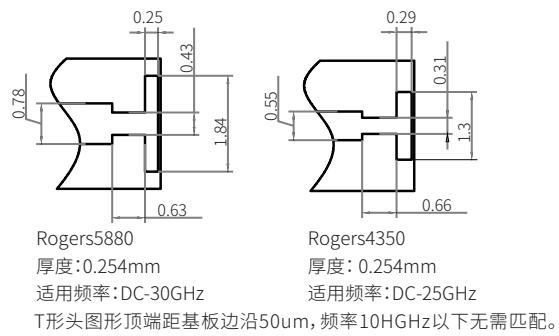


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP23171.5-20-4CQ

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

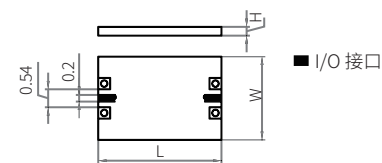
► 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

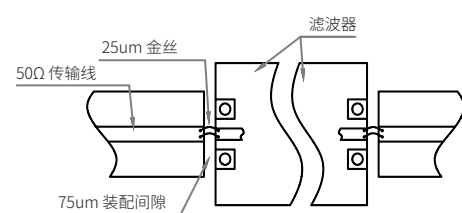
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	23.1715	-	GHz
通带频率	23.1615	-	23.1815	GHz
中心插损	-	6	-	dB
带内波动	-	-	0.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@22.2499 GHz			
	≥40dB@24.0931 GHz			

► 外形尺寸

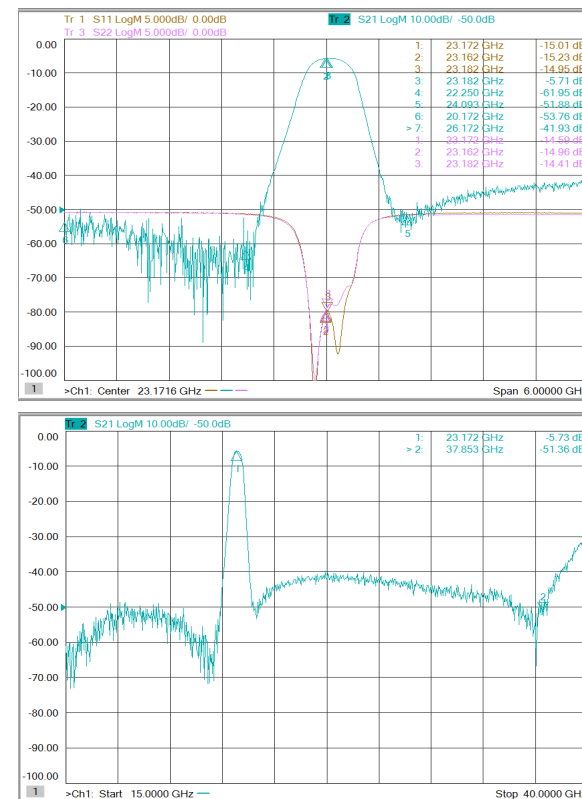


符号	数值	单位
L	3.8	mm
W	3	mm
H	0.254	mm

▶ 建议装配图

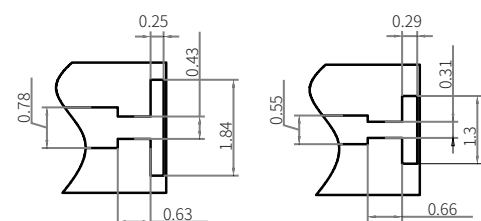


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



Rogers5880	Rogers4350
厚度:0.254mm	厚度:0.254mm
适用频率:DC-30GHz	适用频率:DC-25GHz
T形头图形顶端距基板边沿50um, 频率10GHz以下无需匹配。	

YZBP23200-100-4CQ

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合,适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

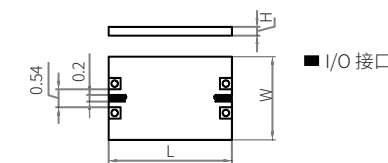
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

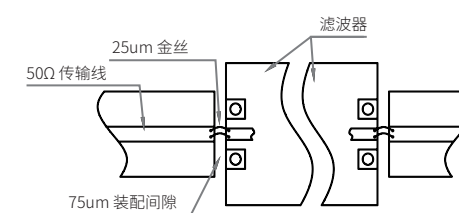
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	23.2	-	GHz
通带频率	23.15	-	23.25	GHz
中心插损	-	6.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@22GHz			
	≥40dB@24.4GHz			

► 外形尺寸

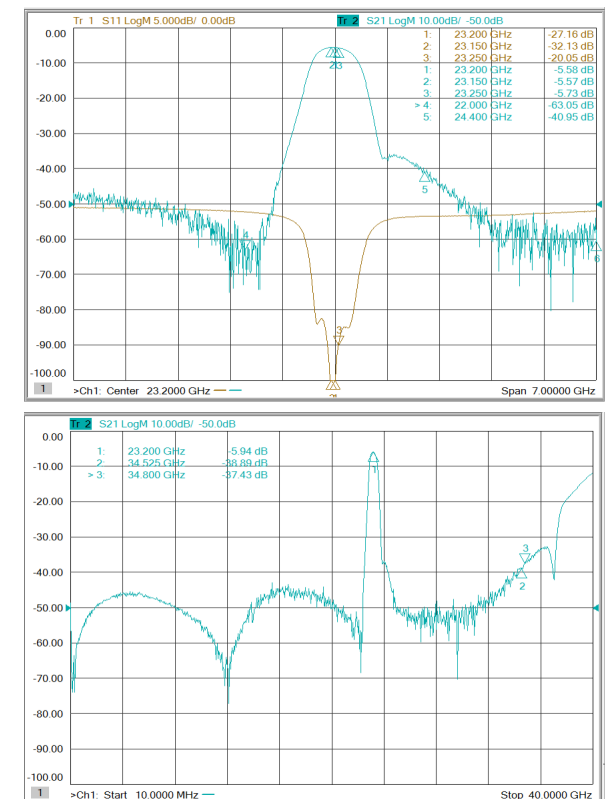


符号	数值	单位
L	4.2	mm
W	3.4	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

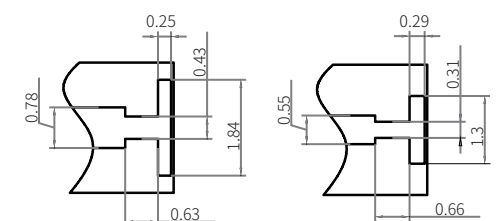


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



Rogers5880	Rogers4350
厚度:0.254mm	厚度:0.254mm
适用频率:DC-30GHz	适用频率:DC-25GHz

T形头图形顶端距基板边沿50um, 频率10GHGz以下无需匹配。

YZBP23671.6-20-4CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

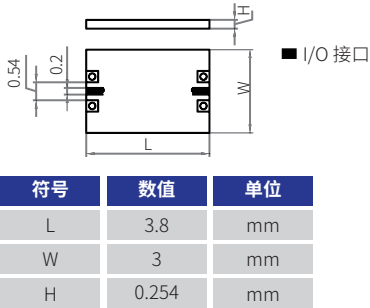
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

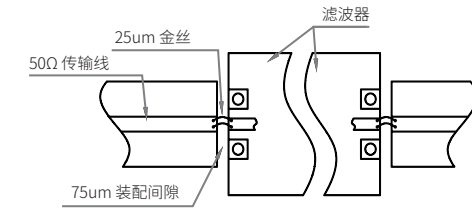
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	23.6716	-	GHz
通带频率	23.6616	-	23.6816	GHz
中心插损	-	6.2	-	dB
带内波动	-	-	0.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@22.75GHz			
	≥40dB@24.5932 GHz			

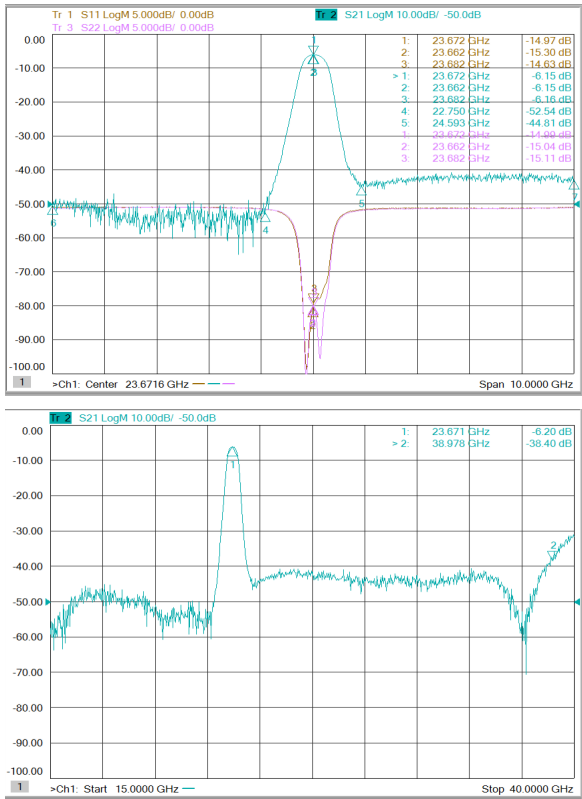
外形尺寸



建议装配图

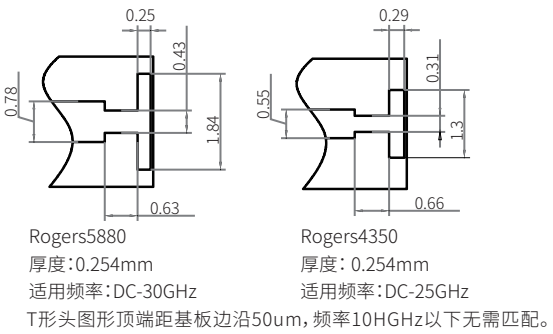


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP24000-1000-5CQ

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

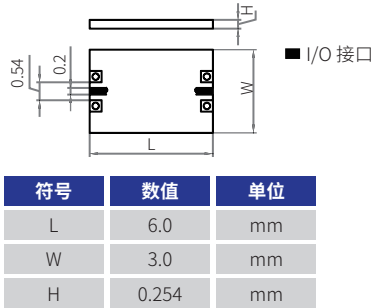
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

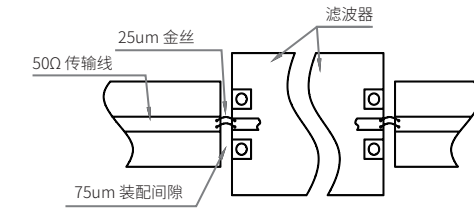
电性能指标 Specifications

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	24	-	GHz
通带频率	23.5	-	24.5	GHz
中心插损	-	3.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@22GHz			
	≥40dB@25.5GHz			

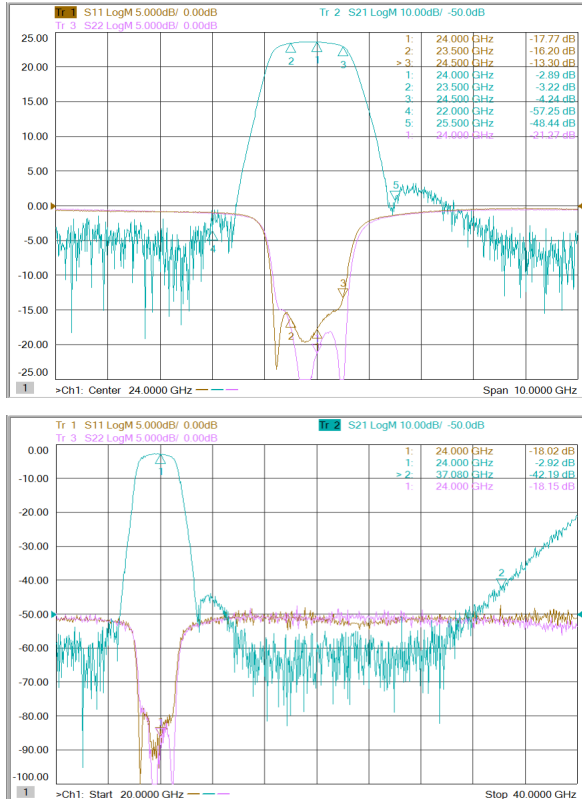
外形尺寸



建议装配图

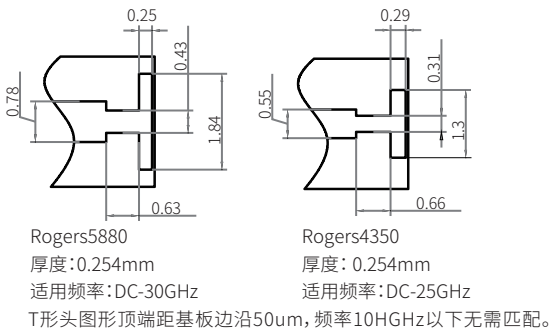


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP25000-2900-8PA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

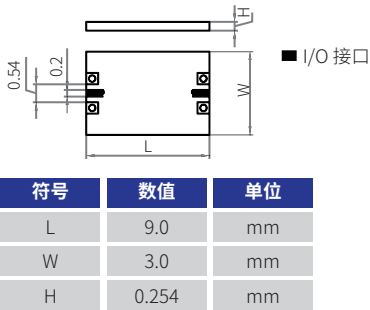
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

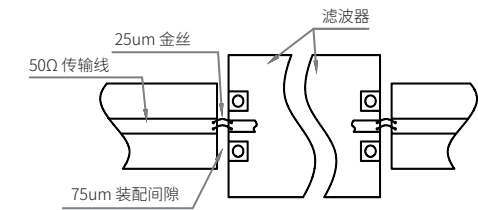
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	25	-	GHz
通带频率	23.5	-	26.4	GHz
中心插损	-	2.8	-	dB
带内波动	-	-	1	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@21.6GHz			
	≥40dB@28.5GHz			

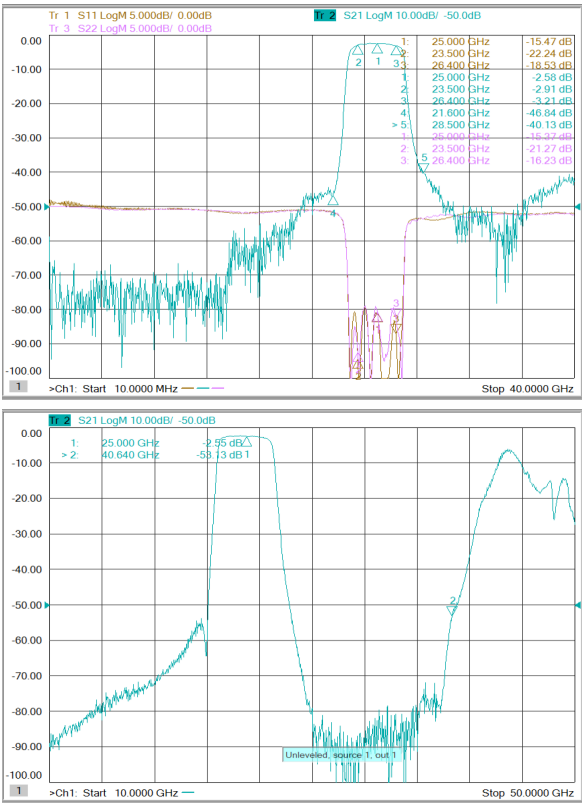
外形尺寸



建议装配图

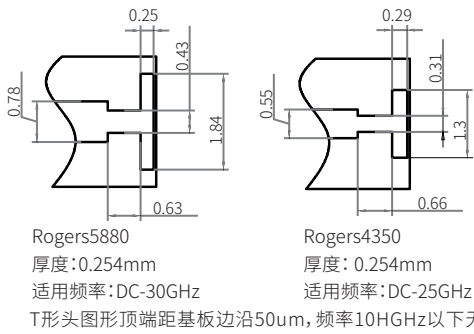


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP26000-4400-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

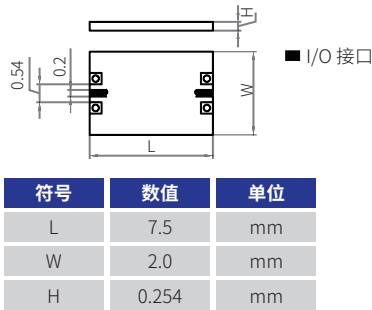
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

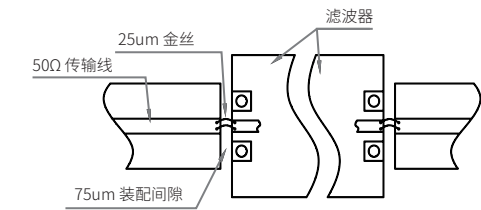
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	26	-	GHz
通带频率	23.8	-	28.2	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥60dB@18GHz			
	≥60dB@32.5GHz			

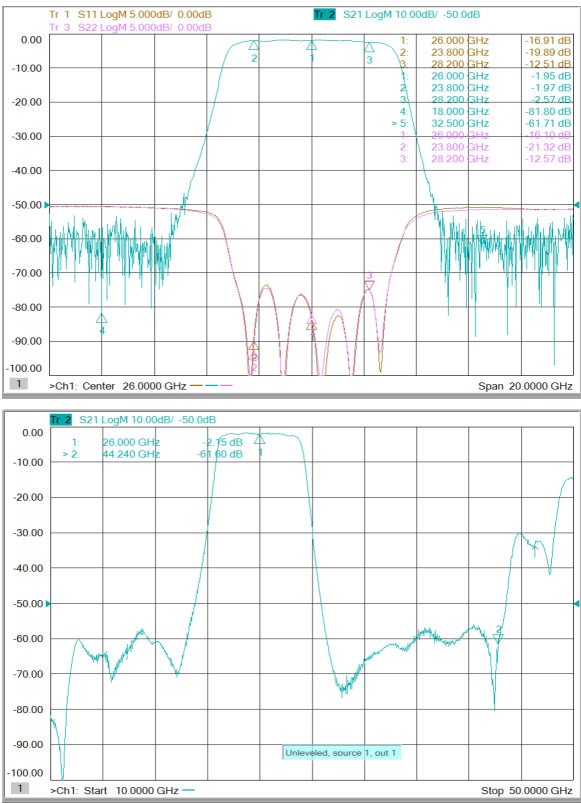
外形尺寸



建议装配图

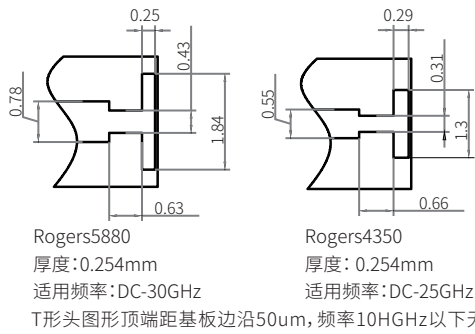


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP28050-8700-9DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

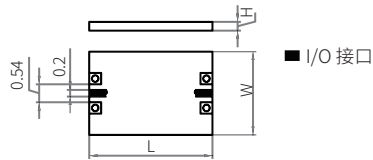
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

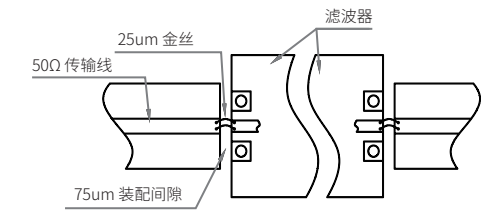
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	28.05	-	GHz
通带频率	23.7	-	32.4	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@DC~16.2GHz			
	≥35dB@35.7~45GHz			

外形尺寸

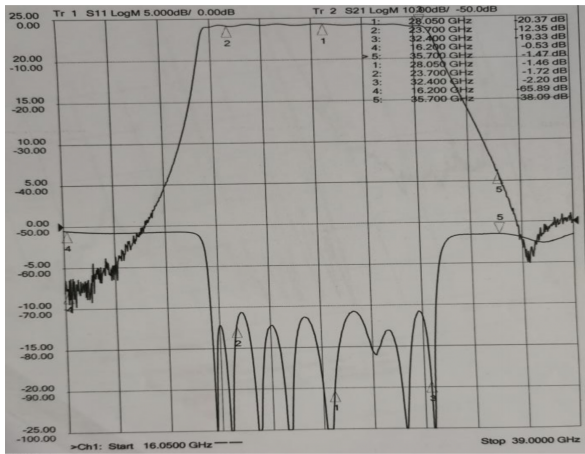


符号	数值	单位
L	9.0	mm
W	2.8	mm
H	0.254	mm

建议装配图

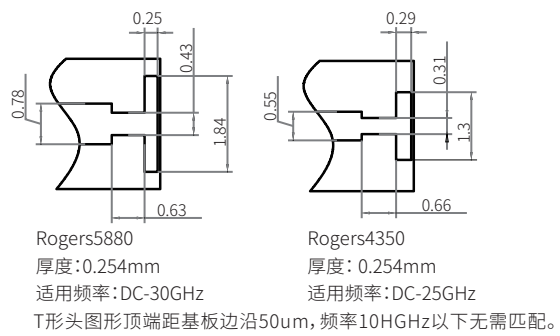


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP28500-8500-10DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

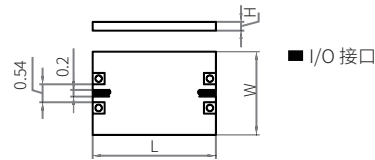
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

电性能指标

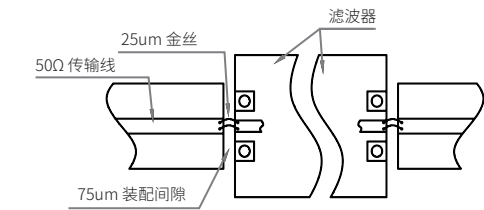
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	28.5	-	GHz
通带频率	24.25	-	32.75	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥55dB@20GHz			
	≥50dB@37.5GHz			

外形尺寸

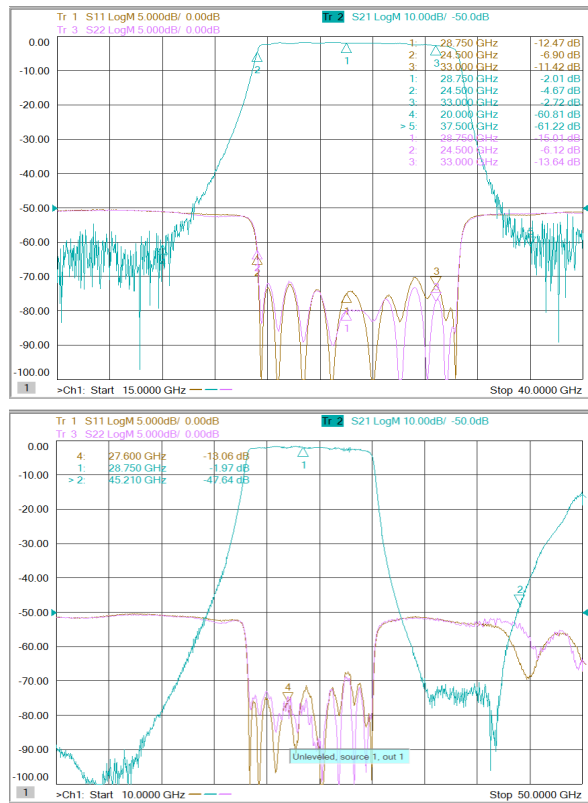


符号	数值	单位
L	7.0	mm
W	2.0	mm
H	0.254	mm

建议装配图

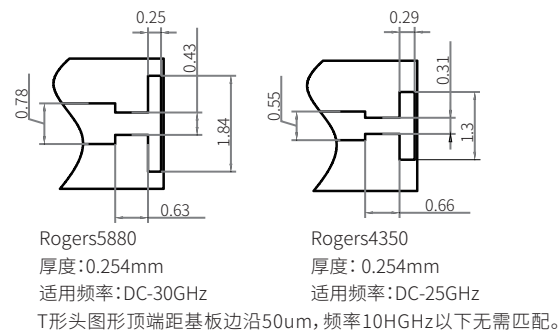


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP29000-200-8PA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

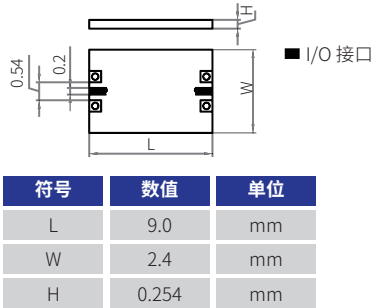
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

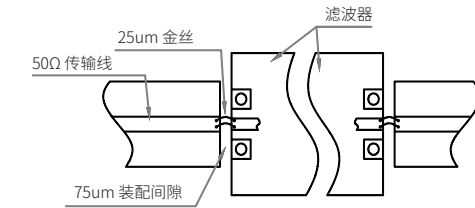
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	29	-	GHz
通带频率	28	-	30	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@23GHz			
	≥50dB@35GHz			

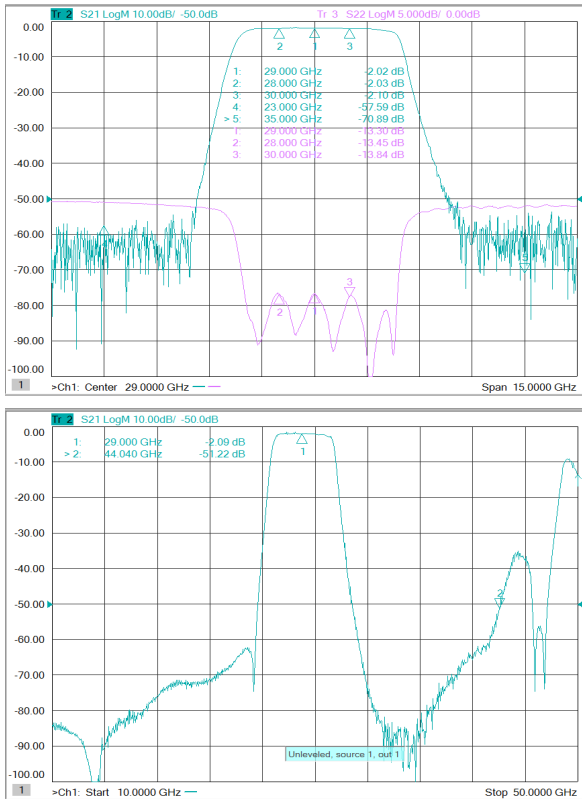
外形尺寸



建议装配图

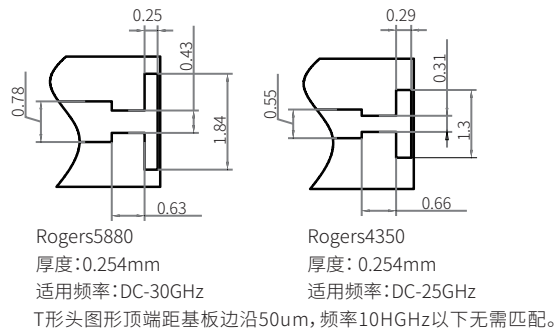


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP29000-6500-8PA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

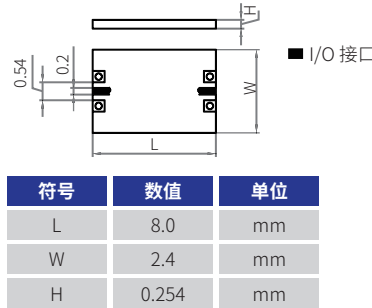
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

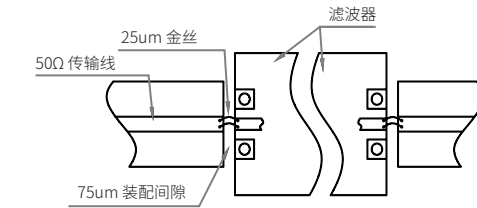
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	29	-	GHz
通带频率	25.75	-	32.25	GHz
中心插损	-	2	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@20GHz			
	≥45dB@38GHz			

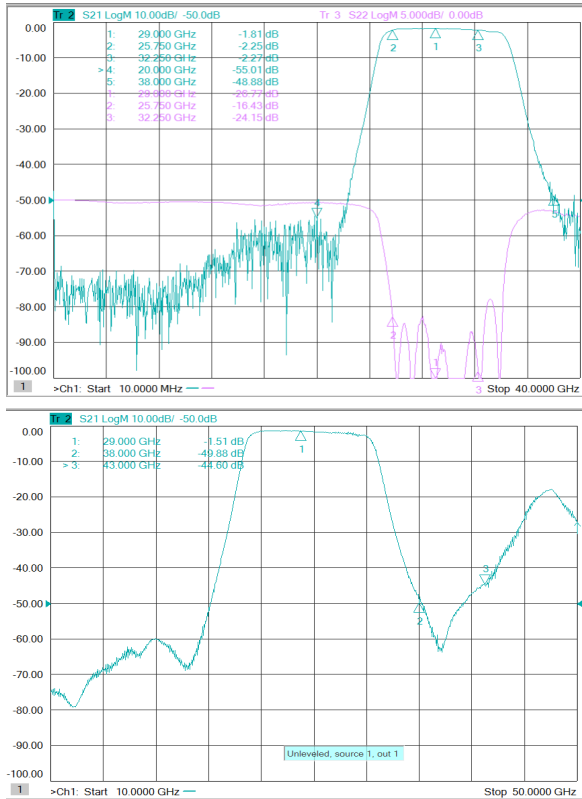
外形尺寸



建议装配图

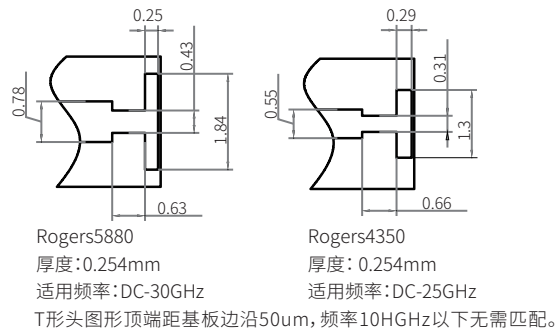


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP29500-7200-8DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

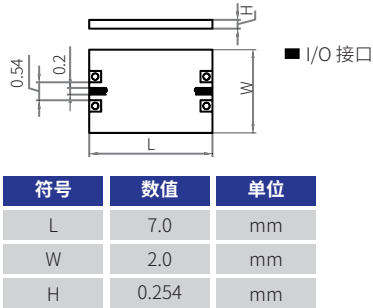
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

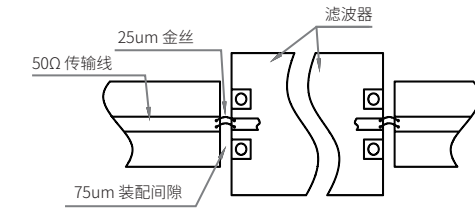
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	29.5	-	GHz
通带频率	25.9	-	33.1	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@19.5GHz			
	≥40dB@37.5GHz			

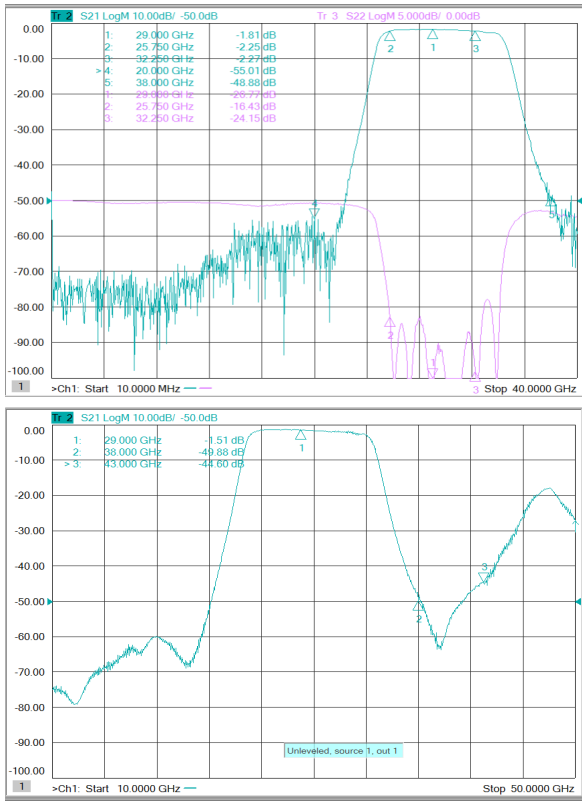
外形尺寸



建议装配图

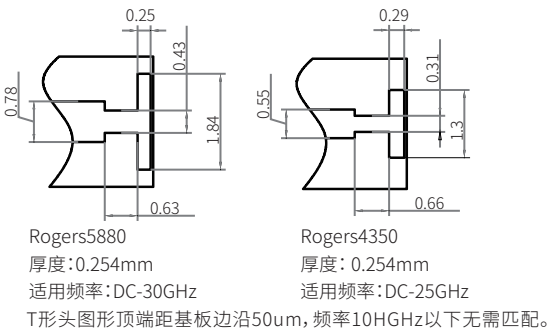


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP33000-1000-6DA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

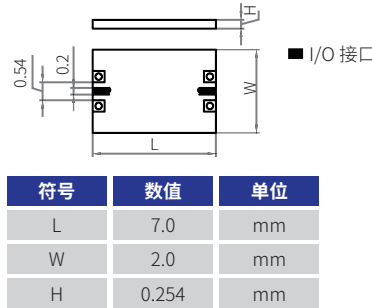
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

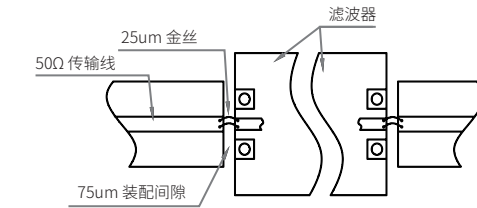
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	33	-	GHz
通带频率	32.5	-	33.5	GHz
中心插损	-	3.5	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@28.8GHz			
	≥40dB@37.5GHz			

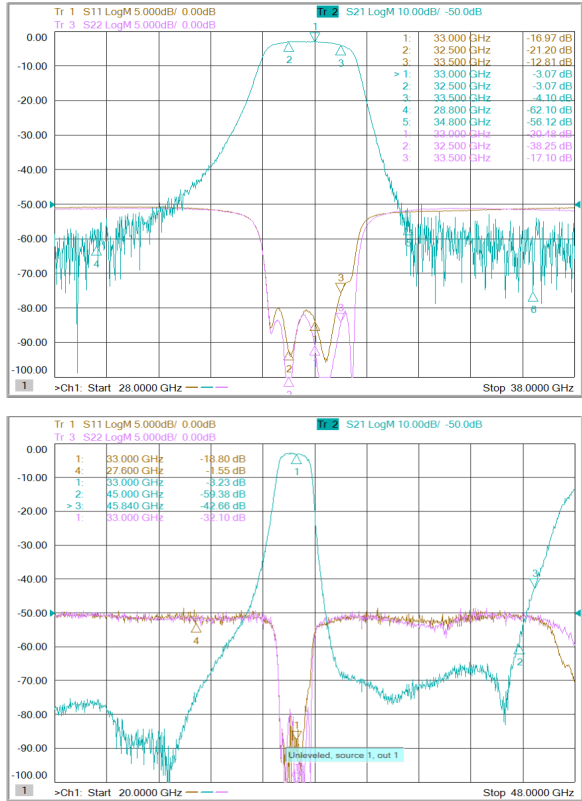
外形尺寸



建议装配图

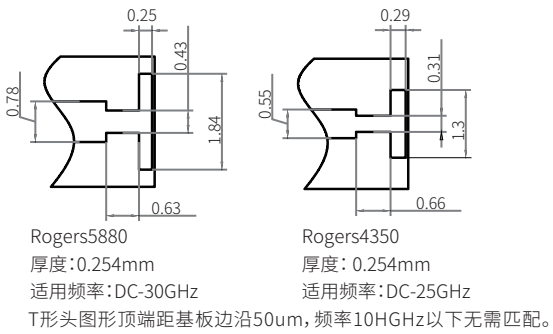


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用, 滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右, 滤波器上表面距上盖板3mm左右;
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上, 载体厚度≥0.2mm;
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时, 建议微带线键合处采用T型结构进行匹配, T型头尺寸如下:



YZBP34000-4000-6PA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

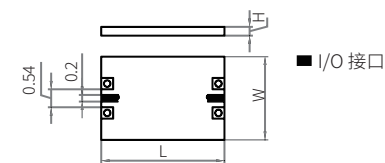
▶ 环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

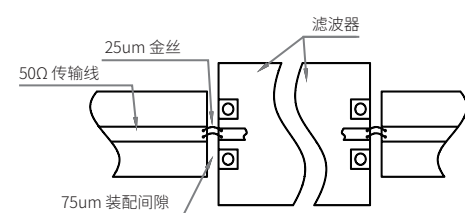
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	34	-	GHz
通带频率	32	-	36	GHz
中心插损	-	2.0	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻 波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@28 GHz			
	≥40dB@40 GHz			

► 外形尺寸

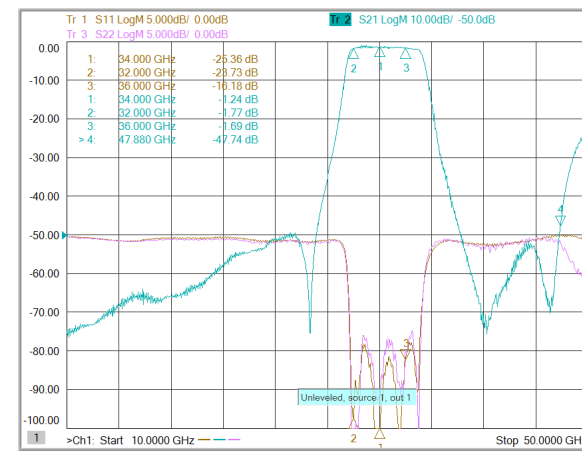


符号	数值	单位
L	7.0	mm
W	2.5	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

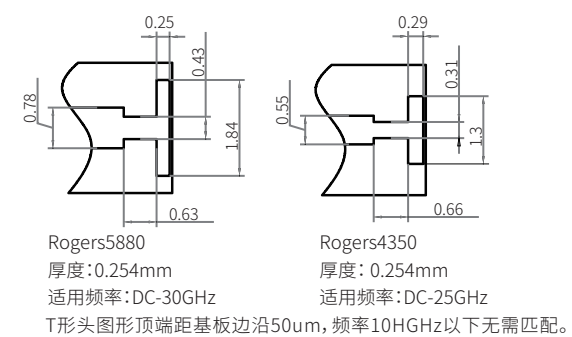


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP34150-700-6DA

► 性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

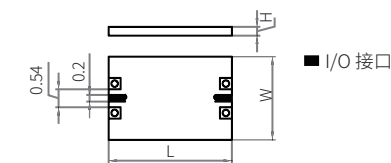
▶ 环境参数

工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最大输入功率	35dBm

► 电性能指标

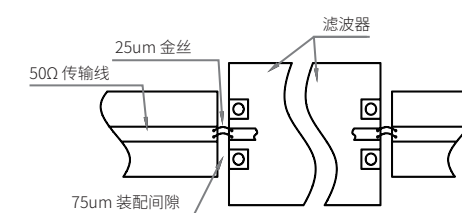
项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	34.15	-	GHz
通带频率	33.8	-	34.5	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@28 GHz			
	≥50dB@40 GHz			

▶ 外形尺寸

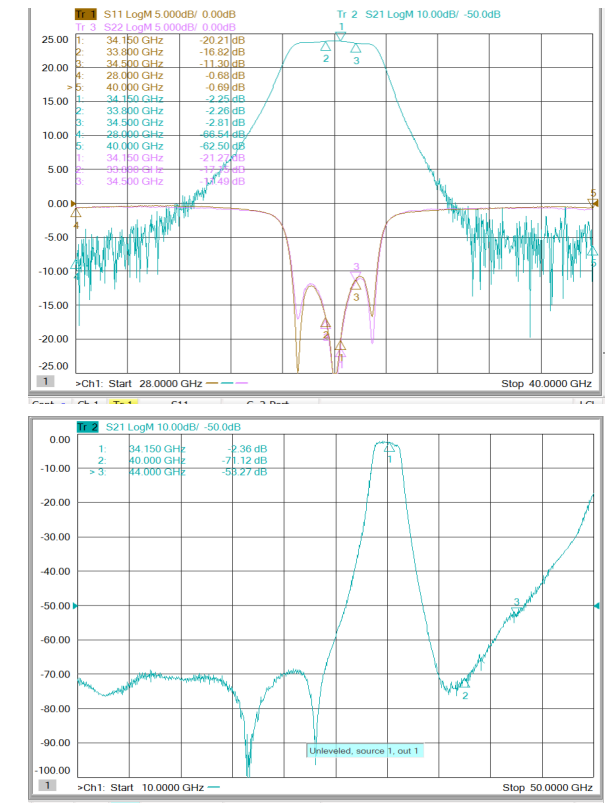


符号	数值	单位
L	7	mm
W	2	mm
H	0.254	mm

► 建议装配图

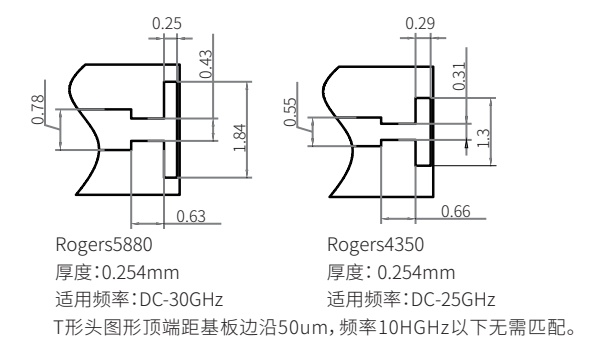


► 典型曲线



► 注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐（推荐）或钼铜等与基片热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载体上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP34500-3000-8PA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

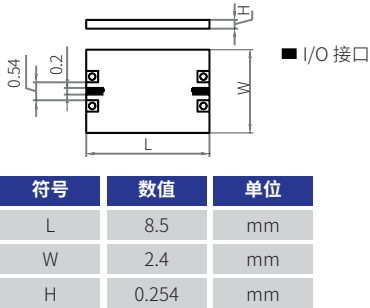
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

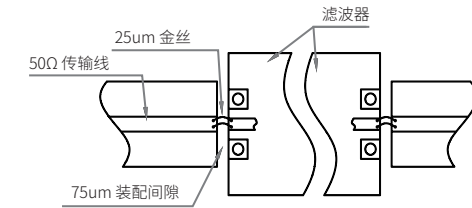
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	34.5	-	GHz
通带频率	33	-	36	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	-	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@30 GHz			
	≥50dB@38 GHz			

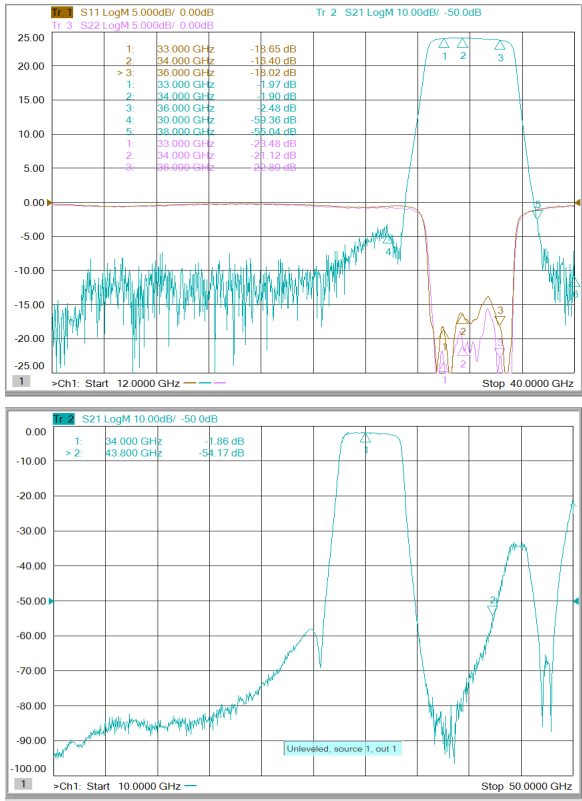
外形尺寸



建议装配图

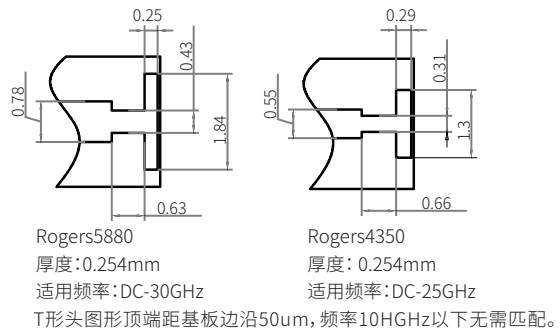


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP34500-3400-6PA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

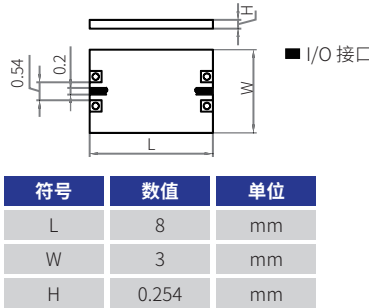
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

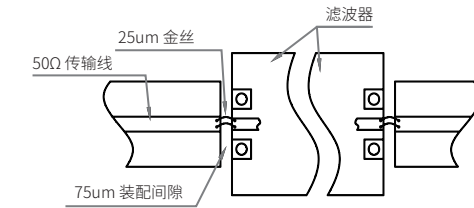
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	34.5	-	GHz
通带频率	32.8	-	36.2	GHz
中心插损	-	2	-	dB
带内波动	-	-	1.0	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥40dB@29.6 GHz			
	≥35dB@39.1 GHz			

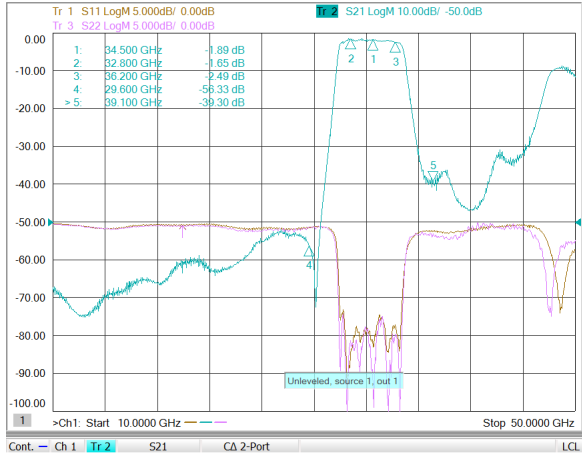
外形尺寸



建议装配图

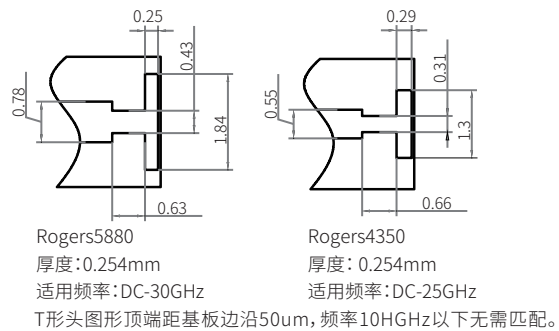


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型头尺寸如下：



YZBP36000-8000-8SA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

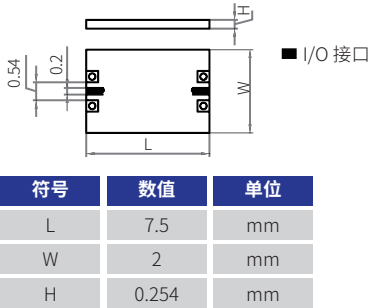
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

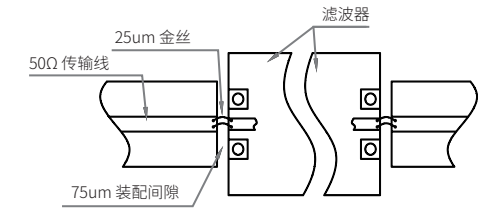
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	36	-	GHz
通带频率	32	-	40	GHz
中心插损	-	2.5	-	dB
带内波动	-	-	1.5	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥45dB@21 GHz			
	≥30dB@42 GHz			

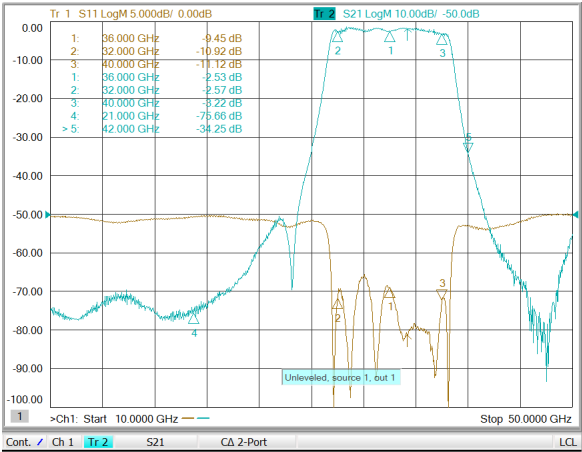
外形尺寸



建议装配图

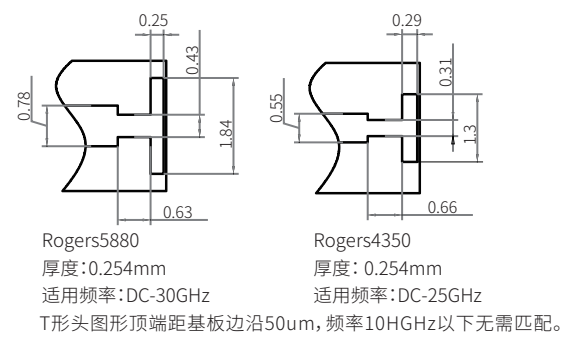


典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上,载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时,建议微带线键合处采用T型结构进行匹配,T型头尺寸如下：



YZBP40500-600-5PA

性能特点

- 1、高精度微纳米加工工艺
- 2、高性能、低温漂、高功率
- 3、金丝键合, 适用多芯片集成模块应用
- 4、50Ω共面波导输出

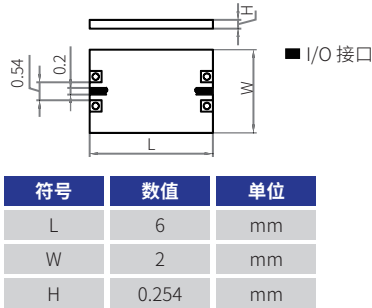
环境参数

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最大输入功率	35dBm

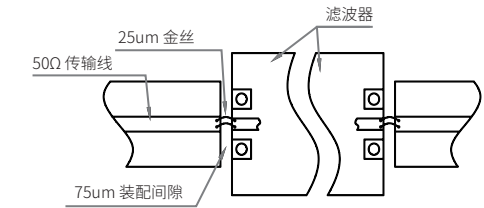
电性能指标

项目	最小	典型	最大	单位
中心频率	-	40.5	-	GHz
通带频率	40.2	-	40.8	GHz
中心插损	-	3	-	dB
带内波动	-	-	1.2	dB
驻波	-	1.8	-	-
带外抑制	≥50dB@31 GHz			
	≥15dB@51 GHz			

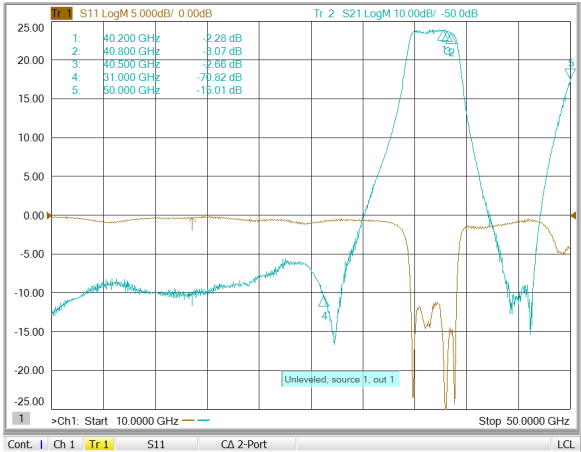
外形尺寸



建议装配图



典型曲线



注意事项

- 1、建议滤波器分腔使用，滤波器上线两侧距墙壁0.2mm左右，滤波器上表面距上盖板3mm左右；
- 2、滤波器推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；
- 3、滤波器应安装在可伐(推荐)或钼铜等与基片热膨胀系数(6.7ppm/°C)相当的载体上,载体厚度≥0.2mm；
- 4、电路微带线与滤波器芯片键合连接时,建议微带线键合处采用T型结构进行匹配,T型头尺寸如下：

